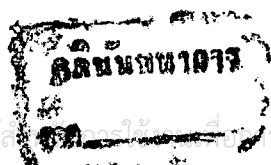




ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์
(COMPUTERIZE SECURITY SYSTEMS)



สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง



024717

29 มค 2533

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์
(COMPUTERIZE SECURITY SYSTEMS)

ชนะ โลหะทรัพย์ทวี
ฉัตรพัฒน์ สารกุล

ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาอดสาทรกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจสอบปริญญาฉัตรพัฒน์

.....ประธานกรรมการ
(*ชนะ โลหะทรัพย์ทวี*)

.....กรรมการ
(*ฉัตรพัฒน์ สารกุล*)

.....กรรมการ
(*ชนะ โลหะทรัพย์ทวี*)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สารบัญ

บทคัดย่อ คือ กิจกรรมประกาศ บท	หน้า
1. บทนำ	1
- อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ	1
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง	15
- อุปกรณ์เซนเซอร์ในระบบรักษาความปลอดภัย	21
2. การติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์	33
- สัญญาณนาฬิกาของระบบ	35
- การตัดโค๊ดแอดเดรสของแอมป์เบล	36
- สัญญาณควบคุมที่ใช้ในการอินเทอร์เฟส	43
3. การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์	46
- อุปกรณ์การตรวจสอบสัญญาณ	48
- การออกแบบชุดอินเทอร์เฟส	54
- กวดเอาท์พุทควบคุม	57
- การทำงานของเครื่อง	60
- การออกแบบโปรแกรมควบคุม	61
- การทำงานของโปรแกรม	61
- โปรแกรมควบคุม	65

4. บทสรุป	79
- การนำใช้งาน	81
- การพัฒนาระบบ	83
บรรณานุกรม	84
ภาคผนวก	85
ผนวก ก	85
ผนวก ข	89



ชื่อเรื่องปริญาณิพนธ์

ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์
(COMPUTERIZE SECURITY SYSTEMS)

ชื่อผู้เขียน

นาย ชนะ โลหะทรัพย์ทวี 29.3305

นาย ธีรพัฒน์ สารีกุล 29.3308

ปริญาณิพนธ์

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ลาดกระบัง

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยได้มีใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นระบบที่ยังยากซับซ้อน ดังนั้นไมโครคอมพิวเตอร์จึงได้เข้ามามีบทบาทในการควบคุมเพื่อลดความยุ่งยากซับซ้อนของระบบ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีแพร่หลายไม่มากนักซึ่งเป็นระบบที่ใหญ่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั่วไป จึงได้ออกแบบระบบชนิดใหม่ให้ขนาดเล็ก และประสิทธิภาพยังคงเดิม

ปริญาณิพนธ์ เป็นการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยควบคุมด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ บทที่ 1 กล่าวถึงอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทั่วไป และทฤษฎีของระบบรักษาความปลอดภัย บทที่ 2 กล่าวถึงการผลิตต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II บทที่ 3 เป็นการออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 เป็นการสรุปผลงานที่ได้จากการออกแบบ รวมทั้งวิธีการนำไปใช้งาน และการพัฒนาระบบต่อไป

ปริญาณิพนธ์ เป็นระบบที่ได้ออกแบบขึ้น ให้ผลการดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถที่จะนำไปใช้งานได้อย่างกว้างขวาง ใช้ติดตั้งในอาคารที่พักอาศัยหรือสถานที่อื่น ๆ มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยที่ราคาไม่สูงมากนัก

กิตติกรรมประกาศ

ปรัชญาอันประเสริฐสำเร็จได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนจากท่าน
อาจารย์ทปรีक्षा ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

อาจารย์ ดร. ไพศาล นาคพิมพ์ณ์ *

และอีกหลายท่านที่ได้ให้ความสนับสนุน ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง



บท 1

บทนำ

คำนำ เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การที่สามารถนำมาต่อรวมกัน หรือ อินเตอร์เฟส (interface) เข้ากับ ระบบไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมการทำงาน ของระบบรักษาความปลอดภัย จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชื่อมได้มากขึ้น ในระบบรักษาความปลอดภัย ส่วนสำคัญของระบบจะต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ หรือ เรียกว่า SENSOR

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ

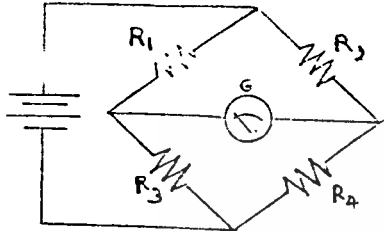
เซ็นเซอร์ (SENSORS) เป็นอุปกรณ์ที่สามารถบริการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม และ สิ่งต่างๆ เช่น อุณหภูมิ แสง เสียง สารเคมี แรงสั่นสะเทือน ปริมาณทางไฟฟ้าการเคลื่อนที่ของวัตถุ ฯลฯ

ทรานสดิวเซอร์ (TRANSDUCERS) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น พลังงานความร้อน พลังงานแสงสว่าง พลังงานเสียง พลังงานจากคลื่นความถี่วิทยุ พลังงานกล สุนัขแม่เหล็ก ฯลฯ

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ทดสอบข้างต้นซึ่งแต่ละชนิดจะมีลักษณะการทำงานแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ทรานสดิวเซอร์ ทดสอบหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานซึ่งจะแปรผันกับ อุณหภูมิ ความร้อน เป็นต้น ออปโตทรานสดิวเซอร์ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้หลักการของสอลเอฟเฟค อุปกรณ์วัดความถี่ ความถี่ หรืออุปกรณ์สวิตช์ และยังมียุคหลายชนิดซึ่งจะกล่าวต่อไป

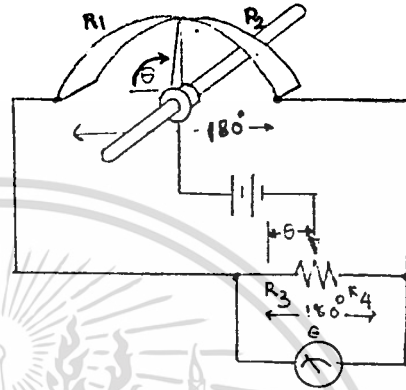
ทรานสดิวเซอร์ทดสอบหลักการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทาน

การใช้ตัวต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้เป็นทรานสดิวเซอร์เป็นทแพร่หลาย และมีใช้ค่อนข้างมากโดยหลักการที่ใช้จะเป็นวิธีการของ วิทส์ ไตนบริดจ์ (WHEATSTONE BRIDGE) ดังรูป 1.1.1



$$R_1 R_4 = R_2 R_3$$

รูป 1.1.1 วิสโตนบริดจ์



รูป 1.1.2 ใช้ตัวต้านทานเป็น
ทรานสดิวเซอร์วัดมุมของเพลลา

ตัวอย่างการใช้งานดังรูป 1.1.2 ซึ่งใช้ตัวต้านทานแปรค่าวัดมุมหมุนของเพลลาสมมติว่าแกนของเพลลาหมุนไปทำให้เกิดมุมที่ตัวต้านทานที่ติดกับแกนเพลลา และแบ่งค่าตัวต้านทานออกเป็น R_1, R_2 ซึ่งอาจทำให้บริดจ์ไม่สมดุลได้วิธีที่จะทำให้บริดจ์สมดุลก็โดยวิธีการปรับพอท (POTENTIOMETER) เพื่อแบ่งค่าความต้านทาน R_3 และ R_4 ให้พอเหมาะส่วนของพอทเอง ถ้าเราปรับแต่งในการหมุนแล้วมีสเกลอ่านค่ามุมได้โดยตรงซึ่งจะเห็นว่าเมื่อบริดจ์สมดุล $R_3/R_4 = R_1/R_2$ หรือ $R_3 \cdot R_4 = R_1 \cdot R_2$ นั่นคือถ้า R_1/R_2 เป็นมุม $0/180$ องศาเราก็จะปรับแต่ง R_3/R_4 ตามแกนเป็นตัวเลข $0/180$ องศาได้

ด้วยหลักการของวิสโตนบริดจ์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ตัวอย่างเช่น เครื่องชั่งน้ำหนัก ฯลฯ

สเตรนเกจส์ (STRAIN GAUGES)

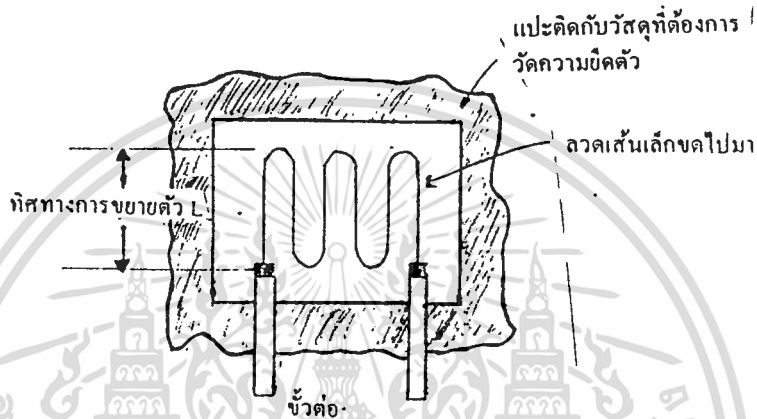
สเตรนเกจส์ เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วยลวดเส้นเล็กๆ ขดอยู่บนแผ่นกระดาษหรือพลาสติกบางๆ เมื่อต้องการใช้ก็จะปะติดลงบนแผ่นวัสดุซึ่งวัสดุจะต้องมีการวัดการยืดตัวหรือการขยายตัว โดยคุณสมบัติของสเตรนเกจส์ จะเปลี่ยนค่าความต้านทานตามขนาดของ การยืดหรือ หดตัวของวัสดุ โดยให้ความสัมพันธ์ดังนี้

$$\Delta R/R = K \Delta L/L$$

K = เป็นค่าคงตัวของคนสมบัตย์ของสเตรนเกจส์

R = คือค่าความต้านทาน

L = คือค่าระยะทางหยดตัวหรือหดตัว



รูป 1.2 ลักษณะทั่วไปของสเตรนเกจส์

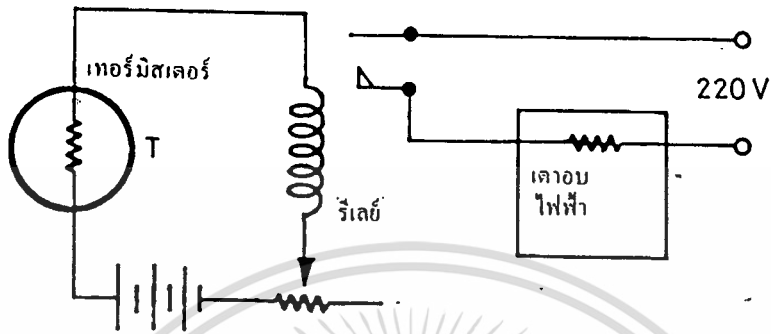
ประโยชน์หลักของสเตรนเกจส์คือ เป็นตัวให้ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามการยืดตัว หรือ หดตัวของวัสดุที่ต้องการวัด ในการวัดนั้นเราก็จะหาค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนตรงกับความยาวที่เพิ่มขึ้น ทำให้เรานำเอาค่าความยาวที่เพิ่มขึ้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเช่น วัดความเค้น หรือความเครียดในคานเสา เป็นต้น

วัดอุณหภูมิด้วยหลักการแปรค่าความต้านทาน

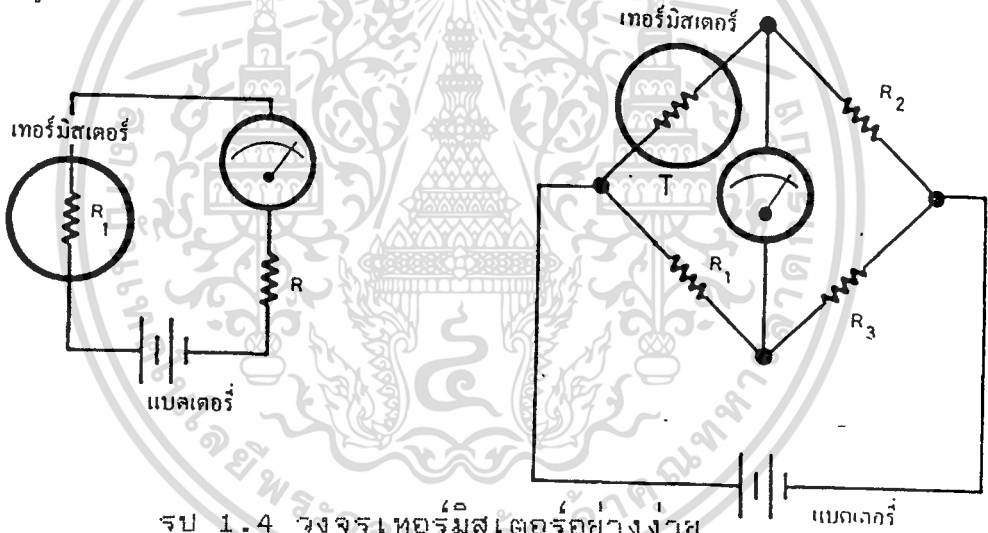
อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการวัดอุณหภูมิจะกล่าวถึงนี้ คือ เทอร์มิสเตอร์

(THERMISTOR) เทอร์มิสเตอร์ เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ความต้านทานในทางลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและในทางกลับกัน เมื่ออุณหภูมิลดลงค่าความต้านทานก็จะเพิ่มขึ้น ค่าโดยเฉลี่ยของการแปรค่าจะอยู่ในราว -2% ต่อองศาฟาเรนไฮต์ แต่อย่างไรก็ตาม การแปรค่าของเทอร์มิสเตอร์ไม่ได้เป็นเชิงเส้นตลอดเทอร์มิสเตอร์บางแบบสามารถใช้ได้ถึงอุณหภูมิประมาณ 250 องศาเซลเซียส มีรูปร่างหลายแบบ เช่น เป็นแผ่น สี่เหลี่ยม

๘๘
ทรงกลมขึงสองขา



รูป 1.3 วงจรอย่างง่ายใช้เทอร์มิสเตอร์เป็นเทอร์มิสแตท



รูป 1.4 วงจรเทอร์มิสเตอร์อย่างง่าย

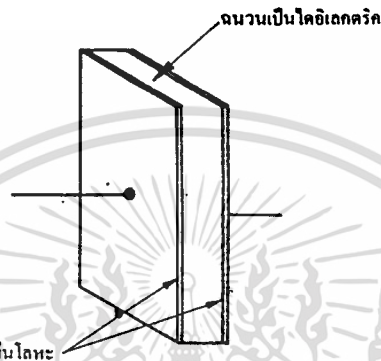
การใช้หลักการของตัวเก็บประจุเป็นทรานส์ดิวเซอร์

เมื่อนำแผ่นโลหะสองแผ่นวางขนานกัน โดยมีวัสดุฉนวนวางขึ้นกลาง ครั้นเมื่อ

ต่อขาออกจากแผ่นขั้วโลหะทั้งสองผลที่ได้ก็คือ ตัวเก็บประจุ ค่าตัวเก็บประจุสามารถคำนวณได้จากสูตร

$$C = \frac{KA}{L}$$

- เมื่อ $K =$ เป็นค่าคงตัวของสารหน้ามาชนกลาง
 $A =$ เป็นพื้นที่ผิวแผ่นโลหะ
 $L =$ เป็นระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะ



รูป 1.5 หลักการของตัวเก็บประจุอย่างง่าย

การให้ค่าตัวเก็บประจุแปรค่าได้ อาจทำได้หลายวิธี เช่น ให้สารไดอิเล็กตริก เปลี่ยนให้พื้นที่ผิวแผ่นโลหะเปลี่ยน หรือให้ระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะเปลี่ยน ก็ทำให้ค่า C เปลี่ยนแปลงโดยปกติค่า C ที่เปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ แต่ถ้าหากหันมาพิจารณาในแง่ของอิมพีแดนซ์ โดยใช้ความถี่สูงจะมีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงทางอิมพีแดนซ์ สูง เนื่องจาก

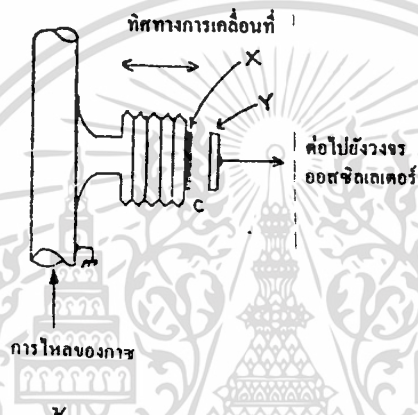
$$Z = \frac{1}{2\pi fC}$$

$Z =$ คือค่าอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุที่ความถี่ f

การดัดแปลงเพื่อนำไปใช้งานของทรานซิสเตอร์ ชนิดแปรค่าตัวเก็บประจุอาจทำได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้เป็นอุปกรณ์วัดหรือตรวจสอบระดับของเหลวหรือสารที่เป็นผง วิธีการอาจกระทำในลักษณะการสร้างส่วนตรวจสอบเป็นแผ่นโลหะสองแผ่น โดยให้ของเหลวสามารถผ่านเข้าไปในช่องระหว่างกลาง เพื่อให้แปรเปลี่ยนค่าตัวเก็บประจุตามระดับของเหลวที่ผ่านเข้าไป นอกจากนี้ยังสามารถใช้หลักการของตัวเก็บประจุไปใช้ในการตรวจสอบ

เช่น เครื่องวัดความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดพืช โดยความชื้นจะทำให้ค่าของตัวเก็บประจุเปลี่ยนแปลงไป

รูป 1.6 เป็นวิธีหนึ่งในการใช้หลักการของตัวเก็บประจุในการวัดความชื้นของพืชจากกรณีนี้ถ้าให้พืชมีความชื้นมากขึ้นจะกดแผ่นโลหะด้าน X ด้วยแรงที่สูงขึ้น ทำให้ระยะของแผ่นโลหะ X-Y ลดลง ค่าตัวเก็บประจุจะพลอยมีค่าสูงขึ้น และนำไปใช้เปลี่ยนความถี่ได้ในวงจรออสซิลเลเตอร์เพื่อที่จะได้เหตุผลต่อไป

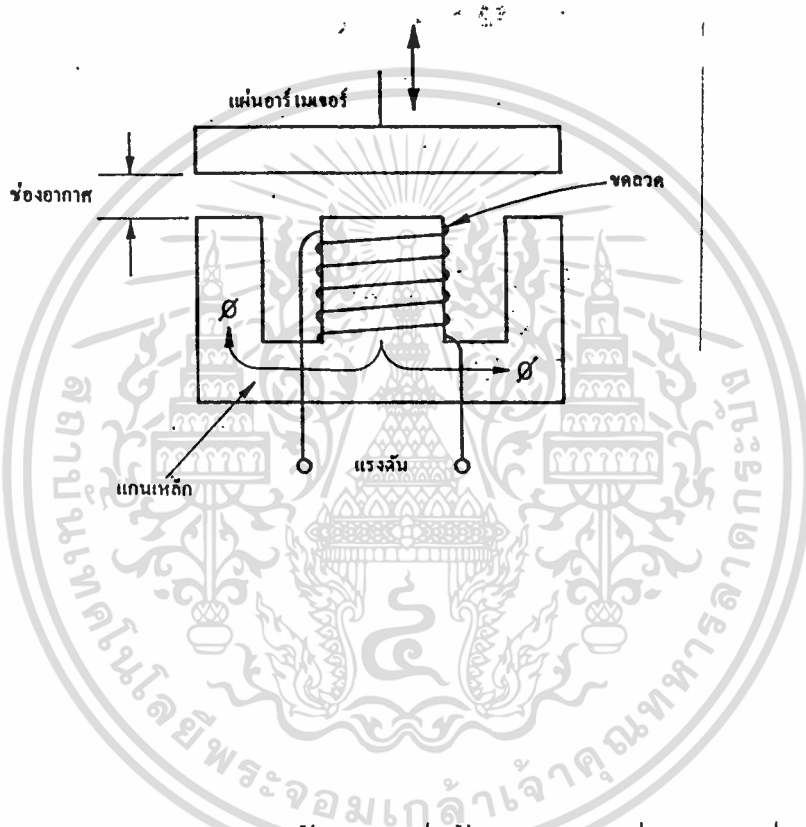


รูป 1.6 การใช้หลักการของตัวเก็บประจุ เพื่อวัดความชื้น

ทรานสดิวเซอร์แปรค่าความเหนียวน้ำเปลี่ยนแปลง

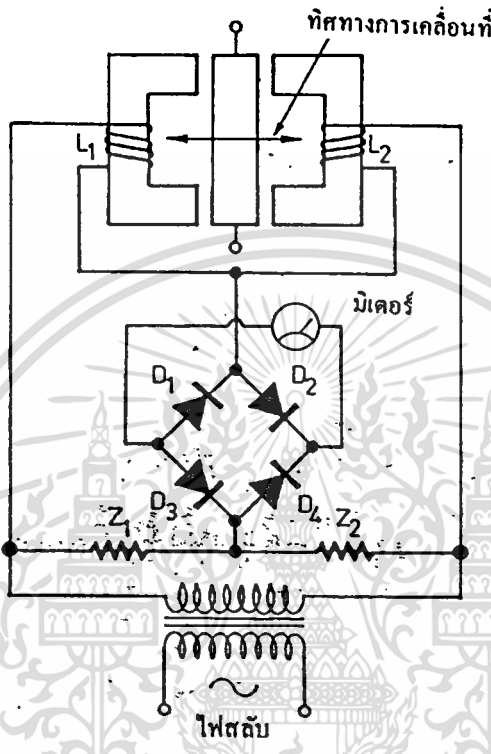
ในวงจรแม่เหล็กก็มีหลักการคำนวณ หรือพิจารณาคล้ายคลึงกับวงจรทางไฟฟ้า โดยมีความหนาแน่นเส้นแรง เปรียบเสมือนกระแสไฟฟ้า คาร์แอดแทนซ์ เปรียบเสมือนค่าความต้านทานในวงจร โดยมีค่า $N^2 I$ เสมือนเป็นแหล่งจ่ายเส้นแรงแม่เหล็ก คาร์แอดแทนซ์ของวงจรแม่เหล็กขึ้นอยู่กับ รูปร่างและชนิดของอุปกรณ์นำมาใช้ และผลในการเปลี่ยนแปลงค่าคาร์แอดแทนซ์ในวงจรแม่เหล็กเองจะทำให้ค่าความเหนียวน้ำ หรือค่า L เกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

จากรูป 1.7 เส้นทางเดินของแรงแม่เหล็กจะแยกเป็นวงรอบสองข้างผ่านช่องอากาศถ้าให้ขนาดความกว้างของช่องอากาศมาก คาร์แอดแทนซ์จะมีค่าสูง ส่วนค่าความเหนียวน้ำหรือค่าอินดักแตนซ์จะมีค่าลดลง เราอาศัยหลักการเปลี่ยนแปลงของค่าอินดักแตนซ์เป็นหลักในการทำทรานสดิวเซอร์



รูป 1.7 แสดงลักษณะของทรานส์ฟอรม์เซอร์ที่ใช้ค่าความเหนี่ยวนำเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงทางค่าความเหนี่ยวนำแสดงให้เห็นดังรูป 1.8 โดยอาศัยหลักการของวงจรบริดจ์ชนิดไฟสลับ การสมมูลของบริดจ์เกิดขึ้นเมื่อค่า L_1/L_2 และ Z_1/Z_2 มีค่าเท่ากัน ส่วนการสมมูลของบริดจ์เราใช้ไดโอดสี่ตัว ทำการเรกติไฟร์ให้เป็น V_{avg} แล้วนำมาเป็นตัวตรวจสอบ



รูป 1.8 การใช้ทรานส์ดิวเซอร์ชนิดความเหนียวนำเปลี่ยนไปในการตรวจสอบการเคลื่อนที่

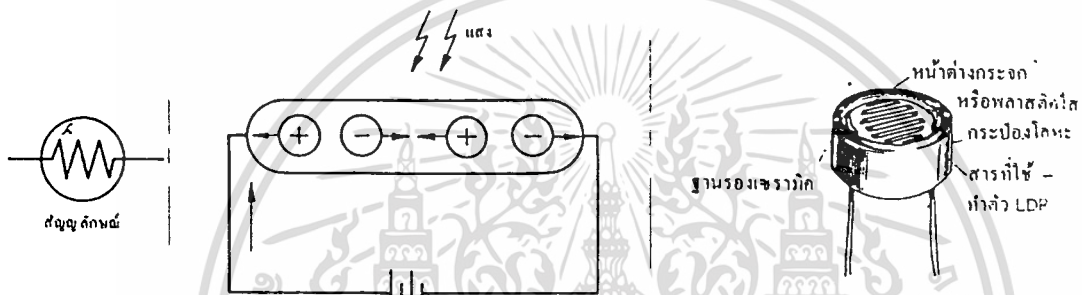
เราใช้หลักการในการวัดความแรงของรถยนต์ เครื่องบิน ฯลฯ ด้วยการใช้หลักการเคลื่อนที่ของอามเพอร์แกนกลาง และหลักการแปลงค่าความเหนียว นำสามารถนำมาใช้ตรวจสอบการไหลของกระแส เป็นต้น

ออฟโตทรานส์ดิวเซอร์ (OPTO TRANSDUCER)

ปฏิกิริยาที่แสงตกกระทบต่อหน้าผิวสารกึ่งตัวนำบางชนิด ทำให้คุณสมบัติเดิม เปลี่ยนไปอุปกรณ์หลักขณะการทำงานขึ้นกับเงื่อนไขของแสง มีหลายชนิดดังต่อไปนี้



ตัวต้านทานไวแสง หรือ LDR (LIGHT DEPENDENT RESISTER) หรือค่าความต้านทานที่แปรค่าตามแสง โดยเมื่อบอณพลังงานอย่างเพียงพอให้กับ วาเลนซ์อิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำจะทำให้เกิดการแตกตัวของ โสลและอิเล็กตรอนเกิดขึ้นมากมาย พลังงานทำให้ โสลและอิเล็กตรอนแตกตัวขึ้นจะต้องเป็นพลังงานที่มาจากภายนอก เช่น แสง ความร้อนปริมาณของพลังงานที่ต้องการทำให้เกิดการแตกตัวของ โสลและอิเล็กตรอน จะขึ้นอยู่กับสารนั้น ๆ

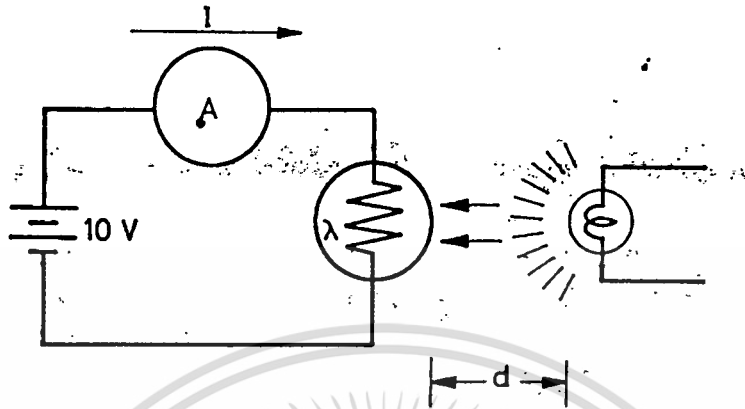


LDR ส่วนใหญ่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำจำพวกแคดเมียมซัลไฟด์ หรือแคดเมียมเซเลไนด์ซึ่งให้ผลตอบสนองต่อแสงได้ ที่ความยาวคลื่นประมาณ 4000-10000 Å ซึ่งเป็นแถบความถี่แสงมองเห็น

ลักษณะการทำงานจะเห็นได้ว่า เมื่อแสงมีความเข้มมากขึ้น มาตกกระทบก็จะทำให้ตัวมันสามารถนำกระแสได้มากขึ้นเป็นผลทำให้ค่าความต้านทานในตัวมันลดลง

ข้อดีในการใช้งานของ LDR คือ มีความไวต่อแสงสูง ราคาถูก มีขนาดเล็กมีการเปลี่ยนแปลงค่าได้กว้าง ข้อเสียเมื่อเทียบกับอุปกรณ์รับแสงอื่น ๆ คือ มีผลตอบสนองต่อความถี่แสงแคบ

ตัวอย่างการใช้งานของ LDR อย่างง่าย ๆ คือ ใช้เป็นตัววัดความเข้มของแสง โดยต่อเป็นวงจรเบืองต้นง่าย ๆ ดังรูป 1.10

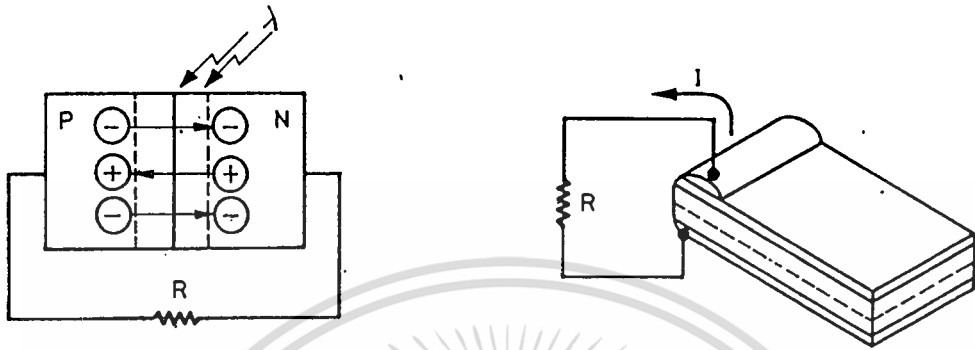


รูป 1.10 ตัวอย่างวงจรวัดความเข้มของแสง

เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างแรงดันตรงขึ้น ซึ่งก็คืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำ P-N ที่ประกอบเป็นรอยต่อ และเมื่อประกอบเป็นวงจรรักไม่จำเป็นจะต้องต่อกับแหล่งจ่ายไฟภายนอก และจะมีกระแสไหลผ่านวงจรได้เอง สารกึ่งตัวนำที่ใช้ทำเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่เป็นสารจำพวก ซิลิกอน หรือ เซเลเนียม เป็นส่วนใหญ่ สำหรับสารเซเลเนียมแล้วจะให้ผลตอบสนองต่อแสงที่ตาเรามองเห็นได้ ส่วนซิลิกอนจะให้ผลตอบสนองค่อนข้างไปทางอินฟราเรด ดังนั้น เซลล์แสงอาทิตย์จึงเหมาะที่จะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟตรงได้

หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ คือเมื่อได้รับแสงจะทำให้โซลและอิเล็กตรอนแยกตัวออกจากกันถ้าหากเป็นการแยกที่เกิดทางด้านสารชนิด P อิเล็กตรอนอิสระที่เกิดขึ้นก็จะเคลื่อนกลับเข้าทาง N ถ้าหากเกิดการแตกตัวที่ผิว N ตัวโซลก็จะเคลื่อนเข้าทางผิว P จะเห็นได้ว่าเกิดการเคลื่อนที่ของพาหะ เป็นผลทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมตัวมัน เมื่อต่อครบวงจรก็จะเกิดกระแสไหลขึ้นได้

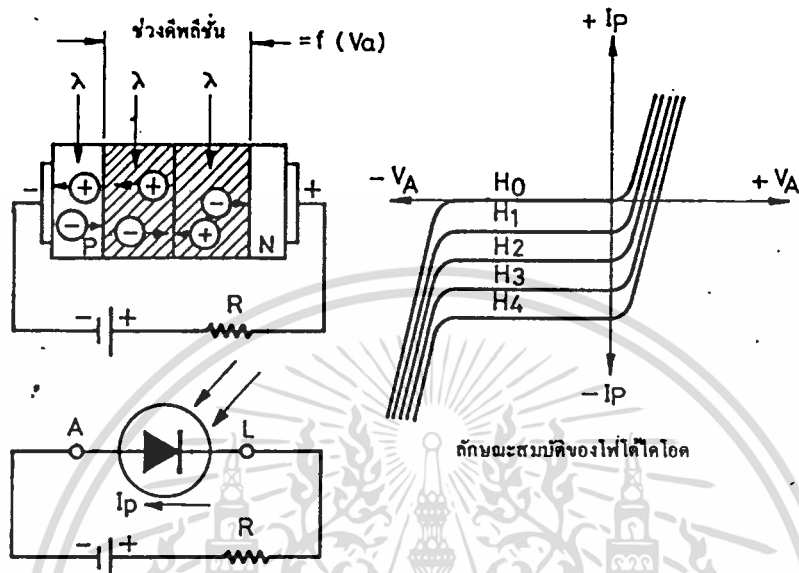
สำหรับสารชนิด เซเลเนียมจะให้ผลตอบสนองต่อแสงในช่วงความยาวคลื่น 2500 ถึง 7500 Å สำหรับซิลิกอนจะอยู่ในราว 3500 ถึง 11500 Å



รูป 1.11 โครงสร้างและการทำงานของ เซลล์แสงอาทิตย์

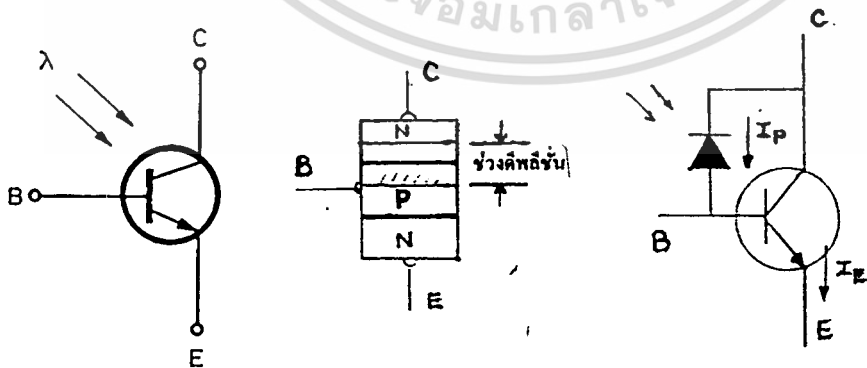
โฟโตไดโอด เป็นอุปกรณ์ไวแสงชนิดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยรอยต่อ P-N เช่นเดียวกับเซลล์แสงอาทิตย์ แต่มีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันคือ การใช้งานของ โฟโตไดโอดจะให้กระแสไหลผ่านตัวมันขึ้นอยู่กับแสง เมื่อโฟโตไดโอดชนิดซิลิกอนถูกไบอัสกลับด้วยแรงดันค่าหนึ่งและมีแสงส่องไปทับบริเวณรอยต่อถ้าแสงทั้งสองมีความยาวคลื่นพอเหมาะจะมีกระแสไหลในวงจร โดยเป็นสัดส่วนกับ ความเข้มของแสงทั้งสองผ่านบนอุปกรณ์นี้ลักษณะทั่วไปของไบอัสตรงจะยังคงเหมือนกับไดโอดธรรมดา คือให้กระแสไหลผ่านตัวมันเองได้ การทำงานของโฟโตไดโอดกล่าวได้ดังนี้ เมื่อแสงตกกระทบบริเวณรอยต่อจะทำให้เกิดการแตกตัวของ โสเดและอิเล็กตรอนอิสระ โสเดและอิเล็กตรอนอิสระจะถูกแรงดันไบอัสกลับเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไหลข้ามรอยต่อเป็นกระแสเนื่องจากแสงได้ โดยปกติค่ากระแสเนื่องจากแสงมีค่าค่อนข้างต่ำมาก อยู่ในช่วง 1-10 μA เท่านั้นดังนั้นการใช้งานของโฟโตไดโอดจะต้องมีตัวขยายกระแสเพิ่มเติม

ไดโอดที่ไวต่อแสงชนิดซิลิกอนมีสมบัติพิเศษของการเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิค่า และผลตอบสนองต่อแสงไว นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมผลตอบสนองต่อความถี่ของแสงและความเร็วได้โดยรูปร่างลักษณะและการได้บของรอยต่อ



รูป 1.12 แสดงการทำงานและลักษณะสมบัติของ โฟโต้ไดโอด

โฟโตทรานซิสเตอร์ อาศัยหลักการเดียวกับโฟโต้ไดโอด แต่โฟโตทรานซิสเตอร์ให้ข้อดีกว่า โฟโต้ไดโอดมากทั้งนี้เพราะว่ากระแสที่ได้จะผ่านการขยายด้วยทรานซิสเตอร์ก่อนในภาวะปกติของการใช้งานของ โฟโตทรานซิสเตอร์ รอยต่อระหว่างเบส และ อิมิตเตอร์จะต่อ ไปยังตรงส่วนรอยต่อระหว่าง เบส-คอลเลคเตอร์ จะต่อ ไปยังสลับหรือรอยต่อเอง เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแปรค่ากระแสให้กับแสง



รูป 1.13 แสดงสัญลักษณ์ โครงสร้างของ โฟโตทรานซิสเตอร์

เมื่อไบอัสกลบหรือรอยต่อระหว่าง เบส-คอลเลคเตอร์ และมีแสงฉายมาที่บริเวณ รอยต่อ กระแสเบสจะถอยขยาย ด้วยอัตราขยายด้วยทรานซิสเตอร์ เป็นกระแสอิมิตเตอร์ และถ้าไบอัสขั้วเบสด้วยกระแสเบสภายนอกก็จะถอยขยายรวมกับกระแสเนื่องจากแสงด้วย

ถ้าให้

$$I_p = \text{กระแสที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสง}$$

$$I_B = \text{กระแสมาจากภายนอก}$$

$$I_E = \text{กระแสอิมิตเตอร์}$$

$$hFE = \text{อัตราขยายของทรานซิสเตอร์}$$

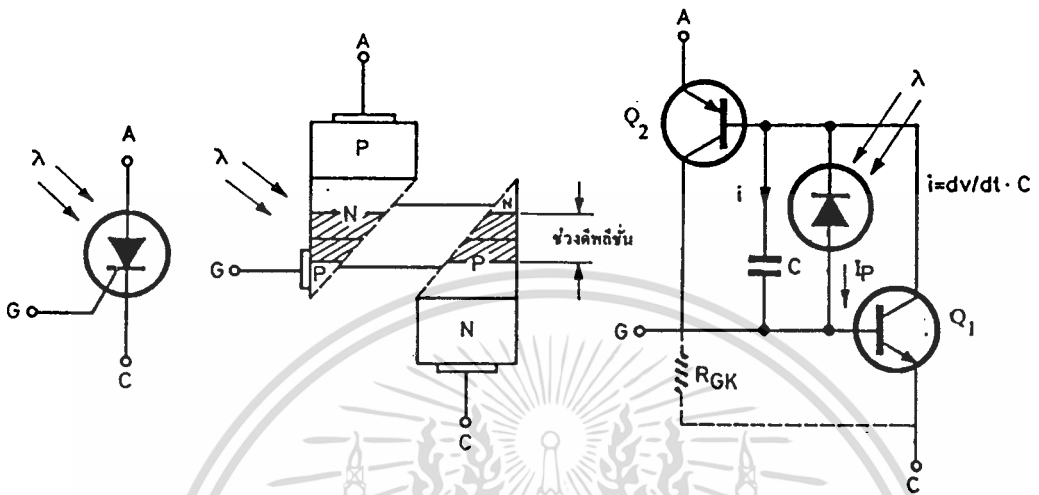
จากสมการของทรานซิสเตอร์ $I_C = hFE \cdot I_B$ และ $I_E = I_C + (I_B + I_p)$

จะได้ $I_E = I_B(hFE + 1) + I_p \approx hFE(I_B + I_p)$

จะเห็นได้ว่ากระแส I_E เปลี่ยนแปลงตามกระแส I_p ด้วยอัตราขยายถึง $hFE + 1$ ซึ่งถ้า I_p มีค่าเปลี่ยนแปลงจาก 1 ถึง 10 μA และให้ hFE มีค่าประมาณ 100 เราจะได้ค่า I_E เปลี่ยนแปลงจาก 100 μA ถึง 1 mA

ถ้าอัตราขยายยิ่งสูง จะทำให้ผลตอบสนองต่อแสงไวขึ้น ค่า hFE สูง ๆ จะ ต้องทำให้รอยต่อเบส-คอลเลคเตอร์มีพื้นที่มากขึ้น แต่ก็ทำให้กระแสรั่วไหลสูงขึ้นด้วย เพราะ รอยต่อจะถูกไบอัสกลับ

โฟโตไดโอดเอซิสซอร์ จากวงจรสมมูลย์ของ โฟโตไดโอดเอซิสซอร์จะเห็นได้ว่าคล้ายกับวง จรสมมูลย์ของ ไดโอดธรรมดาแต่จะมีโฟโตไดโอดต่อที่เบสของทรานซิสเตอร์ Q2 ดังนั้น ถ้ามีการหักเหของแสง โฟโตไดโอดเอซิสซอร์มันก็จะนำกระแสได้ด้วยหลักการทั่วไปของ ไดโอดเอซิสซอร์ แต่ถ้า หากไม่มีการหักเหแสงแต่เรานำตัวเอซิสซอร์ให้ถูกแสงสว่างก็จะเป็นเช่นนี้ ทำให้ เกิด กระแส I_p ขึ้นและถ้ากระแส I_p มีค่ามากขึ้นถึงค่าหนึ่งพอเพียงจะทำให้ Q1 ทำงานมัน ก็เสมือนเป็นการหักเหแสงให้ทำงาน เกิดภาวะการรีเจนเนอเรทีฟให้เอซิสซอร์นำกระแส ได้



รูป 1.14 โครงสร้างและวงจรสมมูลของ โฟโตเอสซอาร์ทแทนด้วยทรานซิสเตอร์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสง

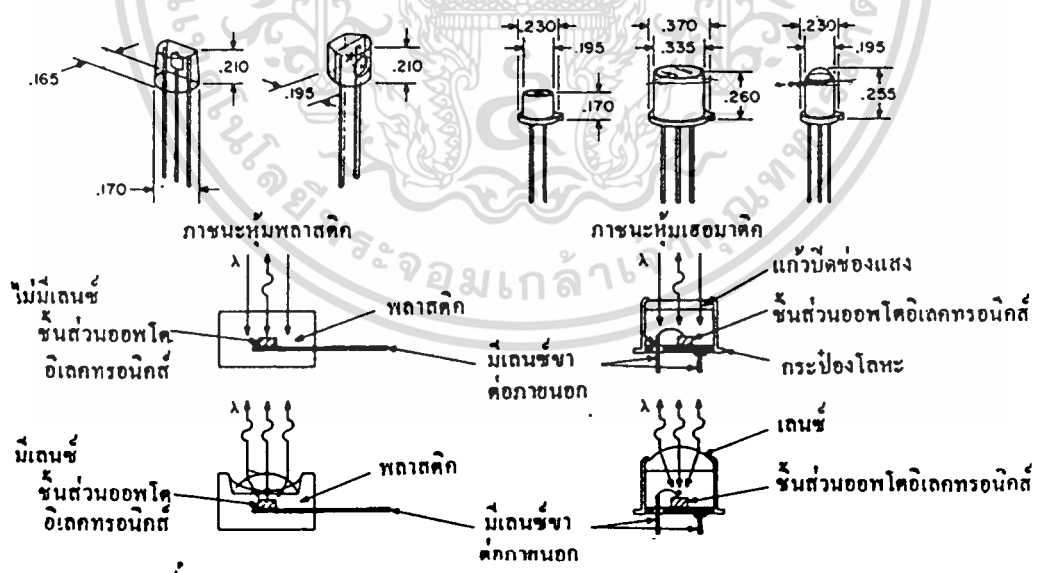
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงมีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการใช้งาน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

1. อุปกรณ์เป็นตัวอิสระ เช่น ตัวปล่อยแสง หรือ ตัวตัดแสง
2. อุปกรณ์ตรวจสอบการตัดแสง และการสะท้อนแสง ซึ่งจะตรวจวัดค่าต่างๆ

โดยควบคุมทิศทางของแสง

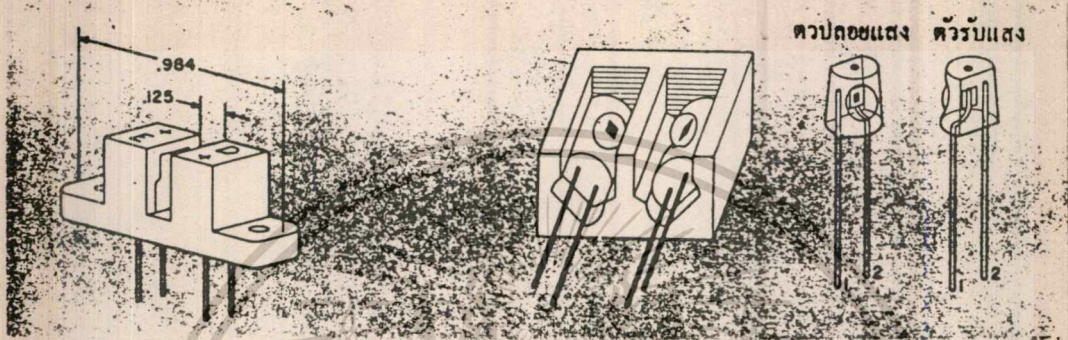
3. อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสง ซึ่งจะส่งผ่านสัญญาณไฟฟ้าโดยตรง ไม่ต้องมีสายไฟเชื่อมโยง

1. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงที่เป็นตัวอิสระที่จะปล่อยแสง หรือจะตัดแสง ภาชนะหุ้มต้องทำหน้าที่ป้องกันชั้นส่วนภายใน และยอมให้แสงผ่านไปได้ นั่นคือตัวประกอบหุ้มต้องมีช่องแสง ช่องแสงอาจมีเลนส์เป็นส่วนประกอบซึ่งทำให้ผลตอบสนองต่อความไวและมุมรับแสงได้กว้าง การกระจายของแสงลดลง เลนส์เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์จึงต้องพิจารณาการใช้เลนส์ด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงของเลนส์จะมีผลต่อตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางแสงอย่างมาก ดังนั้นถ้าต้องการอุปกรณ์ที่มีอัตราขยายสูงจึงควรใช้อุปกรณ์หุ้มเลนส์ภายนอกแทน



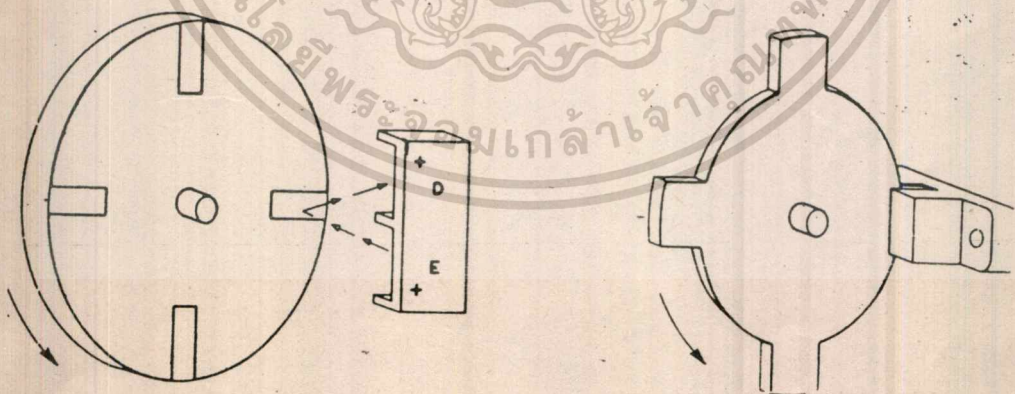
รูป 1.15 แสดงรูปร่างโครงสร้างของอุปกรณ์ปล่อยแสงและตัวตัดแสง

สารที่ใช้ทำภาชนะหุ้ม 2 ชั้น คือพลาสติกและเซรามิค หงสองแบบมีทั้งชนิดมี
 เส้นสและไม่มีเส้นสจะขนานกับขากภายนอก ชนิดเซรามิคสามารถได้กำลังสูงๆ ช่วงอุณหภูมิ
 กว้าง ราคาแพงกว่าแบบพลาสติก



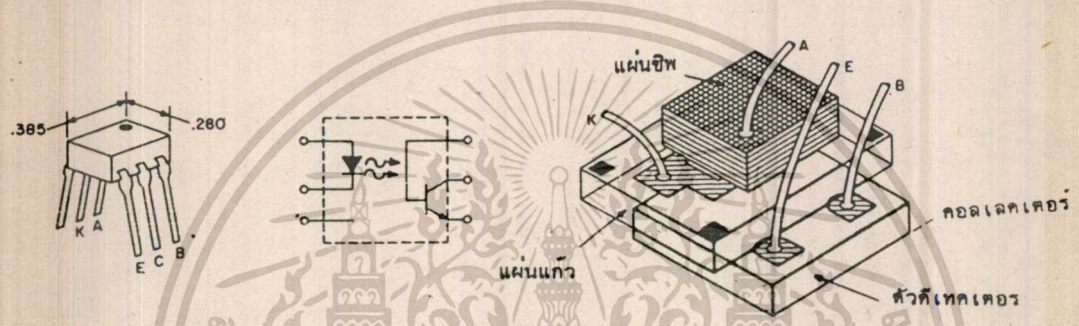
รูป 1.16 อุปกรณ์ตรวจสอบการสะท้อน สร้างขึ้นจากตัวรับแสงและตัวลอยแสง

2 อุปกรณ์ตรวจสอบการตัดแสงและการสะท้อนของแสง อุปกรณ์ตรวจสอบการ
 ตัดแสงส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นจาก ตัวลอยแสงและตัวรับแสงแบบพลาสติก เพราะมีราคา
 ถูกและประกอบได้ง่ายส่วนการสะท้อนแสงจะต้องให้แสงพุ่ง เป็นสั สะท้อนกลับมายังตัวรับ
 แสง ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ชนิดมีเส้นส เพื่อหา ให้การทางวนดขย



รูป 1.17 ตัวอย่างการใช้อุปกรณ์สะท้อนแสงและการตัดแสงสำหรับวัดความเร็วของเพลลา

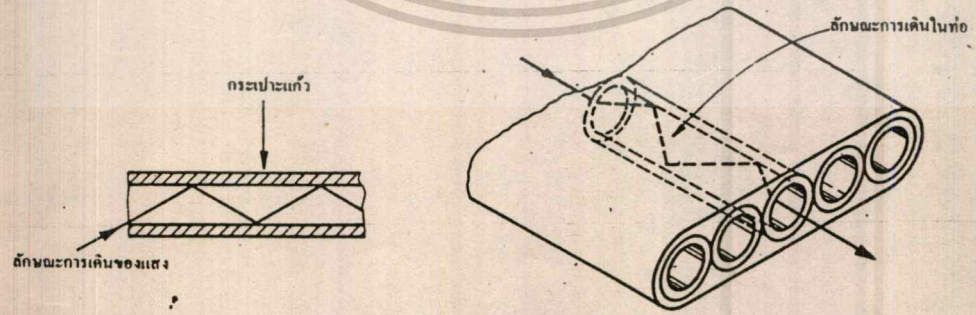
3 การเชื่อมต่อด้วยแสง อุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสงหรือเรียกว่า ออปโตไอโซเลเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วน หนึ่งที่ทางการเคลื่อนที่ของแสงจะคงอยู่ในตัวอุปกรณ์ใช้ เปลี่ยนสัญญาณทาง ไฟฟ้าให้เป็นแสง และจากแสงให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โดยไม่ต้องมีสายเชื่อม โยงระหว่างวงจร แรงดันระหว่างอุปกรณ์สองข้างคือตัวปล่อยแสงและตัวรับแสงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะระหว่างตัวปล่อยแสง และตัวรับแสงระยะยิ่งห่างกันมากอัตราการส่งผ่านสัญญาณจะน้อย



รูป 1.18 แสดงอุปกรณ์เชื่อมต่อด้วยแสงและสัญญาณ

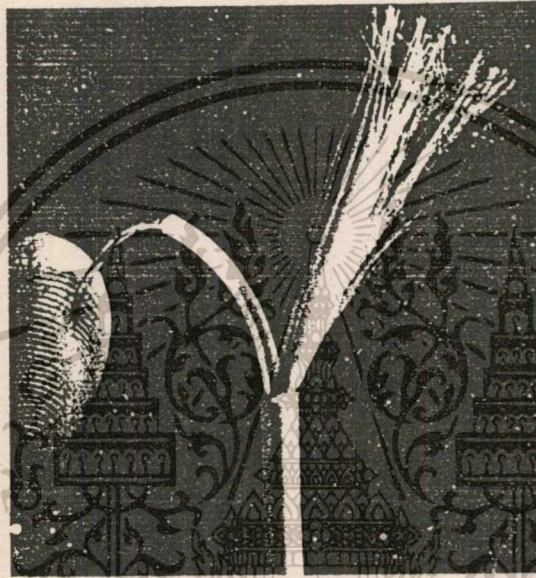
ไฟเบอร์ออปติก

เราสามารถสร้างท่อเส้นใยเล็ก ๆ ที่ให้แสงเดินทางไปได้ เสมือนวิ่งไปในสายไฟฟ้าที่มีการตัดเศวตได้เหมือนกัน ลักษณะพิเศษของการใช้แสงเดินทางไปในท่อ ทำให้เกิดการสื่อสารด้วยส่งผ่านช่องทาง ลักษณะของไฟเบอร์ออปติกและการใช้งาน จะเป็นดังนี้



รูป 1.19 ไฟเบอร์ออปติก

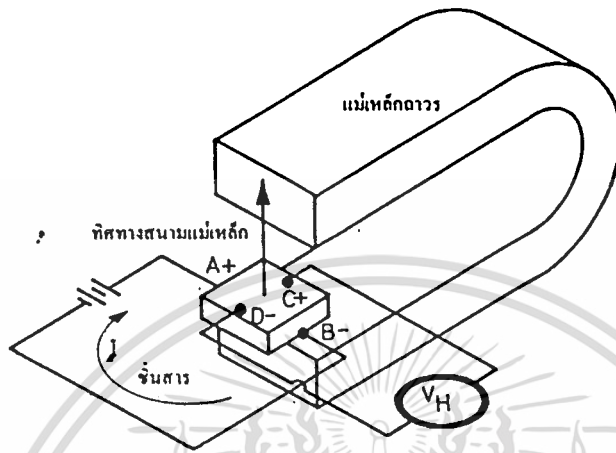
การเคลื่อนที่ของแสงผ่านไฟเบอร์ออปติกไปในทางตรงเดียวได้อาศัย หลักการสะท้อนของแสงผ่านผนังในสายไฟเบอร์ออปติกที่เคลื่อนที่ตามสายได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงประยุกต์ใช้งานของไฟเบอร์ออปติกในด้านการสื่อสาร ฯลฯ เราใช้ไฟเบอร์ออปติกเป็นท่อส่งสัญญาณแสงไปยังจุดที่แตกต่าง ๆ หรือรับสัญญาณแสงจากหนึ่งไปยังอีกหนึ่ง



รูป 1.20 ตัวอย่างไฟเบอร์ออปติก

ทรานสดิวเซอร์ที่ใช้หลักการของโซลล์เอฟเฟค

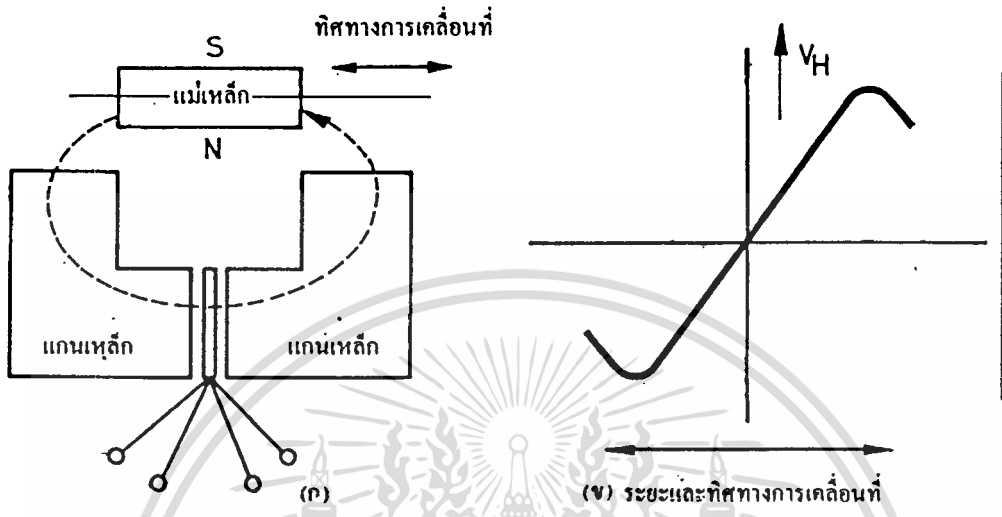
การนำหลักการของโซลล์เอฟเฟคมาใช้ประโยชน์ เกิดขึ้นหลังจากที่เรานำเอาสารกึ่งตัวนำมาใช้เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หลักการของโซลล์เอฟเฟคกล่าวได้ดังนี้



รูป 1.21

เพื่อหาชนิดสารต้องทำการทำเป็นทรานซิสเตอร์วางตั้งฉากกับทิศทางของสนามแม่เหล็ก ครั้นต่อชนิดสารเข้ากับวงจรไฟฟ้า โดยให้ด้าน A ต่อเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่ ด้าน B ต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่ กระแส I และสนามแม่เหล็ก H จะไหลข้ามกันเป็นผลเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าฮอลล์ (HALL VOLTAGE) ขึ้นระหว่างขั้ว C และ D ของแผ่นชนิดสาร ทิศทางของแรงดันเหนี่ยวนำจะเป็นไปตามกฎของการเหนี่ยวนำ โดยมีขั้วบวกอยู่ทางขั้ว C และขั้วลบอยู่ทางขั้ว D

เราอาศัยหลักการของฮอลล์ไปใช้ประโยชน์ในเครื่องมือหลายอย่าง หงนกถ้าพิจารณาหลักการจะเห็นว่าถ้าให้ค่ากระแส I เป็นค่ากระแสคงที่ แรงดัน V_H ที่เกิดขึ้นจะแปรค่าตามสนามแม่เหล็ก เราจึงนำเอาหลักการนี้ไปใช้ในการวัดความเข้มของสนามแม่เหล็ก โดยใช้วิธีทำแผ่นสารให้บางมากแล้วสอดเข้าไปในส่วนของทางเดินสนามแม่เหล็ก จากหลักการนี้เราประยุกต์ใช้เป็นทรานซิสเตอร์วัดได้อย่างอื่นได้ ดังตัวอย่างรูป 1.22



รูป 1.22 ใช้หลักการฮอลล์เอฟเฟคในการวัดระยะการเคลื่อนที่

ในกรณีที่เราเอาแม่เหล็กวางยึดติดกับอุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนที่ โดยให้ทิศทาง
 การเคลื่อนที่ตามแนวทแยงไว้ในรูปบน ผลของการเคลื่อนที่จะทำให้สนามแม่เหล็ก เกิด
 การเปลี่ยนแปลงซึ่งยังผลทำให้เกิดแรงดัน V_H ตามรูป ข

อุปกรณ์เช่น เซอร์ อุปกรณ์ทรานส์มิชเชอร์ อุปกรณ์ดีเทคเตอร์ หรืออุปกรณ์ตรวจ
จับสัญญาณ ในระบบรักษาความปลอดภัยนั้นสามารถนำอุปกรณ์ที่ใดก็ตามมาแล้วข้างต้นมา
ประยุกต์ใช้กับระบบรักษาความปลอดภัยได้ ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีจะต้องมีความแม่น-
ยำ ตอบสนองได้ดี มีละอุนแล้วระบบจะทำงานผิดพลาดได้ ส่วนใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัย
ได้แบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้

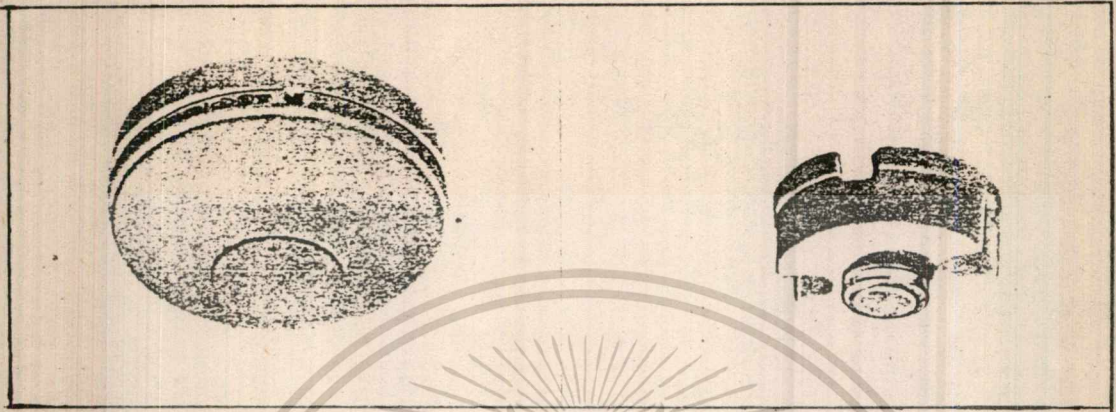
- 1 ระบบแจ้งสัญญาณและป้องกันอัคคีภัย
- 2 ระบบแจ้งสัญญาณและป้องกันผู้บุกรุก
- 3 ระบบแจ้งสัญญาณและป้องกันวงจรทางไฟฟ้า

๑๑๑

อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ เพื่อป้องกันอัคคีภัยสามารถให้ผลในการป้องกันได้เป็น
อย่างดีการป้องกันในกรณีนี้จะใช้อุปกรณ์ดีเทคเตอร์สองแบบด้วยกันคือ อุปกรณ์ดีเทคความ
ร้อน และ อุปกรณ์ดีเทคควัน

อุปกรณ์ดีเทคความร้อน (HEAT DETECTOR)

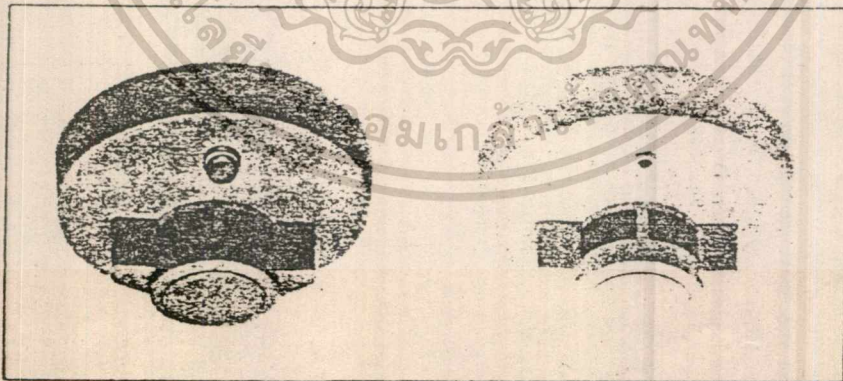
อุปกรณ์ดีเทคความร้อนมี 2 หลักการคือ หลักการแรกจะเป็นตัวตรวจจับอุณหภูมิ
สูงซึ่งจะทำงานเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมมาถึงช่วงหนึ่ง เช่น 135 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ
ปรับตัวอุณหภูมิได้ธรรมดาตัวตรวจจับเหล่านี้จะเป็นแบบ N/O การติดตั้งจะติดตั้งตามใต้ฝ้า
เพดานในตำแหน่งที่คิดว่าการตรวจจับไฟไหม้ได้ดีที่สุด พบที่ในการตรวจจับตลอดอุปกรณ์ตรวจ
จับจะไม่เกิน 900 ตารางฟุตส่วนแบบที่สองของอุปกรณ์ดีเทคความร้อนเป็นแบบตรวจจับ
อุณหภูมิคงที่เหมือนแบบแรก รวมกับการตรวจจับอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ กล่าวคือถ้า
อัตราการเพิ่มของอุณหภูมิรวดเร็วถึงขนาด 5 องศาฟาเรนไฮต์ต่อ 20 วินาที แล้วตัวตรวจ
จับจะทำงานทันที การติดตั้งก็เช่นเดียวกันคือ ใต้ฝ้าเพดานหันหัวลง



รูป 1.23 ตัวอย่างของอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความร้อนแบบต่าง ๆ

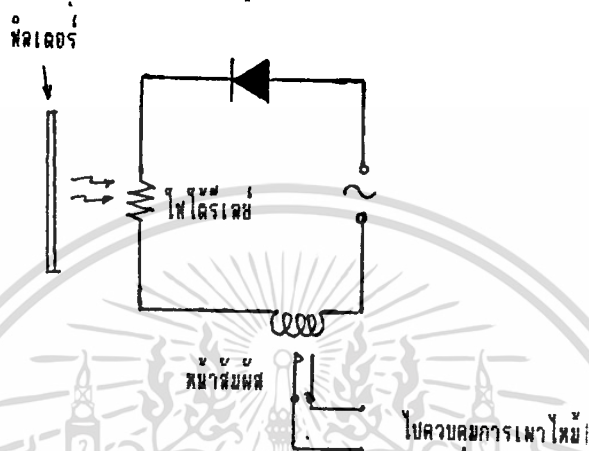
อุปกรณ์ตรวจจับควัน (SMOKE DETECTOR)

อุปกรณ์ตรวจจับควัน เป็นหย่อมรูปก้นแฉวยว้า ขณะที่เกิดเพลิงไหม้ ควันเป็นสิ่งที่หนีงท
 เกิดขึ้นและมีจำนวนมาก ฉะนั้นถ้าเราตรวจสอบตัวมันจะเป็นเหตุให้เราทราบล่วงหน้าก่อน
 ภารตตรวจจับความร้อน อุปกรณ์ตรวจจับควันที่ขายกันมสองแบบคือ ใช้หลักการไฟฟ้ไอโอเลคทริก
 และแบบไอไอโนเซชัน (ใช้สารกัมมันตรังสี)



รูป 1.24 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบต่าง ๆ

การตัดเหตควัน หรือเปลวเพลิงนี้อาจตัดแปลงลักษณะการตัดเหตเป็น การตัดเหต ลักษณะของเปลวเพลิงหรือความร้อนในเตาเผาก็ได้ วงจรในรูป 1.25 เป็นวิธีการนำไฟ- ฟ้าได้รเลยตรวจสอบความร้อนในเตาเผาโดยดูจากแสงที่ผ่านตัวกรองระดับต่างๆ เข้ามา

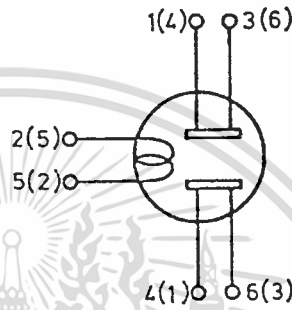
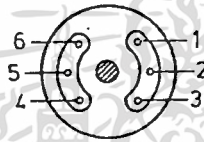


รูป 1.25 การใช้ไฟโตรีเดย์ควบคุมการเผาไหม้ในเตาเผา

ในระบบของกันออกคดียัง จึงใช้อุปกรณ์ตัดความร้อน และอุปกรณ์ตัดเหตควันทำ งานร่วมกัน และในระบบของกันออกคดียัง สามารถป้องกันแหล่งที่อาจทำให้เกิดออกคดียได้ ตัวอย่างแหล่งที่อาจทำให้เกิดออกคดียได้แก่ แหล่งสารเคมี แหล่งก๊าซ เป็นต้น

อุปกรณ์ตัดเหตควาน

วิธีการตัดเหตควานในปัจจุบันมีหลายวิธี เช่นใช้ท่อสารเคมี สีของสารภายในท่อ จะเปลี่ยนไปเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างก๊าซกับสารเคมีภายในท่อ วิธีนี้เหมาะกับการ ตรวจสอบเป็นครั้งคราวและใช้งานได้เพียงครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมีวิธีการใช้แสงอินฟรา เรดที่ใช้เครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ใช้เครื่องก๊าซโครมาโตกราฟี วิธีหลังนี้ให้ผลแน่นอน แต่ราคาสูง จึงเหมาะสมกับงานวิจัยหรืองานที่ต้องการค่าที่แน่นอน สำหรับวิธีที่จะกล่าวถึงนี้ ใช้สารกึ่งตัวนำที่ไวต่อก๊าซ คือมีสาร Ni แพร่อยู่บน SnO₂ เมื่อก๊าซชนิดที่ตรวจ (REDUCING) หรือก๊าซที่ลดไหม้มาปรากฏที่ผิวของสารกึ่งตัวนำ ความต้านทานของสารกึ่ง- ตัวนำจะลดลง วิธีนี้ให้ความไวสูง ราคาถูกใช้เป็นอุปกรณ์เตือนภัยได้ดี



รูป 1.26 รูปร่างและสัญลักษณ์ อุปกรณ์หลอดแก้ว

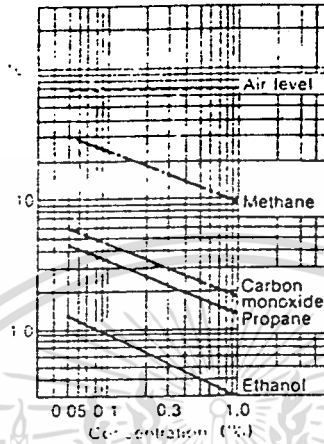
อุปกรณ์หลอดแก้ว จะใช้ทำเป็นเครื่องเตือนก๊าซจรัว (ก๊าซหัดไฟ)

หรือ เครื่องวัด คาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องเตือนไฟไหม้ (โดยตรวจจับก๊าซหัดไฟได้

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของควีน) เครื่องวัดอากาศเป็นพิษ เพราะอุปกรณ์มีความไวต่อก๊าซพิษ

เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ แอมโมเนีย ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ ไอของสารอินทรีย์

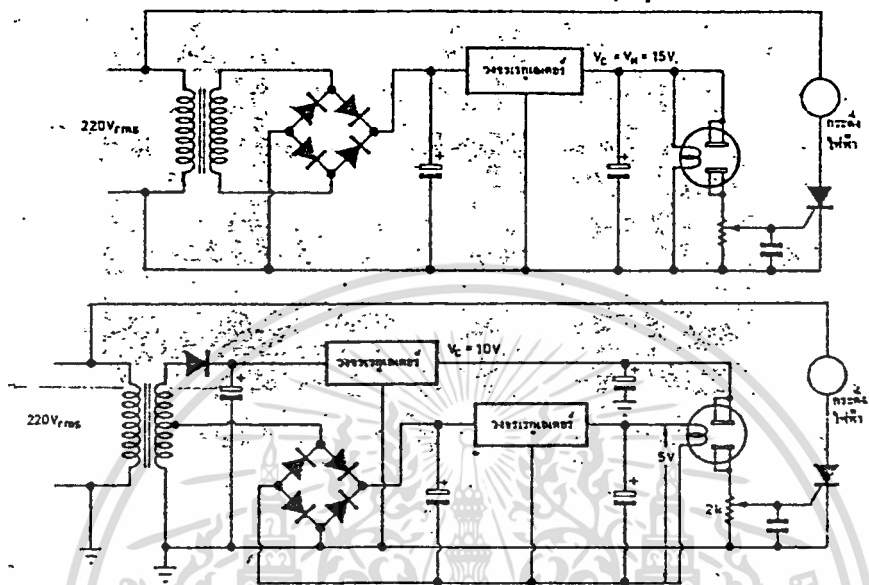
เช่น แอลกอฮอล์ เบนซิน มีเทน ก๊าซหุงต้ม เป็นต้น



รูป 1.27 แสดงกราฟความถ่วงหนาทดความเข้มข้นของก๊าซต่าง ๆ ของ TGS 812

กราฟที่แสดง เป็นกราฟแสดงความถ่วงหนาทดความเข้มข้นของสารกึ่งตัวนำ เบอร์ TGS 812 ที่ผลิตโดยบริษัทพิคาโร โดยพิจารณาที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน

ภายในตัวก๊าซที่ทดสอบแล้วความชื้นภายใน เพื่อขจัดความชื้นออก และทำให้การทำงานไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ และความชื้นภายนอก แรงดันที่บ่งบอกให้วัดความชื้นตลอดเวลา (VH) คือ 5 โวลต์ และหลอดจะดับกระแสปะมาณ 50 มิลลิแอมป์ ยกเว้นแต่ถ้าถ้าเก็บไว้นาน โดยไม่ได้ใช้งานเลย ในระยะแรกจะต้องเพิ่มแรงดันให้สูงกว่านี้เล็กน้อย นอกจากนั้นต้องบ่งบอกแรงดันไบอัสให้แก่สารกึ่งตัวนำ ทำหน้าที่ตรวจจับก๊าซ (Vc) ตลอดเวลาด้วยค่า Vc นี้จะต้องไม่มากกว่า 24 โวลต์ ตัวอย่างการต่อวงจรดังรูป 1.28 แรงดันที่ออกมาเป็นแรงดันคร่อม RL ความถ่วงหนาทดระหว่างสารกึ่งตัวนำทั้งสองภายในของอุปกรณ์ที่ตรวจจับชนิดนี้เรียกว่า Rs ซึ่งมีค่าลดลงเมื่อความเข้มข้นของก๊าซที่ทดสอบเพิ่มขึ้น เมื่อเปิดเครื่องให้ทำงานแล้วจะต้องคอยประมาณ 1 ถึง 2 นาที กว่าที่จะพร้อมที่จะทำงานได้ตามปกติ

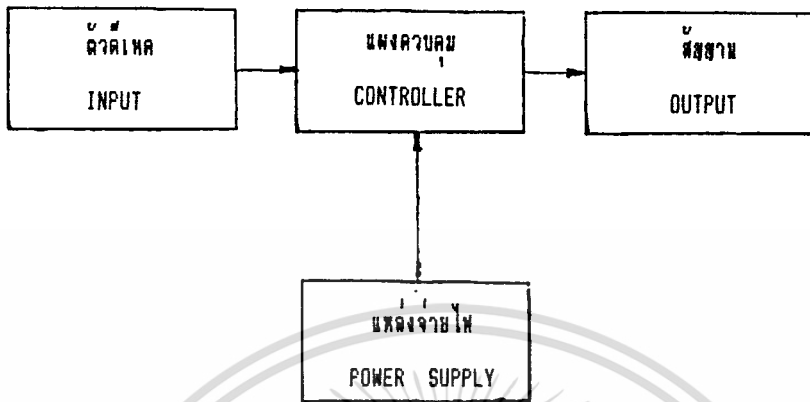


รูป 1.28 ตัวอย่างวงจรใช้งานของตัวตัดทิศทาง

รูป 1.28 เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่อง เตือนภัย ในทางปฏิบัติ เมื่อกำลังไฟ
 การตกจับเกิดขมุกมากเกินกว่าที่กำหนด แรงดันที่บ่อนพวน ไปเหนื โอมิเตอร์มายัง SCR
 จนมากพอ SCR ก็จะมีกระแสและทำให้กระแสไฟฟ้างได้ หรือนำไปต่อกับวงจรอื่นได้
 เราสามารถปรับระดับความเข้มของกำลังไฟที่จะทำให้กระแสไฟฟ้างได้ โดยการปรับ พอท
 แต่ก่อนปรับควรบ่อนไฟเข้าเครื่อง ให้นานพอสมควร เพื่อให้อุณหภูมิ และความชื้นภายใน
 ตัวของ มนตง ทกอน

การเตือนภัยจากผู้บกรุก

การบกรุกในหนนี้อาจจะหมายถึง ข โยบกรุกเข้ามาใจกรรมทรัพย์สิน การทำ
 งานของอุปกรณ์ตรวจจับตัวตัดทิศทางมีระบบป้องกันคล้ายคลึงกัน โดยระบบการทำงานของการ
 เตือนภัยจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังรูป 1.29



รูป 1.29 ไดอะแกรมระบบการเตือนภัย

อุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวตรวจจับหรือตัดเหตุนานหลายอย่างด้วยกันซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

สวิทช์แม่เหล็ก (MAGNETIC SWITCH) สวิทช์นี้เป็นสวิทช์ที่ติดตั้งง่าย มีความ

แน่นอนสูงแต่จะต้องใช้เป็นคู่ และมีทั้งชนิด NO และชนิด NC การติดตั้งจะติดส่วนหมแม่

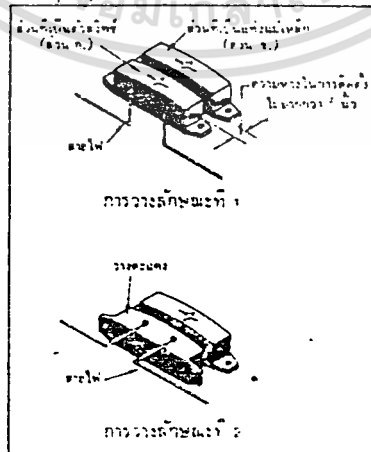
เหล็กเข้ากับส่วนที่เคลื่อนไหวได้เช่น ประตู หน้าต่าง เป็นต้น ส่วนตัวสวิทช์จะติดอยู่กับส่วน

คงที่ และต่อสายออกมา หากใช้ในการป้องกันผบกกรัก อาจต้องซ่อนสวิทช์เหล่านี้ไว้ ขณะที่

ทั้งสองส่วนประกอบใกล้กัน สวิทช์จะยกอำนาจแม่เหล็กกระทำอยู่ แต่ถ้าเมื่อไรชนส่วนแม่

เหล็กเคลื่อนออก สวิทช์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่ง ส่งงานไปที่แผงควบคุมทันที ตัวอย่างสวิทช์ชนิด

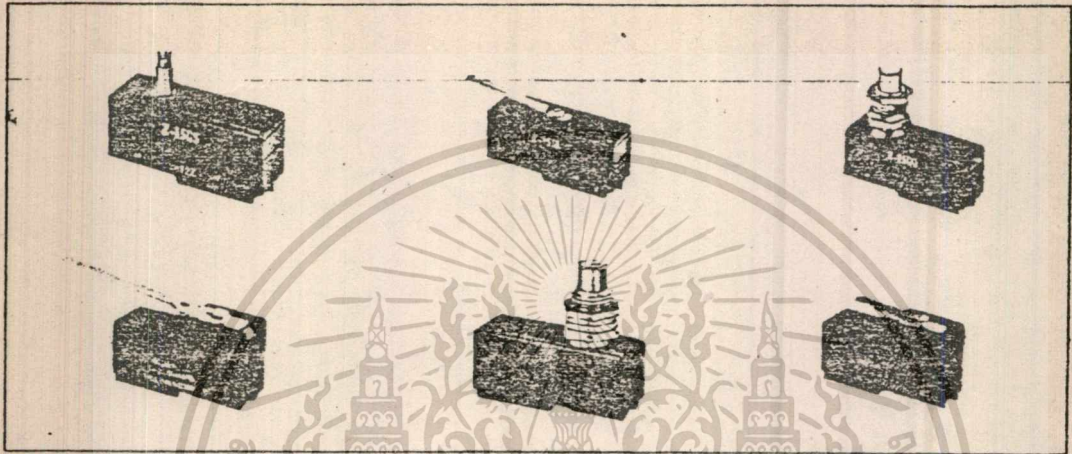
นี้และวิธีการติดตั้งแสดงไว้ดังรูป 1.30



รูป 1.30 ตัวอย่างของ สวิทช์แม่เหล็ก

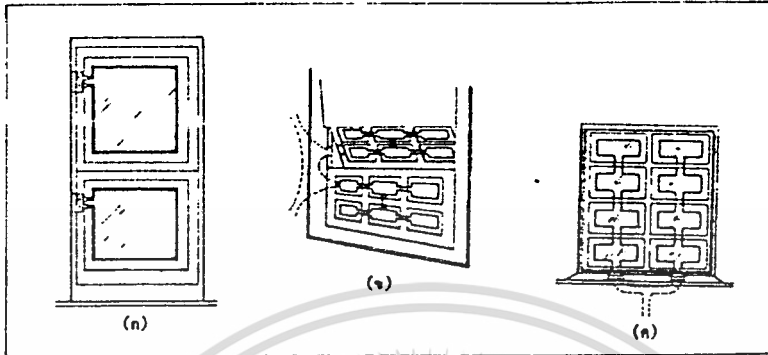
ไมโครสวิตช์ (MICRO SWITCH) สวิตช์ชนิดนี้ได้รับการออกแบบ มาให้ใช้งาน

เฉพาะอย่าง รูปร่างของไมโครสวิตช์มีแตกต่างกันไปตามสถานการณ์การใช้ การติดตั้งไมโครสวิตช์จะต้องระมัดระวัง เพราะส่วนของแรงกดอาจทำให้สวิตช์แตกได้



รูป 1.31 ตัวอย่างของไมโครสวิตช์แบบต่าง ๆ

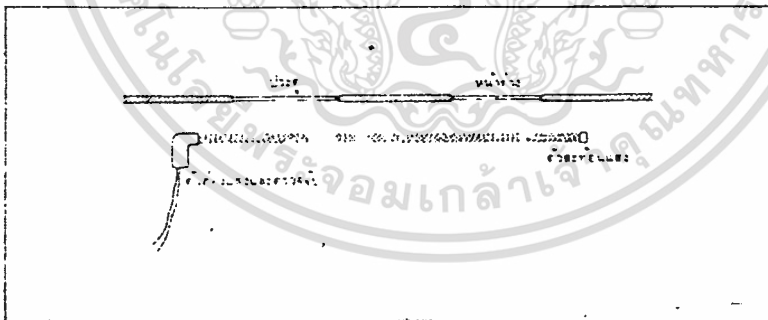
อลูมิเนียมฟอยล์ (ALUMINIUM FOIL) ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ เป็นวัสดุหน้าไฟฟ้า เวลาใช้ให้นำเอาแถบอลูมิเนียมฟอยล์บาง ๆ ตัดไว้ตามวัสดุบางอย่างที่แตกหักง่าย เช่น กระดาษหน้าต่าง แล้วแต่งให้สวยงาม การตัดอลูมิเนียมฟอยล์อาจตัดไว้กับชิ้นส่วนเครื่อง ไฟฟ้า เครื่องจักร ฯลฯ ได้ ถ้าเกิดการแตกหักก็ให้วงจรเตือนภัยทำงานทันที แต่วัสดุตัดไว้จะ ต้องเป็นฉนวน



รูป 1.32 การใช้ลুমเนียมฟอสฟอไรต์ติดตั้งเข้ากับหน้าต่างแบบต่างๆ กัน

ตัวตรวจจับใช้แสง (PHOTOELECTRIC SENSOR) ตัวตรวจจับแบบนี้เป็นตัว

ประกอบระบบให้สมบูรณ์ โดยใช้ตัวรับและตัวส่งตั้งหกล้าวมาแล้ว การใช้แสงนี้อาจรวมไปถึงการใช้แสงอินฟราเรดก็ได้



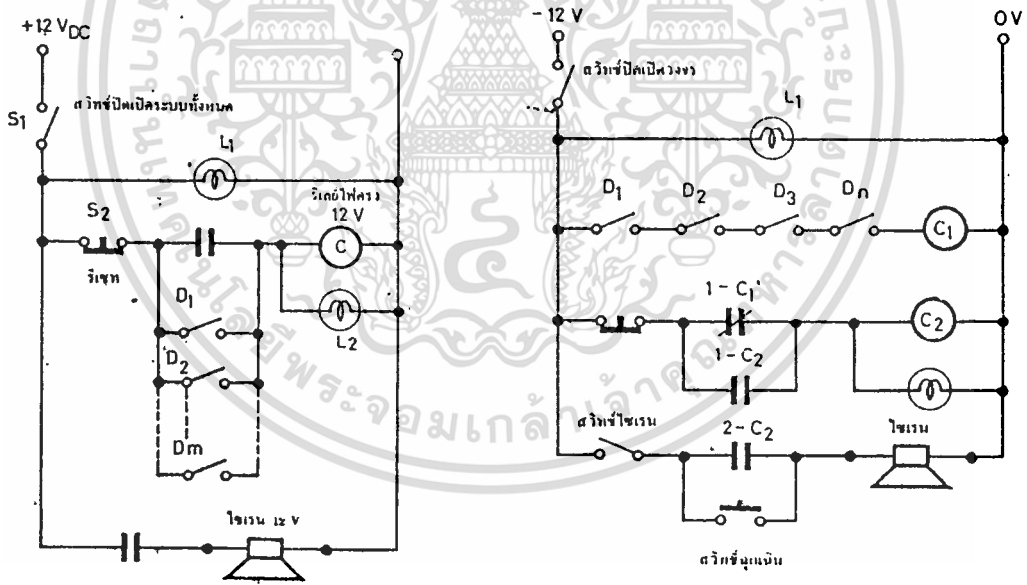
รูป 1.33 การประยุกต์ตัวตรวจจับ การบุกรุกโดยใช้แสง

การประกอบระบบเตือนภัยผู้บุกรุก

วงจรประกอบเป็นระบบเตือนภัย อาจจะเป็นวงจรแบบพื้นฐานง่าย ๆ ซึ่งประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์ที่ติดต่อกับตัวบอกการเตือนภัยโดยตรง หรือประกอบเป็นวงจรหมดตัวตรวจจับหรือตัดเหตอยู่หลายอย่างรวมกัน

วงจรรูป 1.34 เป็นวงจรระบบเตือนภัยอย่างง่าย ๆ ที่ใช้สวิตช์เหตแบบต่างๆ ได้จาก S1 ถึง Sn ซึ่งจะต้องต่อขนานกันไปได้เป็นจำนวนมาก

สวิตช์ต่อ S1...S4 เป็นสวิตช์ที่ใช้ต่อเพื่อเตือนภัยต่าง ๆ เช่น เวลาเกิดไฟไหม้ ก๊าซรั่ว และขโมย เป็นต้น การเริ่มทำให้วงจรทำงานเพียงแต่ใช้สวิตช์ SW1 บอนกระแสจ่ายให้วงจรในกรณีถ้าเกิดสัญญาณเตือนภัย สัญญาณจะดังค้างต่อไป ซึ่งเราจะทำการรีเซ็ตได้ด้วยสวิตช์รีเซ็ต SW2



รูป 1.34 วงจรควบคุม OPEN CIRCUIT และ รูป 1.35 CLOSE CIRCUIT

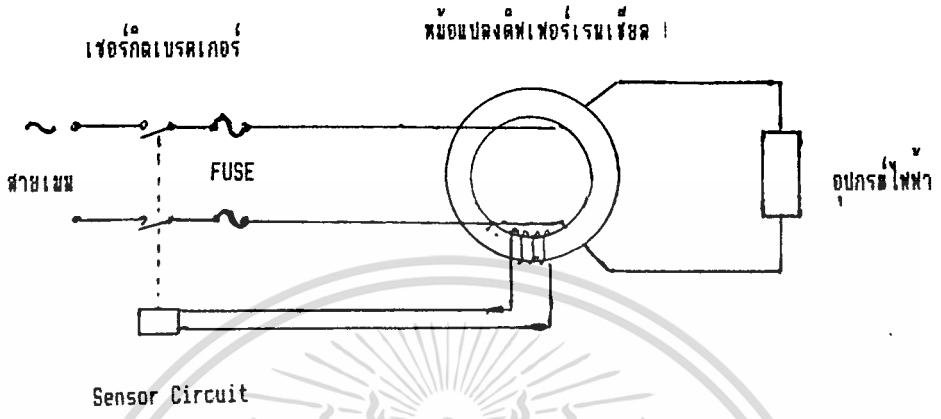
รูป 1.35 เป็นการพัฒนาจากวงจรในรูปก่อน ซึ่งสามารถป้องกันกรณีท่อจากมนุษย์บุกรุกหรือขโมยรู้หนัและตัดสายตัวตัดเหตเสียก่อน หรือในบางกรณีถ้าเกิดสายตัวตัดเหตของวงจรเกิดหลวมหลุดเราก็ไม่มีทางรู้ได้ว่าจุดนั้นไม่ปลอดภัยเสียแล้ว วิธีแก้เราจะใช้วงจรปิด (CLOSE CIRCUIT) คือ เราเอาตัวตัดเหตมาต่ออนุกรมกัน โดยให้กระแสจำนวนหนึ่งไหลเลี้ยงผ่านวงจรตลอดมา ในวงจรจะมีรีเลย์เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวคือรีเลย์ C1 เมื่อสับสวิตช์ SW1 หลอดไฟ L1 จะสว่าง เป็นการบอกว่าวงจรกำลังทำงาน S1...Sn ต่ออนุกรมกัน

นอกจากนี้เรายังใช้วิธีการหน่วงเวลาในบางกรณี เช่น หน่วงเวลาในการทำงาน หรือ หน่วงเวลาในการเตือนภัย เป็นต้น

ระบบป้องกันวงจรทางไฟฟ้า

ระบบป้องกันอันตรายจากไฟรั่ว ที่ใช้ได้ผลและมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งก็คือ ป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟ เมื่อเกิดไฟรั่วขึ้นจะตัดไฟโดยอัตโนมัติ หรือเรียกว่า GROUND FAULT INTERRUPTER (GFI) หรือ EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKERS โดยสามารถป้องกันวงจรทั้งหมดได้ ถ้าเกิดไฟรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งของวงจร เครื่องก็จะตัดวงจรขาดออกจากสายเมนทันที

เครื่องตัดวงจรกระแสไฟรั่วทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่า ถ้าเกิดมีกระแสรั่วลงจรลงดินกระแสรั่วจะเป็นตัวไปกระตุ้นให้วงจรตรวจจับ (SENSING CIRCUIT) ทำงานคือทำให้ CIRCUIT BREAKER ตัดวงจรออกจากสายเมนทันที ในรูปที่ 1.36 แสดงถึงส่วนสำคัญของวงจรเครื่องตัดกระแสไฟรั่ว ซึ่งประกอบด้วยหม้อแปลงตีเฟสเพื่อเรนเซียล สายไฟจะจ่ายพลังงานให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะผ่านหม้อแปลงนี้ กระแสไหลเข้าสู่สมมุติเป็นสายหนึ่งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วย้อนกลับมาจากสายหนึ่ง โดยผ่านหม้อแปลงเช่นกัน ในยามปกติคือไม่มีกระแสรั่ว กระแสที่ไหลเข้าจะเท่ากับกระแสที่ไหลออก ฉะนั้นผลรับของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็กของหม้อแปลงตีเฟสเพื่อเรนเซียล เป็นศูนย์ ไม่เกิดแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวดที่สอง (SECONDARY) ไม่ผลต่อเซอร์กิตเบรคเกอร์ ถ้ามีกระแสรั่วลงดินที่ใดในวงจรที่อยู่หลังเครื่องตัดวงจรไฟรั่ว กระแสที่ไหลเข้าและไหลออกผ่านหม้อแปลงจะไม่เท่ากันเป็นผลให้เกิดผลลัพธ์ สนามแม่เหล็กเกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นไปกระตุ้นให้เซอร์กิตเบรคเกอร์ ตัดวงจรออกจากสายเมนทันที คือภายในเวลา 0.1 วินาที



รูป 1.36 หลักการทำงานของระบบป้องกันทางไฟฟ้า

บทที่ 2

การติดต่อกับไมโครคอมพิวเตอร์

เนื่องจาก PROJECT นี้ได้ใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II เป็นตัวควบคุมการทำงานดังนั้นจะต้องทำการศึกษาทางด้านอินเทอร์เฟซ โดยการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกของเครื่อง จะใช้ทาง I/O SLOT ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 8 SLOT เราสามารถใช้การอินเทอร์เฟซกับ I/O SLOT ได้

สำหรับขาสัญญาณต่าง ๆ ในแต่ละ SLOT นั้นจะถูกกำหนดขึ้น เหมือนกันหมดทุก SLOT จำนวนขาทั้งหมด 50 ขา รายละเอียดบางขาของบาง SLOT ได้แสดงไว้ดังรูป 2.1

รูป 2.1 แสดงรายละเอียดการจัดขา จุดต่อมี 50 ขา ต่อ 1 SLOT ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มแรก คือ ขาสัญญาณมาตรฐาน ในการติดต่อกับหน่วยความจำ และพอร์ทัลได้แก่ขา A0-A15 ขา DO-D7 ขา R/W ขา DEVSEL ขา IOSEL ขา IOSTRB รวม 28 ขา

2. กลุ่มที่สอง เป็นสัญญาณเกี่ยวกับทาง DMA อินเทอร์รัพท์ และ รีเซ็ต ได้แก่ ขา RDY ขา DMA ขา NMI ขา IRQ ขา RES ขา INH ขา USER1 ขา INT IN กับ INT OUT ขา DMA IN กับ DMA OUT รวม 11 ขา

3. กลุ่มที่สาม เป็นสัญญาณนาฬิกา ได้แก่ ขา 7M (7MHz) ขา $\phi 0$ ขา $\phi 1$ และขา $\phi 3$ รวม 4 ขา

4. กลุ่มที่สี่ เกี่ยวกับสัญญาณภาพ ได้แก่ COLOR REF และ SYNC รวม 2 ขา

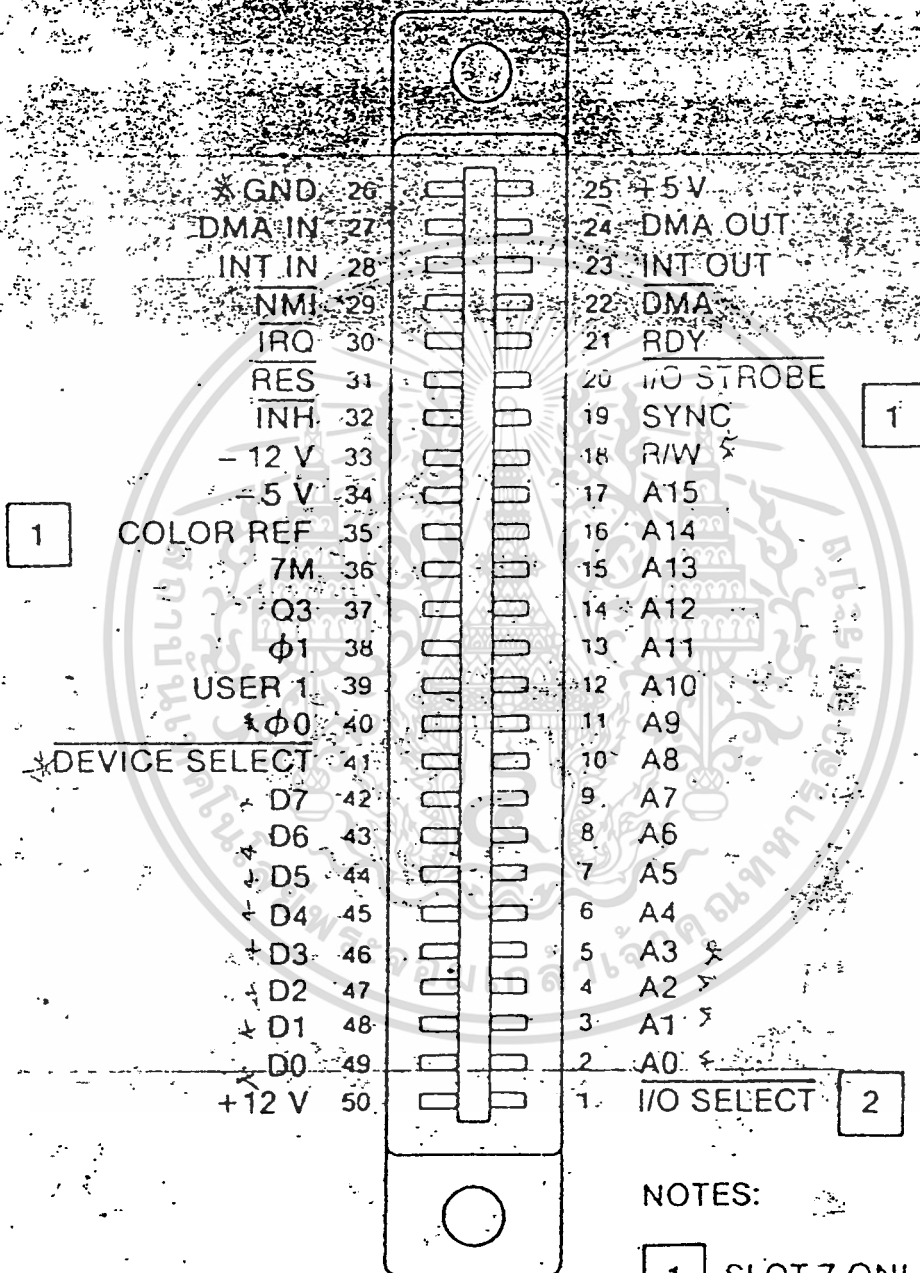
5. กลุ่มที่ห้า เป็นแหล่งจ่ายแรงดัน ได้แก่ GND +5 -5 +12 และ -12 VOLT รวม 5 ขา

PROJECT นี้ได้ใช้ขาสัญญาณบางขาเพื่อนำมาใช้ในการต่อออก ซึ่งได้แก่ ขา A0 ถึง A3 เพื่อนำไปต่อกับขา DO ถึง D7 ขา R/W ขา DEVSEL และ GND รวม 15 ขาก่อนที่จะใช้งานจะต้องทำการศึกษาสัญญาณขาต่าง ๆ ก่อน

รูปที่ 2 แสดงการถอดรหัสของชุด ขา DEVICE SELECT ในเนื้อ
 เครื่องเขียนเป็น DEVSEL

I/O STROBE ในเนื้อเครื่องเขียนเป็น IOSTRB

I/O SELECT ในเนื้อเครื่องเขียนเป็น IOSET



FRONT

NOTES:

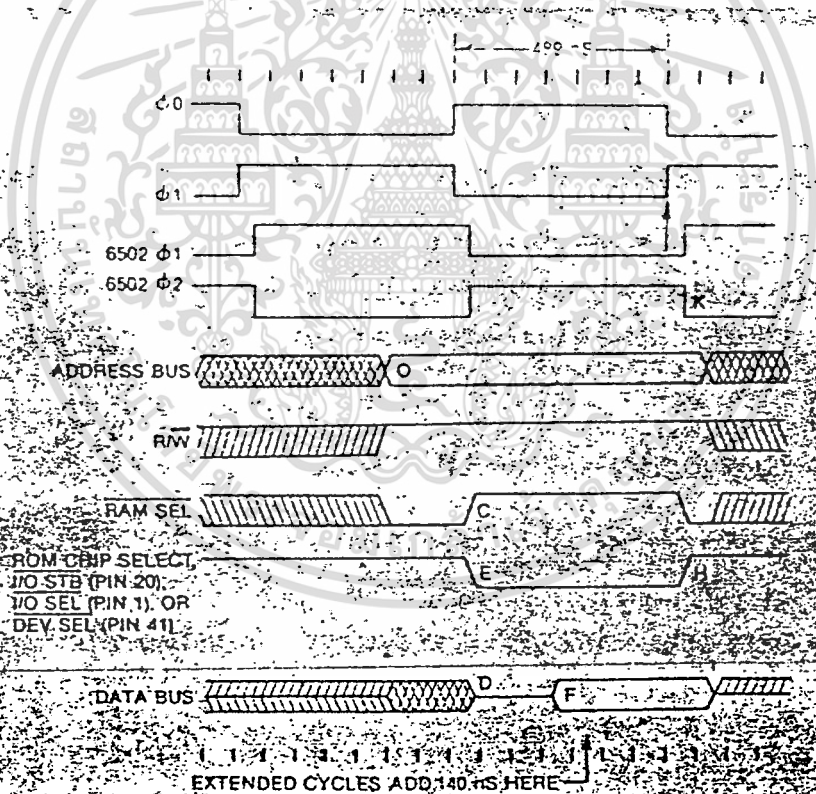
1 SLOT 7 ONLY

2 SLOTS 1-7 ONLY

สัญญาณนาฬิกาของระบบ

ระบบคอมพิวเตอร์ทั่วไปจะใช้สัญญาณนาฬิกาให้กับ CPU เป็นสัญญาณนาฬิกาของระบบด้วย ในกรณีของเครื่องแอปเปิ้ล มีข้อแตกต่างคือ แอปเปิ้ลได้สร้างสัญญาณนาฬิกา $\phi 0$ กับ $\phi 1$ ขึ้นและนำ $\phi 0$ ไปผ่านเกทเพื่อควบคุมการทำงาน แล้วจึงจ่ายให้แก่ 6502 $\phi 0$ ซึ่งจะได้สัญญาณนาฬิกาอีก 2 เฟส คือ 6502 $\phi 1$ และ 6502 $\phi 2$

ผู้สร้าง CPU 6502 ได้กำหนดให้ใช้สัญญาณทั้งสองนี้เป็นสัญญาณนาฬิกาของระบบ แต่ แอปเปิ้ลไม่ได้ดำเนินการ โดยนำแต่ 6502 $\phi 1$ ไปใช้ในเครื่องที่เกี่ยวกับการรับฟลอเปอร์ ขาดตาข่ายของ 6502 เพียงเรื่องเดียวเท่านั้น และในบางแห่งก็เรียก $\phi 0$ เป็น $\phi 2$ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ 6502 จึงทำให้เพิ่มความสับสน เพราะมีช่วง DELAY TIME แสดงดังรูป 2.2 จึงจะขอเรียกเป็น $\phi 0$ กับ $\phi 1$ ดังเดิม



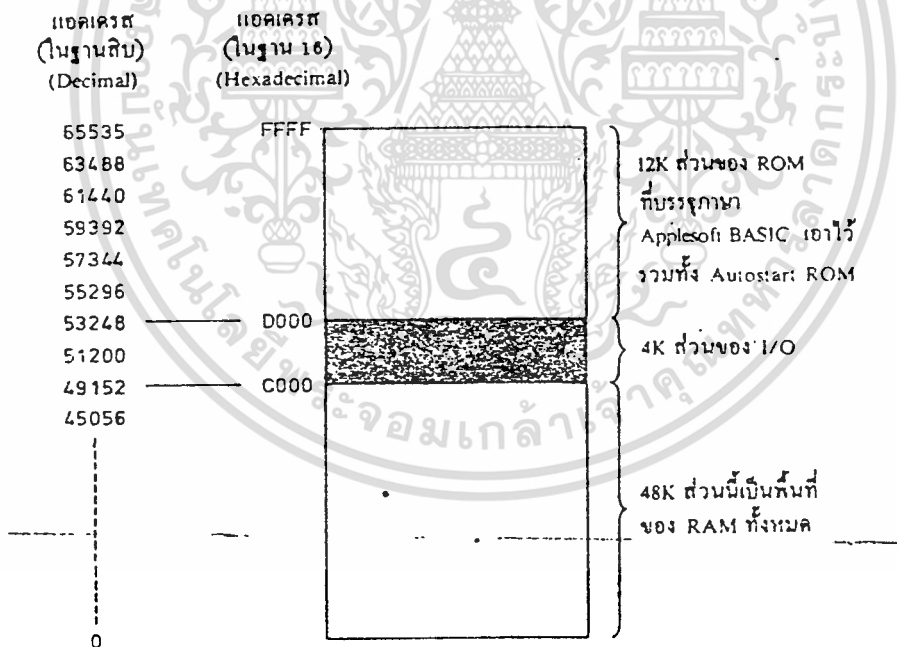
รูปที่ 2.2 แสดงสัญญาณนาฬิกา และสัญญาณอื่นในวงจร READ ใน 16K ในที่นี้ ส่วนในวงจร WRITE จะถอยออกที่ขา R/W ตรงครั้งที่ $\phi 1$ คือจุดที่ต้องการให้ READ หรือ WRITE

สัญญาณนาฬิกา $\phi 0$ กับ $\phi 1$ มีเฟสตรงข้ามกันโดยตรง เพราะได้มาจาก Q และ \bar{Q} ของฟลิปฟล็อปตัวเดียวกันไม่เหมือนกับ 6502 $\phi 1$ กับ 6502 $\phi 2$ ซึ่งมีลักษณะเฟสตรงกัน ดังนั้นการนำพอร์ทของ 6502 เช่น PIA 6520 มาใช้ควรจะต้องพิจารณา

อีกเรื่องหนึ่งคือ แอปเปิ้ล ได้กำหนดการเรียกช่วงเวลาไว้ว่า ให้เป็นช่วง $\phi 0$ เมื่อ $\phi 0 = "1"$ และช่วง $\phi 1$ เมื่อ $\phi 1 = "1"$ และได้แบ่งเวลาใช้งานระบบบัสให้แก่ ซีพียู กับ CRTC คนละครึ่ง คือ ซีพียู จะยึดครองบัสในช่วงเวลา $\phi 0$ และ CRTC จะยึดครองบัสในช่วงเวลา $\phi 1$ ดังจะเห็นได้จากการตีโค้ดแอดเดรส

การตีโค้ดแอดเดรสของแอปเปิ้ล

โดยที่ 6502 ได้วางระบบพอร์ทไว้ในแบบ MEMORY MAP I/O PORT การศึกษาถึงเรื่องพอร์ท จึงต้องศึกษาถึงการตีโค้ดแอดเดรสด้วย แอปเปิ้ล ได้แยกการตีโค้ดแอดเดรสไว้เป็น 2 ช่วง คือ 48 K ไบท์ต่ำ กับ 16 K ไบท์สูง คือ แอดเดรส \$C000 ถึง \$FFFF ดังรูป 2.3 และ 2.4



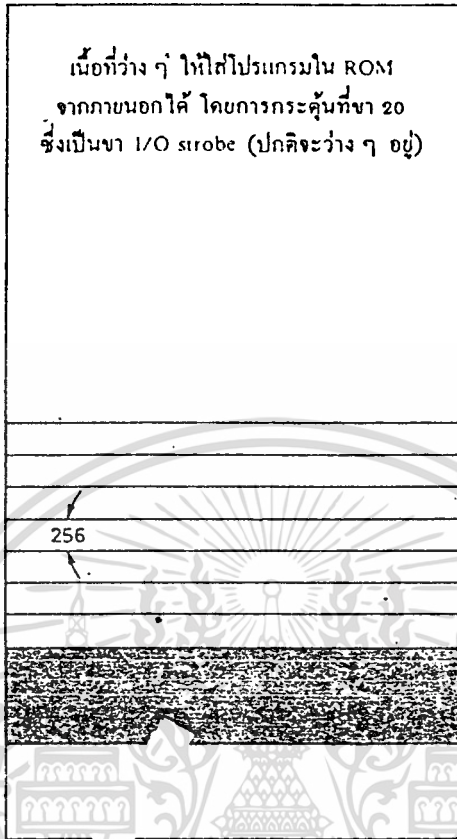
รูปที่ 2.3 แสดงหน่วยความจำทั้ง 64 K ของ APPLE II

แอดเดรส(ในฐานสิบ)
(Decimal)

แอดเดรส(ในฐาน 16)
(Hexadecimal)

53248
4
51200
50944
50558
50432
50176
49920
49564
49408
49280
49152

D000
C800
C700
C600
C500
C400
C300
C200
C100
C080
C000

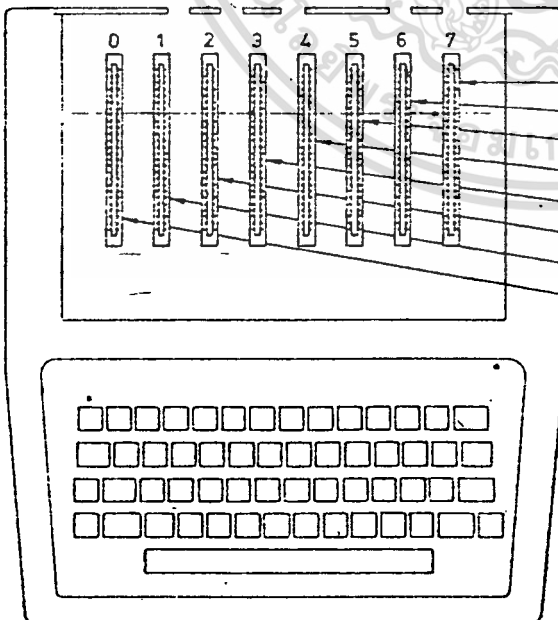


ROM ขนาด 2K

ส่วนของ ROM หรือ RAM ที่จะมาใช้งาน I/O ขนาด 1.75K

ส่วนนี้แหละที่เป็นแอดเดรสของสต็อกทั้ง 8

เป็น I/O ติดมากับเครื่อง เพื่อควบคุมคีย์บอร์ด, ลำโพง, จอยสติค, เทปคาสเซตท์

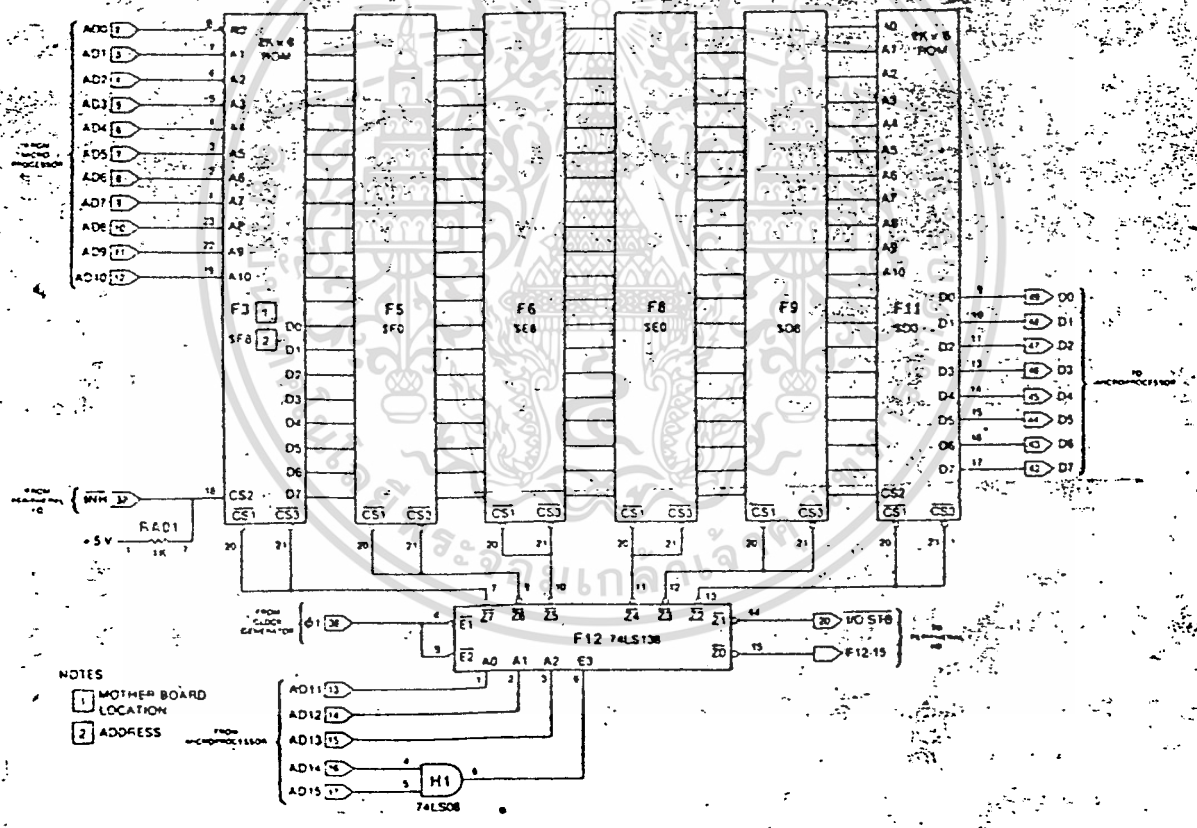


- สต็อก 7 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49392-49407
- สต็อก 6 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49376-49391
- สต็อก 5 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49360-49375
- สต็อก 4 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49344-49359
- สต็อก 3 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49328-49343
- สต็อก 2 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49312-49327
- สต็อก 1 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49296-49311
- สต็อก 0 มีเลขที่แอดเดรสจาก 49280-39295

ในหน่วยจะกล่าวถึงการจัดไบต์แอดเดรสที่ \$C000 ถึง \$FFFF แทน ซึ่งการจัดไบต์ทั้งสองช่วงเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกัน ในการจัดไบต์จะกล่าวถึง จะขอกล่าวในลักษณะเป็นหน้า PAGE ซึ่งหน้าหนึ่งมี 256 ไบต์ เช่น PGE \$00 จะหมายถึงแอดเดรส \$0000 ถึง \$00FF หรือ PGE \$C5 จะหมายถึง \$C500 ถึง \$C5FF ทำนองเดียวกัน PGE \$C0 ถึง PGE\$FF จะหมายถึง \$C000 ถึง \$FFFF

การจัดไบต์ใน 16 Kไบต์สูงเริ่มต้นที่ IC F12ซึ่งเป็น 74LS138 คือ 3TO 8 LINE DECODER/MULTIPLEXER ดังรูป 2.5

รูปที่ 2.5 แสดงการวัดไบต์แอดเดรส 16K ไบต์สูงครั้งแรก



โดยที่แอมป์นำ ϕ_1 มาเข้าขา $\bar{E}1$ กับ $\bar{E}2$ นั่นคือจะทำให้ F12 ต่ได้เมื่อ ϕ_1 เป็น 0 หรือต่ได้ในช่วง ϕ_0 (เมื่อ ϕ_0 เป็น 1) คือในช่วงเวลา ϕ_0 ความหมายของการต่ได้ในหนคคือ ถ้ามันต่ได้ ขา O/P ตรงกับข้อมูลทาง I/P (เพียงขาเดียว) จะเป็นลอจิก 0 ในเวลาปกติ คือเมื่อไม่มีการต่ได้ ขา O/P ทุกขาจะเป็นลอจิก 1

และนำขา A14 กับ A15 มา AND กันไปเข้าขา E3 นั่นคือจะทำให้ F12 ต่ได้ต่อเมื่อทั้งสองขาเป็นลอจิก 1 ึ่งคู่ เท่ากับ เป็นการกำหนดช่วงต่ได้ให้ ต่ได้ตั้งแต่แอดเดรส \$C000 คือ PGE \$C0 เป็นต้นไปถึง PGE \$FF ถ้าช้ข้ให้ค่าแอดเดรสต่ำกว่านั้น (\$C000) วงจรต่ได้จะไม่ทำงาน ึ่งเป็นการต่ได้ 16K ไบท์สูงจากน้ได้ นำขา A11, A12 และ A13 มาเข้าขา A0, A1 และ A2 ของ F12 ตามลำดับ ึ่งน้น การต่ได้แอดเดรสได้ดังนี้

$\bar{Z}0 = \text{PGE } \$C0 \text{ ถึง } \text{PGE } \$C7$ ึ่งจะนำไปต่ได้ต่อที่ H12 เป็น SELECTOR ของพอร์ทและหน่วยความจำ ึ่งจะกล่าวต่อไป

$\bar{Z}1 = \text{PGE } \$C8 \text{ ถึง } \text{PGE } \CF เป็น JOSTB เพื่อเลือกหน่วยความจำ ในการต่ได้ซึ่งเสียข้ในแต่ละสล็อต ึ่งจะกล่าวต่อไป

$\bar{Z}2$ ถึง $\bar{Z}7$ นำไปเป็น CS ของหน่วยความจำ ROM ขนาด 2K ไบท์จำนวน 6 ตัวตาม PGE \$ เริ่มถนคือ D0, D8, E0, E8, F0 และ F8 ึ่งเป็นมอนิเตอร์และเป็นอินเตอร์พรีเตอร์ของภาษาเบสิก

การต่ได้ต่อไป แอมป์ได้นำขา $\bar{Z}0$ ของ F12 (PGE \$C0 ถึง PGE \$C7) ไปต่ได้ต่อ โดยนำไปเข้าขา $\bar{E}1$ และ $\bar{E}2$ ของ H12 ึ่งเป็น 74LS138 อีก 1 ตัว ตามรูป 2.6 เพื่อให้ต่ได้ต่อในช่วงแอดเดรส นส่วนของ E3 ของ H12 ได้ให้ลอจิก 1 ไว้โดยต่อ R 1K กับ Vcc กับต่อขาน้ ไปยังขา USER1 บนสล็อต (หากข้ใช้ให้ลอจิก 0 แก่ USER1 ึ่งเป็นการยกเลิกการต่ได้ของ H12) การต่ได้ทำโดยนำขา A8, A9 และ A10 A0, A1 และ A2 ของ H12 ตามลำดับ ึ่งต่ได้ต่ได้ดังนี้

$\bar{Z}0 = \text{PGE } \$C0$ นำไปต่ได้ต่อเป็น SELECTOR ของพอร์ท

$\bar{Z}1$ ถึง $\bar{Z}7 = \text{PGE } \#C1$ ถึง $\text{PGE } \#C7$ ตามลำดับเป็น $\overline{\text{IOSEL}}$ มันจะเลือกหน่วยความจำขนาด 256 ไบท์ในแต่ละสล็อตโดยตรงตั้งแต่ 1 ถึงสล็อต 7 (คือไม่มีลอจิกในสล็อต 0) ซึ่งจะกล่าวต่อไป

การรีเซ็ตโดยตรงทสาม แอปเปิ้ลได้นำขา $\bar{Z}0$ ของ H12 (PGE #C0) ไปเข้าขา E1 ของ H2 ซึ่งเป็น 74LS138 อีกตัว หากดูตามรูป 2.6 จะเห็นได้ว่าได้แยกขา $\bar{Z}0$ ของ H12 ไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะนำไปรีเซ็ตต่อ เป็น ON-BOARD I/O หรือจะยกขึ้นในชื่อของ SOFT SWITCH ต่าง ๆ

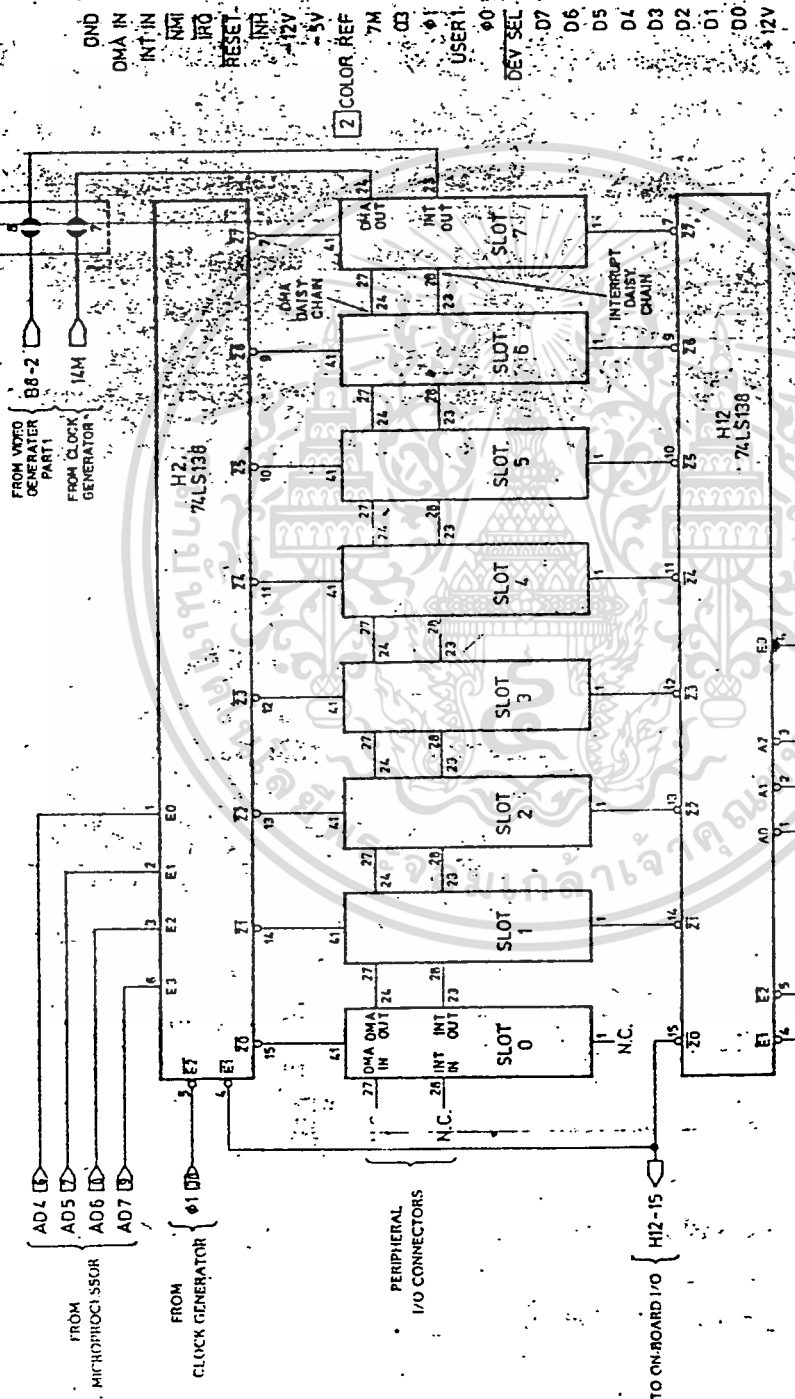
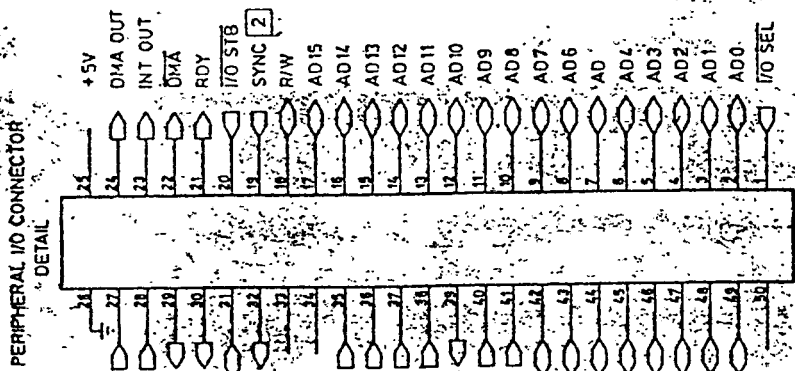
ส่วนที่ H2 ได้นำ $\phi 1$ มาเข้าขา $\bar{E}2$ อีกครั้ง คงเพื่อลดเวลาเมื่อเสียไปเนื่องจากการรีเซ็ตโดยตรงตามลำดับ A7 มาเข้าขา E3 เพื่อเป็นการกำหนดให้ H2 รีเซ็ตในช่วงแอดเดรส $\#C08x$ ถึง $\#C0Bx$ เท่านั้น (x=0 ถึง F) เมื่อนำขา A4, A5 และ A6 มาเข้าขา A1, A2 และ A3 ของ H2 ตามลำดับ จะรีเซ็ตได้ดังนี้

$\bar{Z}0 = \text{แอดเดรส } \#C08x \text{ เป็น } \overline{\text{DEVSEL}}$ ของสล็อต 0

$\bar{Z}1 = \text{แอดเดรส } \#C09x \text{ เป็น } \overline{\text{DEVSEL}}$ ของสล็อต 1

และต่อ ๆ ไปจนถึง $\bar{Z}7 = \#C0Fx$ เป็น $\overline{\text{DEVSEL}}$ ของสล็อต 7

แอปเปิ้ลได้ให้ชื่อของสล็อตเป็น $\overline{\text{DEVSEL}}$ เพื่อให้การเรียก $\overline{\text{DEVSEL}}$ ในแต่ละสล็อตเป็นแบบทั่ว ๆ ไปจึงให้เป็น $\#C0mx$; m แทนด้วย $m = 8+n$ เมื่อ n แทนตำแหน่งหมายเลขสล็อตจาก 0 ถึง 7 เช่นเมื่อนาอปรณ์ PROJECT นี้ไปเสียบสล็อต 2 จะรีเซ็ตแอดเดรสถึงพอร์ทเป็น $\#C0Ax$ (x=0 ถึง F) หากนำ $\overline{\text{DEVSEL}}$ นี้ไปใช้ จะใช้ได้ 1 พอร์ทโดยตรงแต่ถ้าต้องการจะให้เลือกพอร์ทได้ 16 พอร์ท ก็ต้องนำ A0 ถึง A3 (4 TO 16 DECODER) ซึ่งจะได้เป็น $\#C0A0$ ถึง $\#C0AF$



- NOTES:
1. REV. 7 AND DIFF ONLY.
 2. REV. 1, 7, AND REV. SYNC AND COLOR REF CONNECT TO SLOT 7 ONLY; PINS 19 AND 35 FROM TWO BUSES FROM SLOT 0 TO SLOT 6 REV. 0; NO CONNECTION TO SYNC OR COLOR REF; PINS 19 AND 35 FROM TWO BUSES FROM SLOT 0 TO SLOT 7

รูปที่ ๕ แสดงการติดตั้งเดคอดร กว้าง ๒ และ ๗ ๕

IOSEL และ IOSTRB

หากอุปกรณ์นี้มีโปรแกรมเฉพาะของมัน และถ้าไม่ต้องการเก็บโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำ 48Kไบต์ ถ้าเราสามารถเก็บไว้ ๗ แอดเดรสที่จะกล่าวต่อไปนั้น ส่วนตัวที่เป็นหน่วยความจำให้เก็บไว้บนการ์ดที่หาซื้อ

ถ้าหากโปรแกรมยาวไม่เกิน 256 ไบต์ จะสามารถเก็บไว้ที่แอดเดรส \$Cn000 ถึง CnFF (n คือหมายเลขสลอต แต่สำหรับกรณีนี้ให้เว้นสลอต 0) การอ้างแอดเดรสถึงหน่วยความจำเหล่านี้ สามารถอ้างได้โดยตรง เพราะมีขา IOSEL ของแต่ละสลอตอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องต่อขา A0 ถึง A7 ขา D0 ถึง D7 ขา R/W ขา GND และ Vcc

แต่ถ้าโปรแกรมยาวเกิน 256 ไบต์ จะต้องเก็บไว้ที่แอดเดรส \$C800 ถึง \$CFFF คือ 2Kไบต์ จะสังเกตเห็นว่า ในแอดเดรสที่ไม่หมายเลขสลอตนั้นคือ แอดเดรสที่เป็นของกลาง หน่วยความจำของทุกสลอตจะใช้แอดเดรสเดียวกัน ได้โดยที่เราต้องต่อขา IOSTRB และ A0 ถึง A10 ไบต์

ปัญหาอยู่ว่า เราจะให้ ชิปแอดเดรสถึงหน่วยความจำในสลอตที่ต้องการได้อย่างไร แอปเปิ้ลได้กำหนดให้สามารถใช้หน่วยความจำ ขนาด 2Kไบต์ นี้ได้ทีละสลอตเท่านั้น โดยถ้า ชิปแอดเดรส \$CFFF เมื่อใด เราต้องทำเป็น SOFT SWITCH ไว้ว่าให้หน่วยความจำนี้ ของทุกสลอตก่อนดึงออกจากบัส และเมื่อเราต้องการให้ ชิป ติดต่อกับหน่วยความจำ 2Kไบต์ นี้ ของสลอตใดให้ติดต่อกับ IOSEL คือ \$Cn00 ถึง \$CnFF ของสลอตนั้นก่อนซึ่งเราจะต้องจัดวงจรเป็น SOFT SWITCH ให้ต่อหน่วยความจำ 2K ของสลอตนี้เข้ากับบัส การติดตาเป็นการตามนัยเรียก เป็นการลดมาตรฐานของแอปเปิ้ล

สัญญาณควบคุมที่ใช้ในการอินเตอร์เฟส

สัญญาณควบคุมที่จำเป็นต้องใช้ในการอินเตอร์เฟสกับ 6502 CPU ของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II มีดังนี้

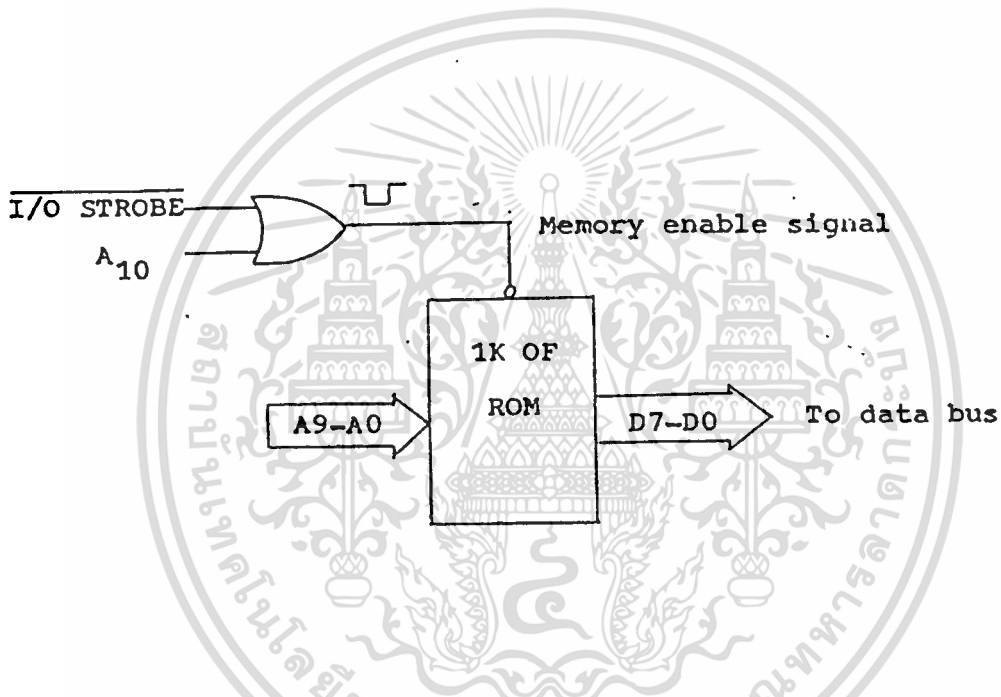
1 I/O SELECT (IOSEL) อยู่ขา 1 ของสล็อต แอดดพอลจิกตัว สัญญาณ IOSEL ในสล็อตที่ n จะแอดดพอลจิกการอ้างแอดเดรสตั้งแต่ Cn00 ถึง CnFF เช่นเมื่อเราอ้างแอดเดรสที่ C200 สัญญาณ IOSEL ในสล็อตที่ 2 แทนที่แอดดพอลจิกของสล็อตอื่น ๆ IOSEL จะไม่แอดดพอลจิกสำหรับช่วงตำแหน่งของแอดเดรสที่ทำให้สัญญาณ IOSEL แอดดพอลจิกแสดงไว้ในตารางที่ 2.1

จะเห็นได้ว่าสัญญาณ IOSEL ในแต่ละสล็อตสามารถอ้างอ้างตำแหน่งแอดเดรสได้ 256 ตำแหน่ง คือ 00 ถึง FF ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ถึง 256 I/O Devices ในแต่ละสล็อต

Interface slot	Address Range
1	C100 - C1FF 49408 - 49663
2	C200 - C2FF 49664 - 49919
3	C300 - C3FF 49920 - 50175
4	C400 - C4FF 50176 - 50431
5	C500 - C5FF 50432 - 50687
6	C600 - C6FF 50688 - 50943
7	C700 - C7FF 50944 - 51199

ตาราง 2.1 ตำแหน่งของแอดเดรสแต่ละสล็อต ที่ทำให้สัญญาณ I/O SELECT แอดดพอลจิก

2 I/O STROBE (IOSTRB) แอดต์ฟลอปจิกต่ำ และสัญญาณนี้จะแอดต์ฟเมื่อถูกอ้างในช่วง \$C800 ถึง \$CFFF ซึ่งสัญญาณ IOSTRB นี้ จะแอดต์ฟทุกสล็อตพร้อม ๆ กัน เราสามารถใช้สัญญาณ อีเนเบิล หน่วยความจำ (Memory Chip) และอุปกรณ์ I/O ได้ (I/O Devices) ตัวอย่างได้แสดงไว้ตรงรูปที่ 2.7 ซึ่งใช้สัญญาณ IOSTRB เป็นตัวเลือกหน่วยความจำแบบ ROM ขนาด 1 K



รูปที่ 2.7 แสดงการใช้สัญญาณ IOSTRB ในการ อีเนเบิลหน่วยความจำ

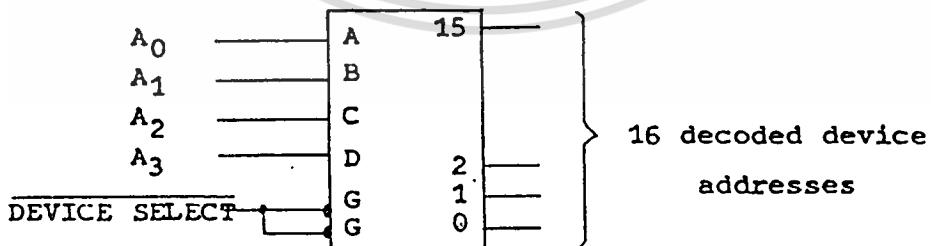
3 DEVICE SELECT (DEVSEL) สัญญาณนี้จะแอดต์ฟเมื่อมีการอ้างแอดเดรสในช่วงต่าง ๆ คล้ายกับสัญญาณ I/O SELECT ตามตาราง 2.2

Interface slot	Address Range	
0	C080 - C08F	49280 - 49295
1	C090 - C09F	49296 - 49311
2	COA0 - COAF	49312 - 49327
3	COB0 - COBF	49328 - 49343
4	COC0 - COCF	49344 - 49359
5	COD0 - CODF	49360 - 49375
6	COE0 - COEF	49376 - 49391
7	COF0 - COFF	49392 - 49407

ตาราง 2.2 ตำแหน่งของแอดเดรสแต่ละสล็อต ทหาให้สัญญาณ DEVICE SELECT แอดดฟ์

จากตาราง 2.2 จะเห็นว่า ในแต่ละสล็อต นั้นสามารถอ้างแอดเดรสได้ใน
 16 แอดเดรสแทน ถ้าอุปกรณ์ภายนอกมากกว่านั้น เราสามารถที่จะขยายได้ด้วย
 การใช้ดีโคเดอ์ (Decoder) เข้ามาช่วยตั้งตัวอย่างในรูป 2.8 เราใช้แอดเดรส
 A0-A3 และสัญญาณ DEVICE SELECT สามารถดีโคออกมาได้ถึง 16 devices

SN 74154



รูป 2.8 การใช้สัญญาณ DEVICE SELECT เพื่อเนเบด 16 address decoder

การออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์

แนวความคิดในการออกแบบ

ในยุคที่คอมพิวเตอร์ยังไม่มืบทบาท หรือ แพร่หลาย ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย ๆ ไม่ใหญ่โตมากนัก และส่วนมากจะเป็นระบบเตือนภัย มิใช่ ระบบรักษาความปลอดภัย เพราะระบบเตือนภัยจะเป็นเพียงแจ้ง เหตุ เท่านั้นแต่ระบบรักษาความปลอดภัยจะทำการป้องกันและแก้ไข เหตุเบื้องต้น ต่อมาเมื่อคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามืบทบาทในชีวิตประจำวัน การนำเอาระบบไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบรักษาความปลอดภัย จะช่วยทำให้ความซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้อยลง และสามารถทำให้ความเชื่อถือได้มีมากขึ้น ในปริมาณที่พอควร จึง ได้นำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีราคาถูกลง มาออกแบบเพื่อให้ต้นทุนของระบบต่ำ เพื่อที่จะนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งแนวทางในการออกแบบชุดอินเตอร์เฟส ได้ออกแบบเพื่อให้ใช้ได้กับไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องไหนไปเพียงแก้ไขชุดแปลงวงจรเล็กน้อย และชุดอินเตอร์เฟสทำให้การเขียนโปรแกรมควบคุมง่ายขึ้น ระบบนั้นจะต้องมีชุดหน้าสัญญาณจากที่เกิดเหตุเข้ามา และแสดงผล MONITOR จากนั้นไมโครคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณไปควบคุม ณ จุดนั้น ๆ ซึ่งจะเป็นการป้องกันเหตุเบื้องต้น

ส่วนแนวความคิดในการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบ เพื่อให้ระบบทำงานได้แม่นยำ ไว้ต่อการควบคุม จึง ได้ใช้ภาษาเครื่อง และ ภาษาแอสเซมบลี ซึ่งอาจจะทำให้เข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางภาษา และ โปรแกรมจะต้องทำการแสดงผล ออกจอ MONITOR เพื่อแจ้งภาวะของที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่เครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ได้ทราบเหตุ เพื่อดำเนินการต่อไป

จากการศึกษาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ และการติดต่อกับ ไมโครคอมพิวเตอร์ ที่กล่าวมาแล้วในสองบทแรก สามารถทำการออกแบบระบบ โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบไว้ดังนี้

1. เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สามารถ
 - ป้องกันอัคคีภัย
 - ป้องกันผู้บุกรุก
 - ป้องกันระบบทางไฟฟ้า

2 สามารถควบคุมระบบในลักษณะหนึ่งอินพุตต่อหนึ่ง เอาท์ควบคุมซึ่งมทั้งหมด 64 อินพุต และ 64 เอาท์พุท

3 สามารถแสดงตำแหน่งจุดตรวจสอบทางจอ MONITOR

4 สามารถใช้ได้ทั้งการควบคุมโดยตรง และใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ควบคุม

5 มีความแม่นยำ เที่ยงตรงต่อการตรวจจับสัญญาณทางอินพุต และการควบคุมทางเอาท์พุท

จากวัตถุประสงค์ข้างต้น ได้ลำดับการออกแบบพร้อมทั้งการทำงานผลการทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1 อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ
- 2 วงจรอินเทอร์เฟส
- 3 ภาคเอาท์พุทควบคุม
- 4 โปรแกรมควบคุม



1 อุปกรณ์การตรวจสอบสถานะ

การทำงานของ Heat detector

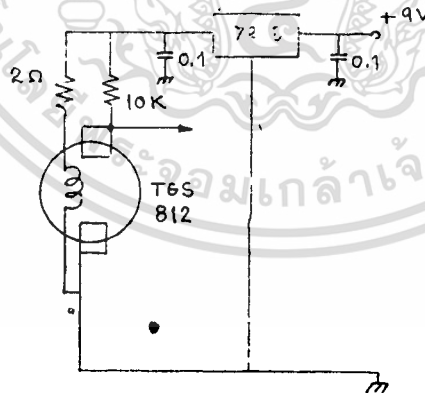
Heat detector เป็น switch แบบ NO จะทำงานที่อุณหภูมิ 55 ถึง 65 องศาเซลเซียส ในขณะที่ปกติสวิตช์จะ open และเมื่อเกิดความร้อน (ขณะเกิดเพลิง) อุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส สวิตช์ก็จะ close

การทดลอง ได้ใช้อุณหภูมิของน้ำอุ่น ประมาณ 60 องศาเซลเซียส ทำให้สวิตช์ close

การทำงานของ Gas detector

ในขณะที่ใช้งานปกติ ต้องมีการจ่ายไฟแก่หลอดความร้อน เพื่อขับไล่ความชื้นออก และทำให้การทำงานไม่ขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิและความชื้นภายนอก แรงดันที่ใช้ประมาณ 5 V. หลอดจะดึงกระแสประมาณ 50 mA ขณะใช้งานภาวะปกติ ค่าความต้านทานภายในจะสูงจนมากเป็น 20 K ohm เมื่อมีก๊าซ จะทำให้ค่าความต้านทานภายในลดลงเหลือ 500 ohm ถึง 2000 ohm จึงนำสภาวะการเปลี่ยนแปลงนำมาใช้งานเพื่อ Sensor ก๊าซ

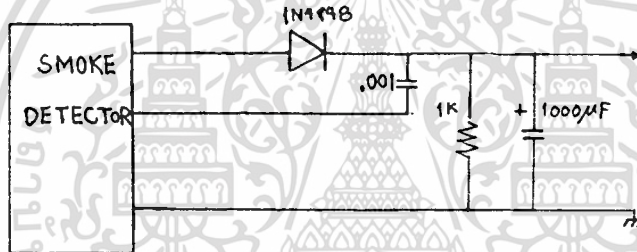
การทดลอง ได้ใช้ก๊าซไฟแช็คไปใกล้บริเวณตัว Gas detector แล้วใช้ ohm มิเตอร์ วัดความต้านทานของตัวมัน จะเห็นการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่มีก๊าซเกิดขึ้น



รูปที่ 3 1 วงจร Gas detector

การทำงานของ Smoke detector

Smoke detector ที่ใช้แบบ ไอโอไอเซ็น (โดยใช้สารกัมมันตรังสี)
ในขณะที่มีควันเกิดขึ้น Smoke detector จะให้สัญญาณรูป sine ความถี่สูงออกมา
โดยวงจรออสซิลเลเตอร์ภายใน ความถี่ประมาณ 10 KHz ดังที่ สัญญาณที่เป็นความถี่
10 KHz นี้ไม่สามารถเข้ากับวงจรดิจิทัลโดยตรง จะต้องทำการแปลงสัญญาณนี้เป็น
ดิจิทัลเสียก่อน จากการออกแบบได้ใช้วิธีการแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลแบบง่าย
เนื่องจากสัญญาณความถี่สูง 10 KHz นี้ได้ ออกแบบวงจรดีเทค โดยมีหลักการ
ดังรูปที่ 3.2



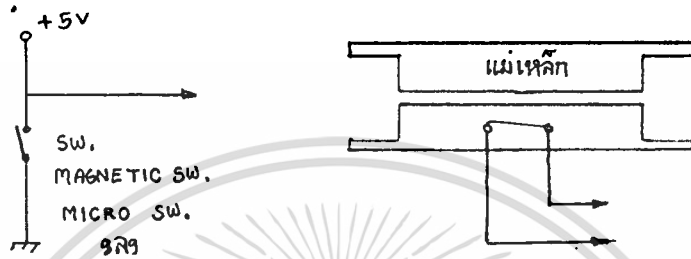
รูปที่ 3.2 วงจร Smoke detector

สัญญาณ 10 KHz ทางช่วงบวกจะผ่านไดโอด 1N4148 แล้วถูกกรองออกด้วย
C filter 100 uF ทำให้สัญญาณเป็นแรงดันไฟตรงเรียบขึ้นเป็นลอจิก "1" เพราะฉะนั้น
เมื่อ Smoke detector ทำงาน เอาท์พุทของ Smoke detector จะให้ลอจิก "1"
และเมื่อสภาวะปกติ Smoke detector ก็จะให้ลอจิก "0"

การทดลอง เมื่อต่อวงจรข้างต้นร่วมกับชุดอุปกรณ์ Smoke detector
สามารถให้ผลเป็นลอจิก เพื่อส่งไปยังวงจรดิจิทัลได้ (เพื่ออินเทอร์เฟซเข้ากับระบบ)

การทำงานของ Magnetic SW.

สวิทช์แม่เหล็กแบบ N.C.



รูปที่ 3.3

ในขณะที่สองส่วนประกบกันอยู่ สวิทช์จะยกอำนาจแม่เหล็กกระทำคือ SW. close และเมื่อไรชนส่วนหนึ่งแยกออกจากกัน สวิทช์ก็จะเปลี่ยนตำแหน่ง สามารถติดตั้งใช้งานทดแทนหม้อการเคลื่อนที่ เช่นที่ ประตู หน้าต่าง เป็นต้น

การทดลอง ใช้โอห์มมิเตอร์วัดหขวออกของสวิทช์ แล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโอห์มมิเตอร์ เมื่อมีการเคลื่อนที่ของสวิทช์ หงสองส่วนออกจากกัน

การทำงานของชุดตรวจจับแรงดัน

ในการตรวจระดับแรงดัน ว่าจะอยู่ในระดับปกติหรือไม่นั้น เราจะตรวจสอบที่ระดับแรงดันต่ำ คือเราจะลดแรงดันจาก 220 V. AC. แล้วทำการตรวจสอบที่แรงดันต่ำ โดยใช้หม้อแปลงทรานส์ฟอร์มเมอร์ 220 V. ไปเป็น แรงดันต่ำประมาณ 9 ,10 V. ค่าแรงดัน 9 V. เป็นแรงดันใช้ในการตรวจสอบ ,ค่าแรงดัน 10 V. เป็นแรงดันที่ใช้ในการปรับแต่งดังจะกล่าวต่อไป

ในขณะที่แรงดันอินพุทปกติ 220 V. แรงดันทางเอาต์พุทจะได้เป็น 9 V. และเมื่อแรงดันอินพุทลดลง หรือเพิ่มขึ้น ประมาณ 10 % คือระหว่างค่าประมาณ 200 V. ถึง 240 V. ก็จะทำให้แรงดันทางเอาต์พุทเปลี่ยนแปลงในช่วง 8 V. ถึง 10 V.

โดยการคำนวณจาก สูตร $E_p/E_s = n$

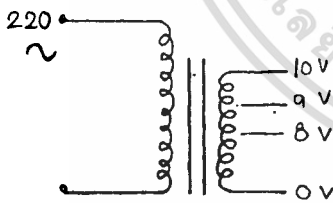
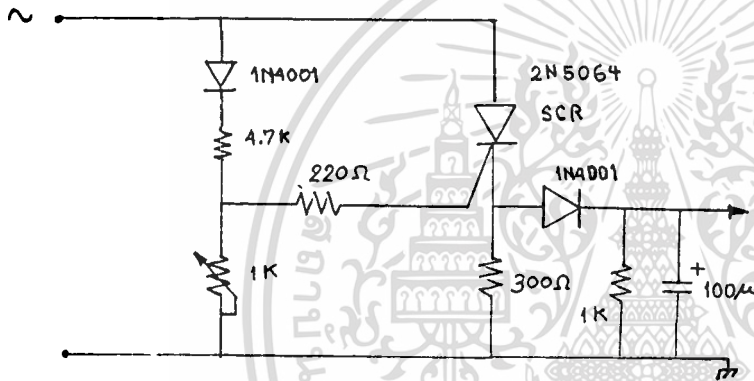
เมื่อภาวะปกติ $n = 220/9 = 24.44$

เมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลงประมาณ 10% ได้อินพุทเป็น 198 V. และ 242 V.

แรงดันเอาต์พุทเท่ากับ $198/24.4 = 8.1$ V. และ $242/24.4 = 9.9$ V.

ดังนั้นจึง ได้ออกแบบวงจรดังรูปโดยใช้ SCR ทำหน้าที่เป็นสวิตช์เมื่อเกิดภาวะ

แรงดันต่ำกว่าปกติ และภาวะแรงดันสูงกว่าปกติโดยการทรigger เกนของ SCR ดังรูป 3.4



การปรับแรงดันให้ SCR ON, OFF โดยปรับ VR 1K (25 รอบ) ปรับละเอียด

กรณี 1 ขณะปรับตั้งให้อินพุท = 9 V. ปรับ VR 1 K ให้ SCR1 ON

และขณะให้อินพุท = 9 V.

-เมื่อแรงดันปกติ SCR1 จะ ON ให้ออกจิก "1"

-เมื่อแรงดันลดลง SCR1 จะ OFF ให้ออกจิก "0"

กรณี 2 ขณะปรับตั้งให้อินพุท 10 V. ปรับ VR 1K ให้ SCR2 ON

และขณะให้อินพุท 9 V.

-เมื่อแรงดันปกติ SCR2 จะ OFF ให้ออกจิก "0"

-เมื่อแรงดันเกิน (สูงจน) SCR2 จะ ON ให้ออกจิก "1"

รูปที่ 3.4

การปรับแรงดันให้ SCR ON, OFF โดยปรับ VR 1K (25 รอบ) ปรับละเอียด
กรณี 1 SCR ขณะปรับแต่งให้อินพุท = 9 V. ปรับ VR 1 K ให้ SCR1 ON
และขณะที่ใช้งานให้อินพุท = 9 V.

- เมื่อแรงดันปกติ SCR1 จะ ON ให้ลอจิก "1"
- เมื่อแรงดันลดลง SCR1 จะ OFF ให้ลอจิก "0"

กรณี 2 SCR2 ขณะปรับแต่งให้อินพุท 10 V. ปรับ VR 1K ให้ SCR2 ON
และขณะที่ใช้งานให้อินพุท 9 V.

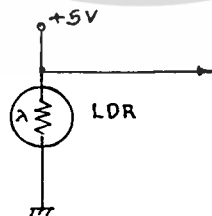
- เมื่อแรงดันปกติ SCR2 จะ OFF ให้ลอจิก "0"
- เมื่อแรงดันเกิน (สูงชน) SCR2 จะ ON ให้ลอจิก "1"

จากกรณี 1 นำมาผ่าน inverter เพื่อให้แสดงผลในภาวะแรงดันลดลง คือ
เมื่อแรงดันลดลง จะให้แสดงลอจิก "1" และภาวะปกติจะให้ลอจิก "0"

จากกรณี 2 นำมาผ่าน inverter 2 ตัว เพื่อให้แสดงผลในภาวะแรงดัน
เกิน (และให้เอาท์พุท เป็นสแควร์เวฟหลายๆรอบ) คือ ขณะเมื่อแรงดันเกินค่าที่ตั้งไว้ จะให้
แสดงลอจิก "1" และในภาวะปกติจะเป็นลอจิก "0"

การทำงานของความต้านทานไวแสง

ได้นำ LDR ความต้านทานที่เปลี่ยนค่าตามความเข้มของแสงสามารถนำมาใช้
เป็นอุปกรณ์สวิตช์ โดยต่อวงจรดังรูปที่ 3.5 เมื่อ LDR ถูกแสงทำให้ค่าความต้านทานลดลง
เป็นผลให้สวิตช์อยู่ในลักษณะปิด และเมื่อ LDR ไม่ถูกแสงก็จะทำให้ค่าความต้านทานสูงขึ้น
เป็นผลให้สวิตช์อยู่ในลักษณะเปิด

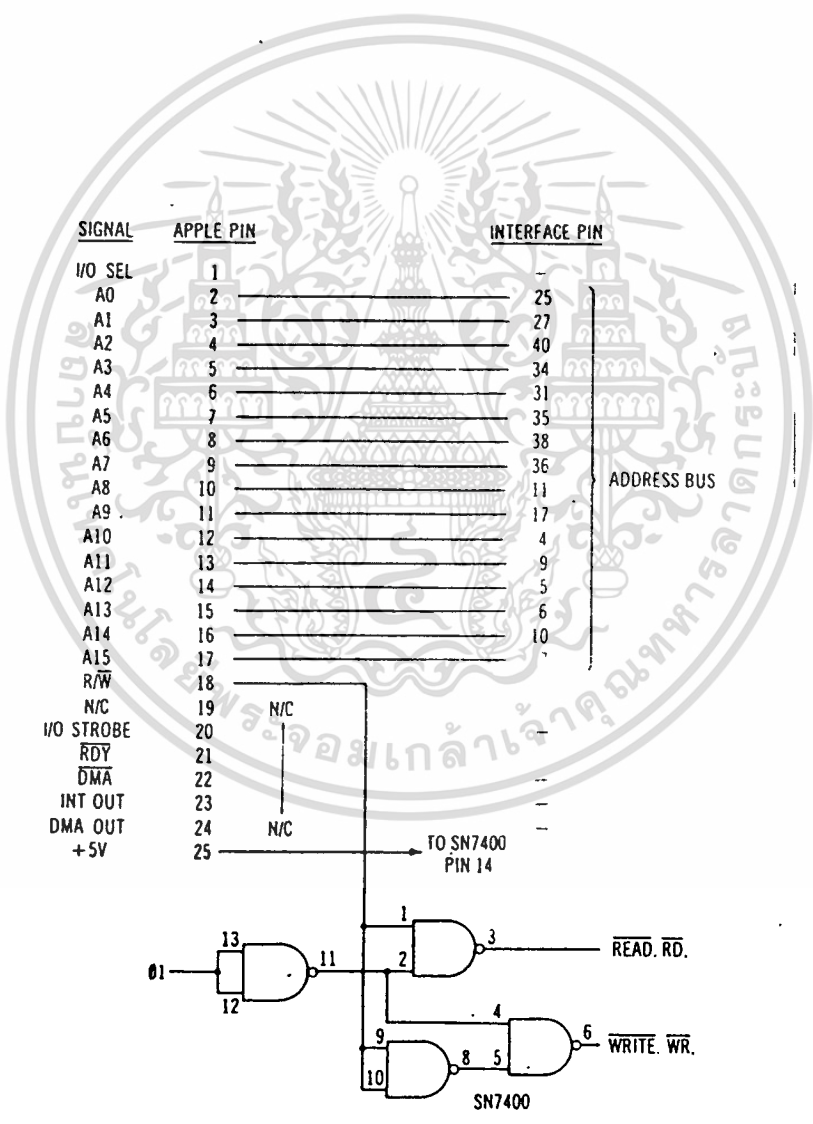


รูปที่ 3.5

การทดลอง เมื่อต่อวงจรดังรูป สามารถนำ LDR

มาใช้เป็นเซ็นเซอร์

สำหรับระบบรักษาความปลอดภัย มีเอาต์พุตดังนี้ ขณะถูกแสงจะให้เอาต์พุตลอจิกต่ำ และเมื่อบังแสงไว้จะให้เอาต์พุตลอจิกสูง



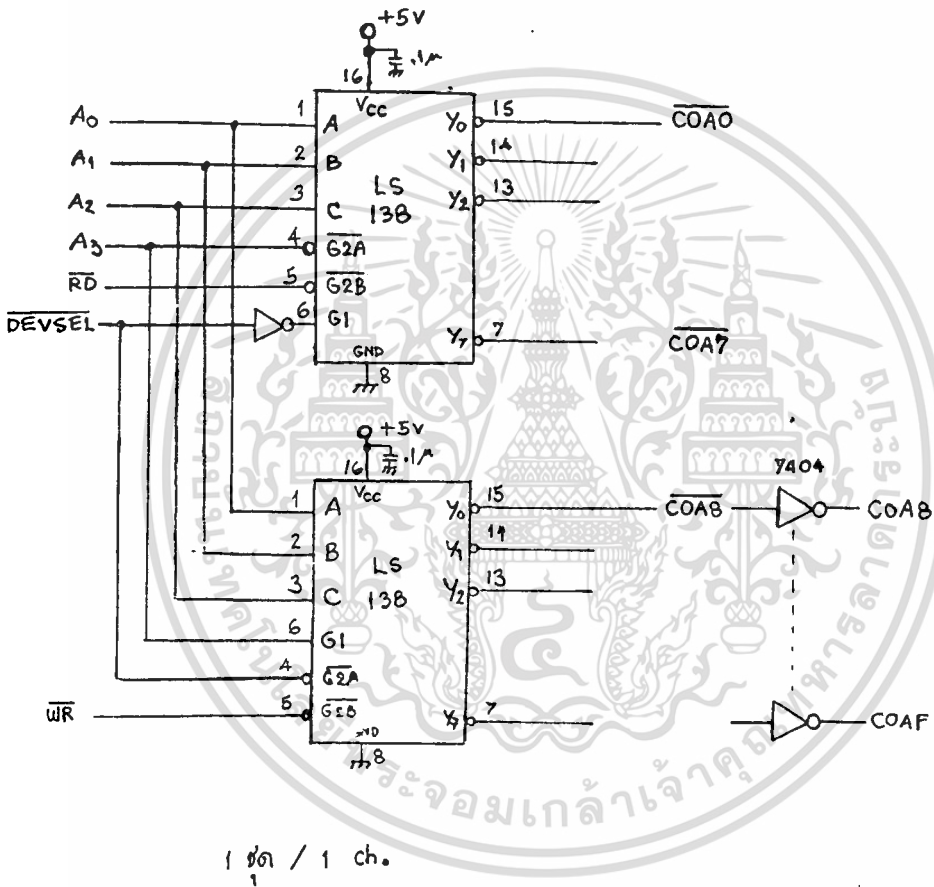
2 การออกแบบชุดอินเทอร์เฟซ

ในการออกแบบชุดอินเทอร์เฟซ เพื่อให้ง่ายต่อการเขียนโปรแกรมควบคุม โดยนำมาใช้ร่วมกับไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II เพื่อแสดงผลทอพอกราฟด้วย ทำให้สะดวกต่อการค้นหาจุดเกิดเหตุ โดยการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงกราฟฟิก และข้อมูลของภาพหรือรูปภาพพิกเซล จะแสดงผลทอพอกราฟของอุปกรณ์เช่น เซอร์เพื่อง่ายต่อการดูผล โดยดูทางจอ MONITOR และเอาท์พุทยังใช้วิธีควบคุมจุดต่อจุด และเป็นการนำเอาเครื่อง APPLE II มาใช้ประโยชน์ในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยใช้ชุดอินเทอร์เฟซชุดนี้ ต่อผ่านทาง SLOT 2 ของ APPLE II โดยเพิ่มโปรแกรมควบคุมอีกเล็กน้อย (ทางด้านกราฟฟิกเป็นส่วนใหญ่) ดังจะกล่าวต่อไป

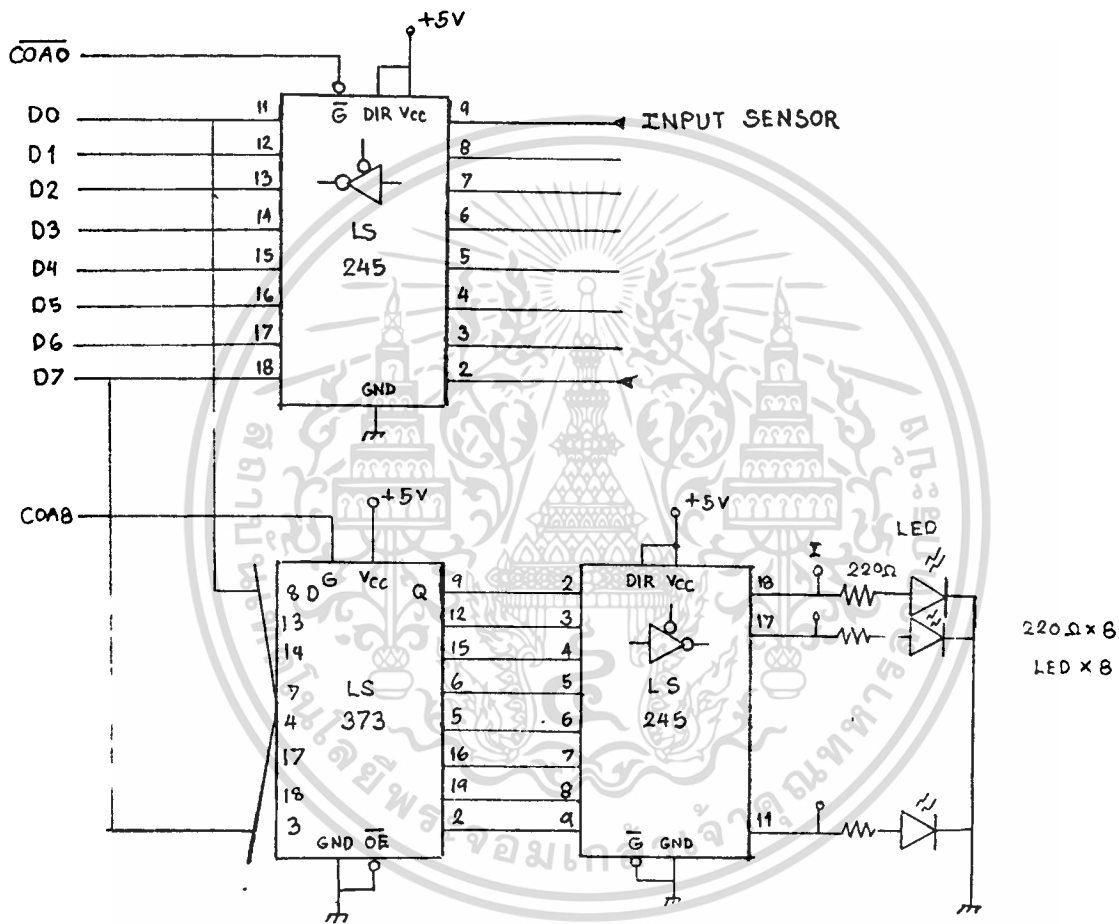
การออกแบบชุดอินเทอร์เฟซนี้ใช้ ดิจิตอล IC ประเภท TTL ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พอร์ทเฉพาะเบอร์ เช่น 6522 ซึ่งเป็นพอร์ทสำหรับ 6502 CPU ทั้งนี้เพราะการเขียนโปรแกรมควบคุมยากขึ้น และการขยายระบบยากขึ้น หรือ ถ้าจะนำไปใช้ร่วมกับไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่ใช้ CPU เบอร์อื่น ก็จะไม่สามารถทำได้ง่าย การออกแบบชุดอินเทอร์เฟซนี้สามารถที่จะนำมาพัฒนาระบบต่อไปได้ง่าย และสามารถดัดแปลงเพียงเล็กน้อยก็สามารถ นำชุดอินเทอร์เฟซนี้ ไปใช้ร่วมกับไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือเครื่อง 16 บิต IBM PC ซึ่งการเขียนโปรแกรมควบคุมก็สามารถทำได้ง่าย วงจรดังรูป 3.6

การทำงาน

จากวงจรสัญญาณควบคุมที่ใช้ได้แก่ O1, R/W, DEVICE SELECT, AO-A3 บกตีในช่วงการ R/W หน่วยความจำสัญญาณ O1 จะเป็นลอจิกต่ำ เมื่อผ่าน NAND GATE ได้แยกสัญญาณออกเป็น RD และ WR จากนั้นนำสัญญาณทั้งหมดทอพอกราฟมาข้างต้น เข้าสู่วงจรถัดไคต์เตอร์ โดยใช้ IC TTL 74LS138 ตัวบนจะแอดดัพในช่วงการ READ ส่วนตัวล่างจะแอดดัพในช่วงการ WRITE จะไดคิต์ตำแหน่งแอดเดรส COAO - COAF ซึ่งใช้สัญญาณ DEVICE SELECT ในสล็อต 2 (COAO - COAF) มาควบคุม ในการอ่านข้อมูลจะอ่านที่ตำแหน่ง COAO-COAF ซึ่งต่อได้ 8 ชุด และในการเขียนหรือการส่งข้อมูลจะส่งไปที่ตำแหน่ง COAB-COAF ซึ่งต่อได้ 8 ชุดเช่นกัน

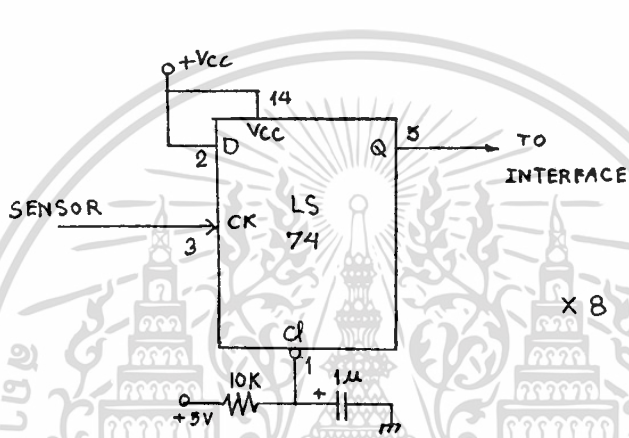


รูป 3.6a วงจร Decoder



รูปที่ 3.6b วงจรควบคุม
รูปที่ 3.6 วงจรภาค INTERFACE

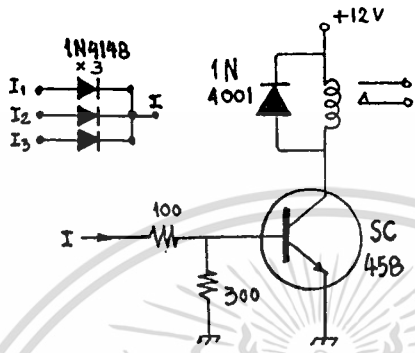
ในการอ่านข้อมูลจากอินพุตซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ จะผ่านวงจร LATCH IC TTL 74LS74 โดยจะให้เอาพุต Q เป็น "1" ขณะที่มีสัญญาณอินพุต ดังรูป 3.7 จากนั้นจะเข้าสู่ BUFFER IC TTL 74LS245 ทำหน้าที่แยกส่วนอินพุตและเอาพุตออกจากกันและทำหน้าที่เป็นอินพุตของวงจร ส่วนเอาพุตของวงจรใช้ LATCH IC TTL 74LS373 เพื่อ LATCH ข้อมูลทางเอาพุตและขยายกระแสด้วย IC TTL 74LS245 เข้าสู่ภาคเอาพุตควบคุมต่อไป



รูปที่ 3.7 LATCH INPUT

3 ภาคเอาพุตควบคุม

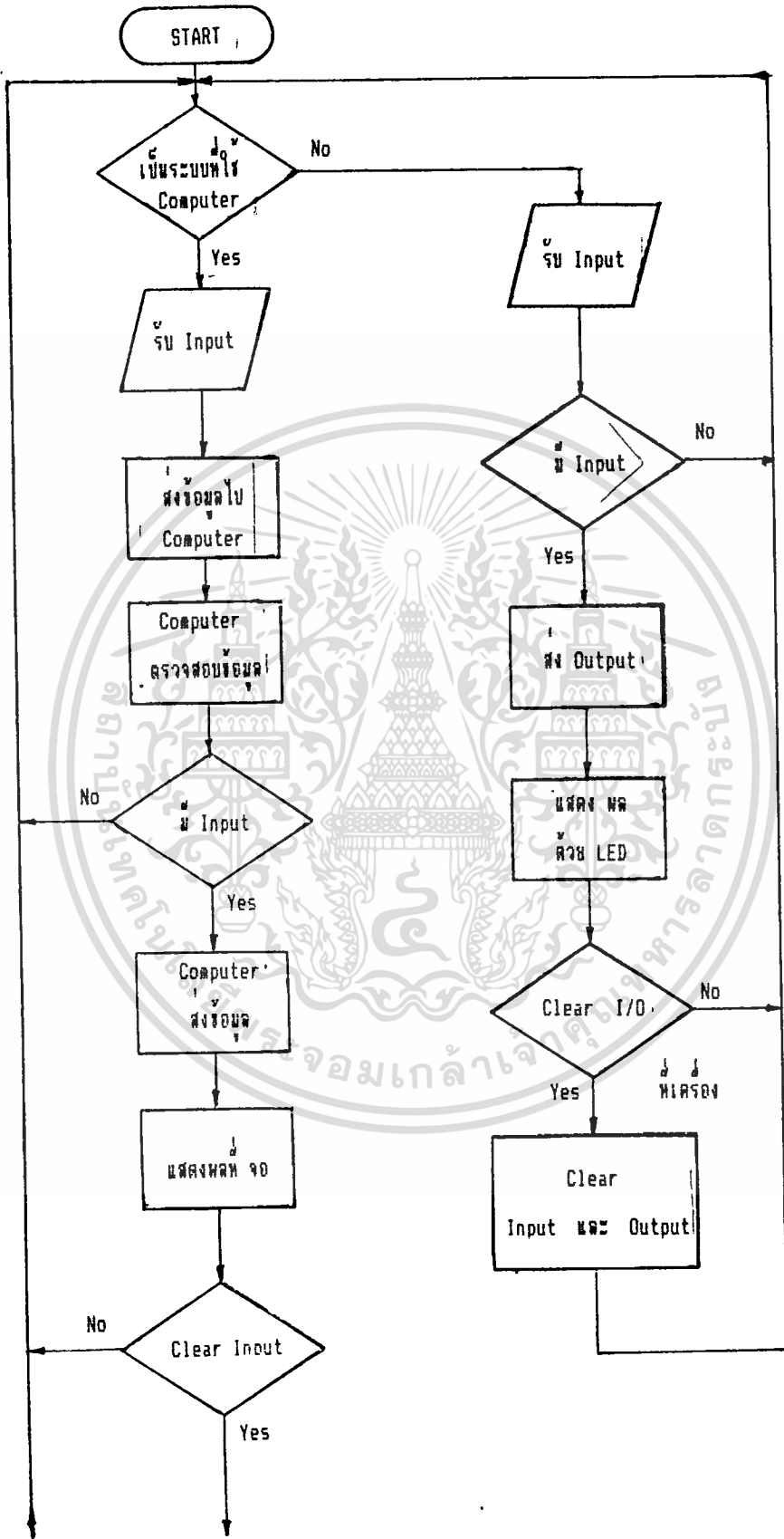
การควบคุมเอาพุตเพื่อป้องกันในระบบรักษาความปลอดภัย ในชุดนี้ได้ใช้วงจรขยาย TR เพื่อขยับแรง ใช้สำหรับการเตือนภัยต่าง ๆ เช่น สำหรับเปิด-ปิด โซลินอยล์ วาล์ว เพื่อเปิดน้ำในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ และส่งสัญญาณเตือนภัย หรือตัดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งภาคเอาพุตสามารถใช้ วงจรอื่นแทนได้ เช่น ใช้ SCR หรือจะใช้อุปกรณ์ทางแสงทึบเข้ามาในบทที่ 1 แสดงภาคเอาพุตควบคุมดังรูปที่ 3.8

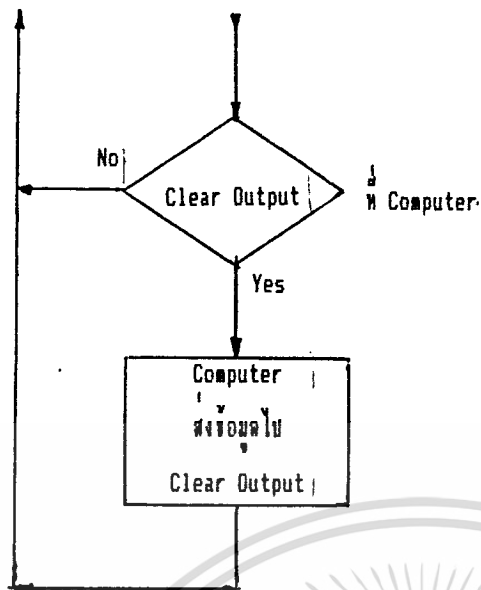


รูปที่ 3.8 ภาคเอาต์พุต

การทำงาน

อินพุตมาจากภาคอินเตอร์เฟส 74LS245 (output) เข้าสู่ เบส ของทรานซิสเตอร์ ในขณะที่มีสัญญาณเอาต์พุตจะทำให้ TR ON ทำให้ รีเลย์ต่อ และในขณะที่ไม่มีสัญญาณเอาต์พุต TR จะ OFF ทำให้ รีเลย์ตัด สัญญาณเอาต์พุตจะมีต่อเมอมสัญญาณอินพุตเข้ามาในระบบ โดยเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์จะส่งสัญญาณเอาต์พุตออกมาควบคุม





รูปที่ 3.9 FLOWCHART ของระบบรักษาความปลอดภัย

การทำงานของเครื่อง

เมื่อเป็นระบบ Direct โดยการปรับสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง DIRECT

1. เครื่องจะคอยรับอินพุท ของแต่ละชั้น
 2. เมื่อมีอินพุทเข้ามา จะส่งสัญญาณ ไปควบคุมที่เอาต์พุท และแสดงผลด้วย LED
 3. CLEAR อินพุทของ แต่ละชั้น โดยสวิตช์หน้าปัด
- เมื่อระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ โดยการปรับสวิตช์ไปที่ COMPUTER

1. เครื่องจะคอยรับอินพุท ของแต่ละชั้น
2. เมื่อไม่มีอินพุทจอภาพจะแสดงภาพของแต่ละชั้น เมื่อมีอินพุทเข้ามา จะส่ง เข้า ไปยังคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งสัญญาณ ไปควบคุมที่เอาต์พุท พร้อมทั้งแสดงผลจอ และที่ LED
4. CLEAR อินพุทของ แต่ละชั้น โดยสวิตช์หน้าปัด

CLEAR เอาต์พุทโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ (ESC)

ภาพแสดง เป็นตำแหน่งของอินพุทและสัญญาณ เตือนเอาต์พุท

4 การออกแบบโปรแกรมควบคุม

โปรแกรมมีส่วนสำคัญมาก เพราะต้องใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมด ของระบบรักษาความปลอดภัย โปรแกรมจะเป็นตัวดำเนินการทั้งหมด ซึ่งการรับ INPUT, ส่ง OUTPUT หรือการแสดงผลภาพ เมื่อโปรแกรมมีส่วนสำคัญ ดังนั้นต้องพิจารณาภาษาที่จะใช้จะต้องเป็นภาษาที่มการทำงานรวดเร็ว เนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยต้องการความรวดเร็วและต้องมีความแน่นอนสูง

ภาษาแอสเซมบลี (ASSEMBLY) ก็เป็นอีกภาษาหนึ่งมการทำงานที่รวดเร็วจึงเป็นภาษาที่นำมาใช้ควบคุมระบบนี้ ต่อมาก็จะมาพิจารณาถึงความต้องการของระบบโดยการแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ๆ ดังนี้

1. สามารถตรวจสอบสัญญาณ INPUT ที่เข้ามาได้พร้อมกันหลายๆ จุด
2. สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลของ INPUT หรือสภาวะทาง INPUT
3. จะต้องทำการแสดงผลหรือสภาวะที่เกิดออกทางจอภาพ
4. สามารถกลับไปรับสัญญาณจาก INPUT ได้อีก ถึงจะมี INPUT ตรงก่อนอยู่แล้วก็ตาม

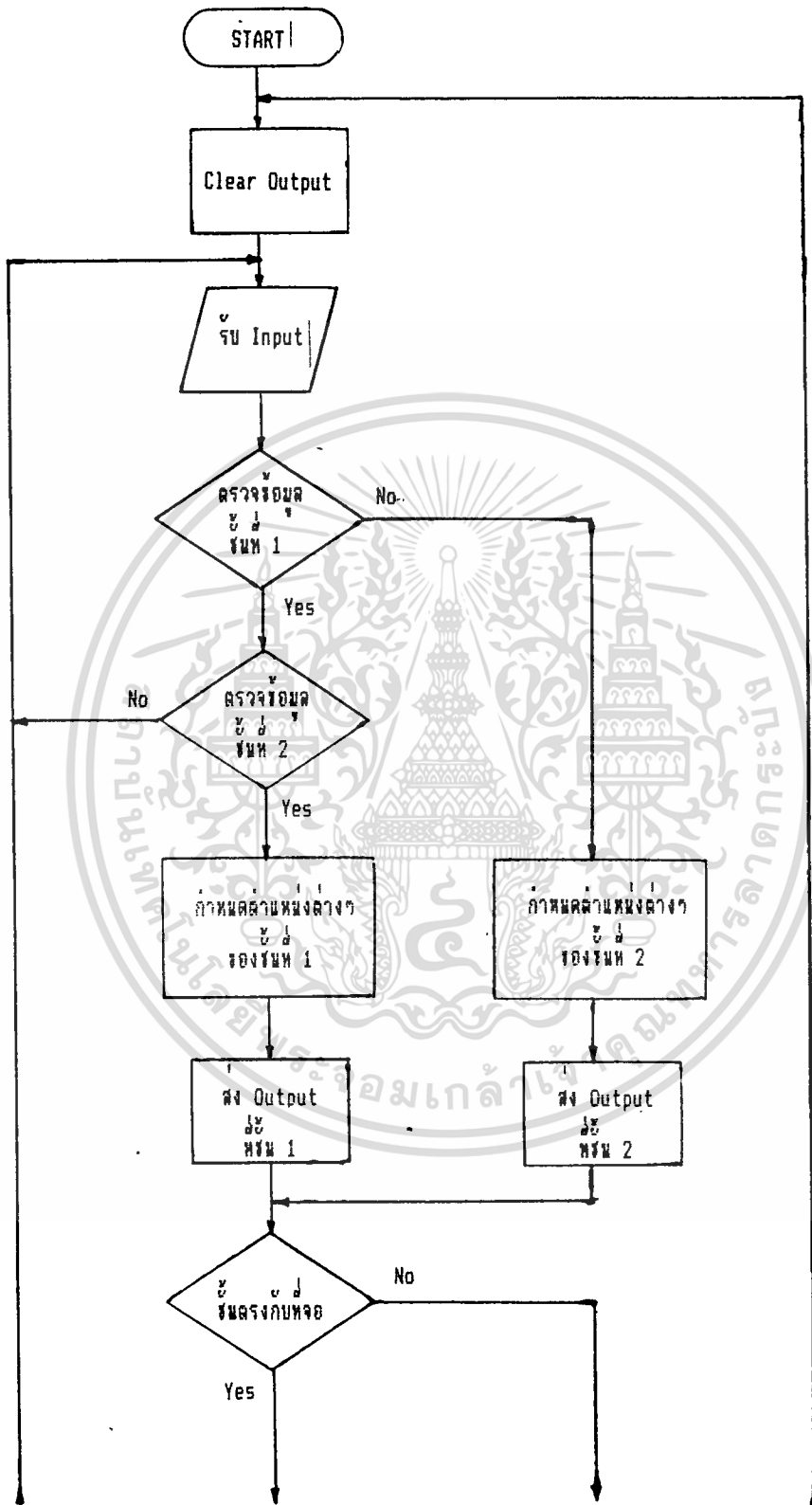
เมื่อได้รู้ถึงความต้องการของระบบแล้ว ก็ทำการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงาน (FLOW CHART) เพราะการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงาน ทำให้การเขียนโปรแกรมง่ายและสะดวกขึ้นอีกทั้งยังง่ายต่อการตรวจสอบแก้ไข ดังรูปที่ 3.10

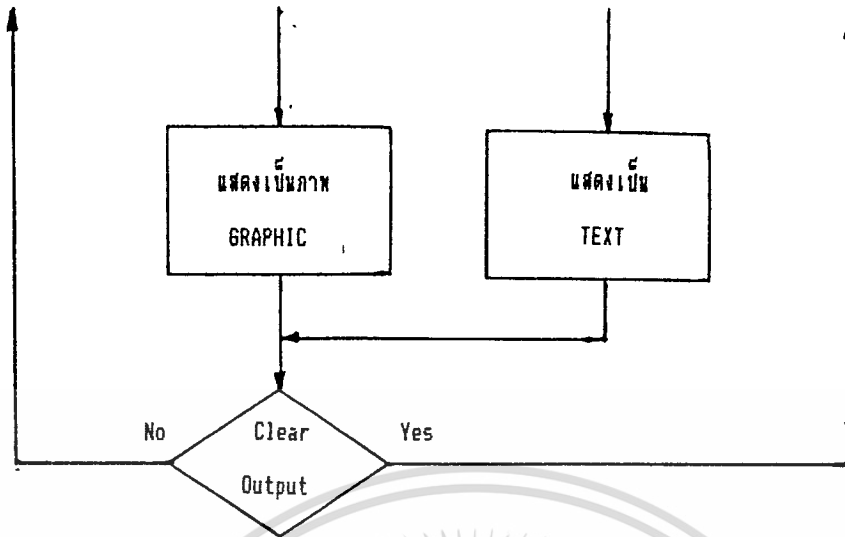
การทำงานของโปรแกรม

1. เริ่มโปรแกรมที่ ADDRESS #6000
2. ทำการแสดงผลแบบจำลองของสถานี
3. ทำการ CLEAR OUTPUT และข้อมูล INPUT ที่อยู่ในหน่วยความจำ
4. รอรับสัญญาณจาก INPUT ทั้ง 8 จุดพร้อมกัน
5. ทำการตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 ชั้น ความสัญญาณ INPUT เข้ามาหรือไม่
6. ถ้าไม่มีสัญญาณทั้ง 2 ชั้น ให้กลับไปรอรับสัญญาณที่ข้อ 4
7. ทำการตรวจสอบสภาวะ และกำหนดตำแหน่งต่างๆ ของภาพที่จะแสดงออกที่จอภาพ
8. ส่งข้อมูล INPUT ที่อยู่ในหน่วยความจำออกทาง OUTPUT
9. ตรวจสอบชั้นหม INPUT ตรงกับภาพที่แสดงบนจอภาพ

10. ถ้าไม่ตรงให้แสดงเป็น TEXT
11. แสดงภาพเป็น GRAPHIC
12. มีการ CLEAR OUTPUT หรือไม่
13. ถ้ามีกลับไปเริ่มข้อ 3
14. กลับไปรอสัญญาณ INPUT ข้อ 4







รูปที่ 3.10 FLOWCHART ของโปรแกรมควบคุมระบบ



```

!L 1 ; LISA VERSION 2.5G
2 *****
3 ** PROGRAM SECURITY SYSTEM **
4 ** BY : ELECTRONICS **
5 ** TECHNOLOGY **
6 ** MAJOR : INDUSTRIAL **
7 ** KING MONGKUT'S INSTITUTE **
8 ** OF TECHNOLOGY LADKRABANG **
9 *****
10 ;
11 ; START PROGRAM AT $6000
12 ;
13 DRG $6000
14 OBJ $6000
15 ; STACK
16 IPL EPZ $00
17 IPH EPZ $01
18 OPL EPZ $02
19 OPH EPZ $03
20 STL EPZ $04
21 STH EPZ $05
22 DPL EPZ $06
23 DPH EPZ $07
24 GRA EPZ $08
25 JP EPZ $09
26 JF1 EPZ $0A
27 JF2 EPZ $0B
28 CHX EPZ $0C
29 CLSS EPZ $0D
30 CLASS EPZ $0E
31 JX EPZ $0F
32 DDRAW EPZ $10
33 LOOP1 EPZ $11
34 LOOP2 EPZ $12
35 LOOP3 EPZ $13
36 DEPTH EPZ $14
37 PAGE EPZ $15
38 LENG EPZ $16
39 LOC EPZ $17
40 RD EPZ $18
41 DATA EPZ $1A
42 PIC1 EPZ $20
43 PIC2 EPZ $28
44 HOR EPZ $30
45 VER EPZ $38
46 LOOP4 EPZ $50
47 SD EPZ $40
48 KEY EQU $C000
49 CLKEY EQU $C010
50 SOU EQU $C030

```

```

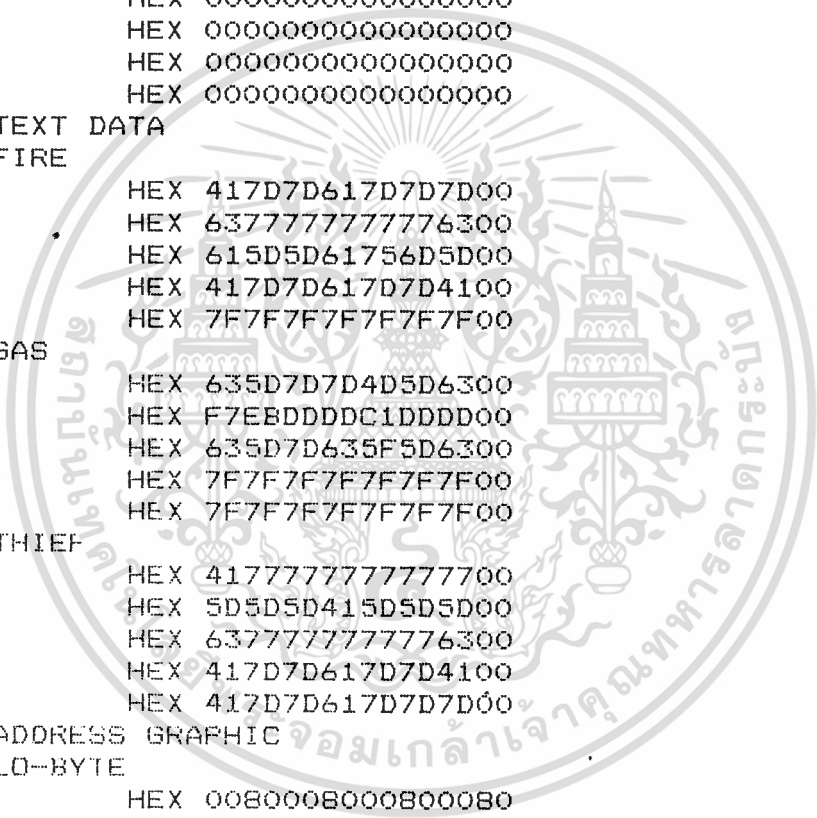
51 S1      EQU  $C050
52 S2      EQU  $C057
53 S3      EQU  $C054
54 S4      EQU  $C055
55 S5      EQU  $C053
56 S6      EQU  $C052
57 ;
58 ; START PROGRAM
59 ;
60      JMP  START
61 ;
62 *****
63 **      DATA SCAN PICTURE  **
64 *****
65 ;
66 ; APPLE
67      HEX  0408183E1F7F3E1C
68      HEX  0000000000000000
69 ; THIEF
70      HEX  0000000000000000
71      HEX  387C546C3810385E
72      HEX  0000000000000001
73      HEX  0000407E18100000
74      HEX  5F6D6C7650727A6A
75      HEX  0302060404050504
76      HEX  0000000000000000
77      HEX  6C6C6C6C28286C6E
78      HEX  0000000000000000
79 ; FIRE
80      HEX  0000000000000000
81      HEX  0000000010181834
82      HEX  0000000000000001
83      HEX  002060244C586850
84      HEX  5A4A66331B596C32
85      HEX  01010021313A161A
86      HEX  505027592E786000
87      HEX  27331A2E5B365947
88      HEX  0D09754E39070100
89 ; GAS
90      HEX  0000000000000000
91      HEX  0205050A0A0C3F33
92      HEX  0000000000000000
93      HEX  0000406060202020
94      HEX  3F377B7F40044E64
95      HEX  0000000101010101
96      HEX  7020202060406060
97      HEX  7F204E607F7F4C7F
98      HEX  0301010101000101
99 ;
100 *****

```

```

101 ** DATA CLEAR PICTURE **
102 *****
103 ;
104         HEX 0000000000000000
105         HEX 0000000000000000
106         HEX 0000000000000000
107         HEX 0000000000000000
108         HEX 0000000000000000
109         HEX 0000000000000000
110         HEX 0000000000000000
111         HEX 0000000000000000
112         HEX 0000000000000000
113         HEX 0000000000000000
114 ; TEXT DATA
115 ; FIRE
116         HEX 417D7D617D7D7D00
117         HEX 6377777777776300
118         HEX 615D5D61756D5D00
119         HEX 417D7D617D7D4100
120         HEX 7F7F7F7F7F7F7F00
121 ; GAS
122         HEX 635D7D7D4D5D6300
123         HEX F7EBDDDDC1DDDD00
124         HEX 635D7D635F5D6300
125         HEX 7F7F7F7F7F7F7F00
126         HEX 7F7F7F7F7F7F7F00
127 ; THIEF
128         HEX 4177777777777700
129         HEX 5D5D5D415D5D5D00
130         HEX 6377777777776300
131         HEX 417D7D617D7D4100
132         HEX 417D7D617D7D7D00
133 ; ADDRESS GRAPHIC
134 ; LO-BYTE
135 GL         HEX 0080008000800080
136         HEX 28A828A828A828A8
137         HEX 50D050D050D050D0
138 ; HI-BYTE
139 GH         HEX 2020212122222323
140         HEX 2020212122222323
141         HEX 2020212122222323
142 ; TABLE ADDRESS
143 ; LO-BYTE
144 TABL       HEX EB135BA33B638B
145 ; HI-BYTE
146 TABH       HEX 60606060616161
147 ;
148 ; LOCATE OF PICTURE
149 ;
150 HOR1       HEX 0510051817051709
151 HOR2       HEX 050A1805050A1806

```



```

152 ;
153 VER1      HEX 050511050F050C11
154 VER2      HEX 0511120D05111212
155 ;
156 HORT      HEX 1D1D1D1D1D1D1D1D
157 VERT      HEX 0405060708090A0B
158 ;
159 START     CLC                                ;CLEAR CARRY FLAG
160           LDA S1                             ;SET GRAPHIC
161           LDA S2                             ;MODE HI-RES
162           LDA S3                             ;PAGE 1
163           LDA #$03                           ;
164           STA LENG                           ;LOAD LENGTH
165           LDA #$00                           ;
166           STA PAGE                           ;SET PAGE
167           LDX #$A0                           ;LOAD INPUT LO
168           LDY #$AB                           ;LOAD OUTPUT LO
169           LDA #$C0                           ;LOAD I/O HI
170           STX IPL                           ;
171           STY OPL                           ;
172           STA IPH                           ;
173           STA OPH                           ;
174 *****
175 ** CLEAR OUTPUT **
176 *****
177 ;
178 CLOP      LDA #$00                           ;CLEAR DATA
179           STA PAGE                           ;
180           STA DATA                          ;CLASS 1 AND
181           STA DATA+1                        ;CLASS 2
182           LDY #$00                           ;
183 COP       STY LOOP4                          ;
184           LDA #$00                           ;CLEAR
185           STA (OPL),Y                         ;OUTPUT
186           JSR CLETX
187           LDY LOOP4
188           INY                                ;CLASS 1 AND
189           CFY #$02                            ;CLASS 2
190           BNE COP
191           LDA #$20
192           STA PAGE
193           JSR CLETX
194           LDA #$00
195           STA PAGE
196           LDX #$00
197 CP        LDA #$00
198           STA SD+1,X                          ;CLEAR DATA
199           STA FIC1,X                          ;CLEAR PICTURE
200           STA FIC2,X
201           STA HOR,X                          ;CLEAR HOR

```

```

202          STA VER,X          ;CLEAR VER
203          INX
204          CPX #$08
205          BNE CF
206 ; CLEAY KEY
207          LDA CLKEY
208 ; WAIT INPUT
209 INPUT    CLC                ;CLEAR CARRY
210          JSR APPLE          ;JUMP SCAN PICTURE
211 ;
212 *****
213 **      WAIT INPUT      **
214 *****
215 ;
216          LDX #$00
217          LDY #$00
218          STX JX
219 LOIN     LDA (IPL),Y
220          ORA DATA,X
221          STA DATA,X
222          LDA KEY
223          CMP #$B1
224          BEQ CLASS1
225          CMP #$B2
226          BEQ CLASS2
227          INC JX
228          LDY JX
229          LDX JX
230          CPX #$02
231          BNE LOIN
232          LDX #$00
233          STX LOOP4
234 CXIN     LDA #$00
235          LDX LOOP4
236          CPX #$02
237          BEQ IN
238          CMP DATA,X
239          BNE IN1
240          INC LOOP4
241          LDX LOOP4
242          CPX #$02
243          BNE CXIN
244 IN      JMP INPUT
245 CLASS1  LDA CLKEY
246          LDA S3
247          LDA #$00
248          STA PAGE
249          LDA #$00
250          STA CLSS
251          JMP INPUT

```

```

252 CLASS2    LDA CLKEY
253          LDA S4
254          LDA #$20
255          STA PAGE
256          LDA #$01
257          STA CLSS
258          JMP INPUT
259 IN1       INC LOOP4
260          STX CLASS
261          LDA IFL          ;LOAD INPUT LO-BYTE
262          CLC              ;CLEAR CARRY FLAG
263          ADC CLASS        ;
264          STA CHX          ;STORE IN CHX
265          CMP #$A0         ;COMPARE CLASS
266          BEQ CL1         ;
267          CMP #$A1         ;1 OR 2
268          BEQ CL2         ;
269          JMP INPUT
270 CL1       LDA S3          ;CALL GRAPHIC
271          LDA #$00         ;LOAD VALUE 0
272          CMP CLSS
273          BEQ OUT
274 CL2       LDA S4
275          LDA #$01
276          CMP CLSS
277          BEQ OUT
278          JMP CL1
279 ;
280 *****
281 **  OUTPUT INTERFACE  **
282 **  CONTROL          **
283 *****
284 ;
285 OUT       LDX #$00
286          LDY #$00
287 OUTPUT    LDA DATA,X
288          STA (OPL),Y
289          INX
290          INY
291          CPY #$02
292          BNE OUTPUT
293          JSR CHECK
294          LDA CLSS          ;
295          CMP CLASS        ;
296          BNE DT
297          JSR SHAPE
298          JSR SOUND
299          JSR CLPIC
300          JSR DELAY

```

```

301 ESC          LDA KEY          ;CHECK KEYBOARD
302              CMP #9B          ; 'ESC'
303              BEQ CLR
304              JMP CXIN
305 CLR          JMP CLOP
306 DT           JSR SOUND
307              JSR DELAY
308              JMP ESC
309 ;
310 *****
311 **          SCAN PICTURE      **
312 *****
313 ;
314 SCAN          LDX #00
315 SC1           LDA (STL,X)      ;LOAD PICTURE
316              STA (DPL),Y      ;SAVE AT GRAP
317              INC STL          ;ADD LO-BYTE
318              BNE CO           ;CARRY = 0
319              INC STH          ;ADD HI-BYTE
320 CO           LDA DPH          ;LOAD HI-BYTE
321              CLC              ;CLEAR CARRY
322              ADC #04          ;ADD ADDR GRAP
323              STA DPH          ;SAVE HI-BYTE
324              DEC DEPTH        ;DECREMENT
325              BNE SC1          ;DEPTH <> 0
326              RTS
327 ;
328 *****
329 **          CHECK INPUT        **
330 *****
331 ;
332 CHECK         CLC              ;CLEAR CARRY
333              LDA CLSS
334              CMP CLASS
335              BEQ NTXT
336              LDX CLASS
337              LDA DATA,X
338              CMP #00
339              BEQ NTXT
340              JMP TEXT
341 NTXT          LDX #00
342              STX JP
343              LDX CLASS
344              LDA DATA,X
345              STA RD
346 *****
347 **          SHIFT DATA        **
348 *****
349 ;
350              LDY #08
351 SHIFT         LDA RD
352 SH           ASL              ;SHIFT 1 BIT

```

```

353          BCS C1          ;CHECK CARRY
354          DEY             ;DECREMENT Y
355          BNE SH         ;Y = 0
356          RTS            ;RETURN
357 C1       STY LOOP2      ;SAVE Y
358          STA RD         ;SAVE DATA
359          LDA #00        ;
360 ROT      ROL            ;ROTATE CARRY
361          DEC LOOP2      ;DECREMENT LOOP2
362          BNE ROT        ;LOOP1 = 0
363          JMP CHX2
364 ;
365 *****
366 ** SET LOCATION AND **
367 ** DRAW PICTURE **
368 *****
369 ;
370 SETLO    LDX JP1        ;
371          LDA TABL,X      ;LOAD LOCATE PIC.
372          STA STL        ;SAVE AT STL
373          LDA TABH,X      ;
374          STA STH        ;HI-BYTE
375          LDX VER        ;LOAD VERTICAL
376          STX JP2        ;
377 SETO     LDA GL,X       ;GRAPH LO-BYTE
378          CLC            ;
379          ADC HOR        ;ADD LO WITH HOR
380          STA DPL        ;SAVE LO-BYTE
381          LDA GH,X       ;GRAPH HI-BYTE
382          CLC            ;
383          ADC PAGE       ;
384          STA GRA        ;
385          LDY #00        ;
386 SET1     JSR DRAW       ;DRAW ON MONITOR
387          JSR SCAN       ;
388          INY            ;
389          CPY LENG       ;CHECK LENGTH
390          BNE SET1       ;
391          LDX LOC        ;
392          INC JP2        ;
393          LDX JP2        ;
394          DEC LOOP1      ;DECREMENT LOOP1
395          BNE SETO       ;
396          RTS            ;
397 *****
398 ** CHECK INPUT DATA **
399 ** FIRE, GAS, THIEF **
400 *****
401 CHX2     CMP #80        ; -

```

```

402          BNE SE1          ;DATA <> 80
403          LDX #$00        ;LOAD TABLE
404          LDA #$02        ;LOAD PIC.FIRE
405          JMP TABLE
406 SE1      CMP #$40        ;
407          BNE SE2        ;DATA <> 40
408          LDX #$01        ;LOAD TABLE
409          LDA #$02        ;LOAD PIC.FIRE
410          JMP TABLE
411 SE2      CMP #$20        ;
412          BNE SE3        ;DATA <> 20
413          LDX #$02        ;LOAD TABLE
414          LDA #$03        ;LOAD PIC.GAS
415          JMP TABLE
416 SE3      CMP #$10        ;
417          BNE SE4        ;DATA <> 10
418          LDX #$03        ;LOAD TABLE
419          LDA #$01        ;LOAD PIC.THIEF
420          JMP TABLE
421 SE4      CMP #$08        ;
422          BNE SE5        ;DATA <> 08
423          LDX #$04        ;LOAD TABLE
424          LDA #$01        ;LOAD PIC.THIEF
425          JMP TABLE
426 SE5      CMP #$04        ;
427          BNE SE6        ;DATA <> 04
428          LDX #$05        ;LOAD TABLE
429          LDA #$01        ;LOAD PIC.THIEF
430          JMP TABLE
431 SE6      CMP #$02        ;
432          BNE SE7        ;DATA <> 02
433          LDX #$06        ;LOAD TABLE
434          LDA #$01        ;LOAD PIC.THIEF
435          JMP TABLE
436 SE7      CMP #$01        ;
437          BNE ECHX2      ;DATA <> 01
438          LDX #$07        ;LOAD TABLE
439          LDA #$01        ;LOAD PIC.THIEF
440          JMP TABLE
441 ECHX2    RTS
442 *****
443 **      SUB TABLE      **
444 *****
445 ;
446 TABLE   LDY #$00        ;
447          CPY CLASS      ;CHECK CLASS
448          BNE CLS2      ;
449          STA PIC1      ;SAVE PIC.
450          LDA VER1,X     ;
451          STA VER        ;SAVE VER.1

```

```

452          LDA HOR1,X          ;
453          STA HOR              ;SAVE HOR.1
454          RTS
455  CLS2     STA PIC2            ;SAVE PIC.2
456          LDA VER2,X          ;
457          STA VER              ;SAVE VER.2
458          LDA HOR2,X          ;
459          STA HOR              ;SAVE HOR.2
460          RTS
461 ;
462 *****
463 **      SCAN PIC.APPLE      **
464 *****
465 ;
466  APPLE    LDA #$02            ;
467          STA DDRAW            ;
468          LDX #$03            ;LO-BYTE TABLE
469          LDY #$60            ;HI-BYTE TABLE
470          STX STL              ;SAVE IN STL
471          STY STH              ;SAVE IN STH
472          LDX #$00            ;LO-BYTE GRAPH
473          STX DFL              ;SAVE GRAPH
474          LDA #$20            ;HI-BYTE GRAPH
475          CLC                  ;CLEAR CARRY
476          ADC PAGE            ;SET PAGE
477          STA GRA              ;SAVE HI-BYTE
478  F1       JSR DRAW            ;SCAN PICTURE
479          LDY #$00
480          JSR SCAN
481          JSR DELAY            ;DELAY
482          DEC DDRAW            ;DECREMENT DDRAW
483          BNE F1              ;DDRAW = 00
484          RTS                  ;END SUBROUTINE
485 ;
486 *****
487 **      DRAW ON MONITOR      **
488 *****
489 ;
490  DRAW     LDX #$08            ;LOAD DEPTH
491          STX DEPTH            ;SAVE X
492          LDA GRA              ;LOAD HI-BYTE
493          STA DPH
494          RTS
495 ;
496 *****
497 **      LOAD SHAPE TABLE    **
498 *****
499 ;
500  SHAPE    LDY #$00            ;

```

```

501          CPY CLASS          ;CHECK CLASS
502          BNE CLSS2          ;
503          LDA PIC1           ;LOAD PIC.1
504          STA JP1            ;
505          JMP SETP           ;JUMP SETUP
506 CLSS2    LDA PIC2           ;LOAD PIC.2
507          STA JP1            ;
508 SETP     LDA #$03           ;LOAD LENG
509          STA LOOP1          ;SAVE IN LOOP1
510          JSR SETLO          ;SET LOCATION
511          RTS
512 ;
513 *****
514 **          SOUND          **
515 *****
516 ;
517 SOUND     LDX #$B0
518 SDOU      LDY #$70
519          LDA SOU             ;ADDRESS SOUND
520 SOU1      DEY                ;DECREMENT Y
521          BNE SOU1
522          DEX                 ;DECREMENT X
523          BNE SDOU
524          RTS
525 ;
526 *****
527 **          DELAY          **
528 *****
529 ;
530 DELAY     LDX #$A0
531 DELO      LDY #$00
532 DEL1      DEY
533          BNE DEL1
534          DEX
535          BNE DELO
536          RTS
537 *****
538 **          CLEAR PICTURE  **
539 *****
540 ;
541 CLPIC     LDA #$00          ;
542          STA PIC1           ;CLEAR PIC.1
543          STA PIC2           ;CLEAR PIC.2
544          JSR SHAPE          ;
545          RTS
546 ;
547 *****
548 **          LOAD TABLE TEXT  **
549 *****
550 ;
551 TBT      LDY #$00          ;

```

```

552          CPY CLASS          ;CHECK CLASS
553          BNE CS3
554          STA PIC1          ;SAVE TEXT.1
555          JMP CS4
556 CS3      STA PIC2          ;SAVE TEXT.2
557 CS4      LDA VERT,X        ;LOAD VER TEXT
558          STA VER
559          LDA HORT,X        ;LOAD HOR TEXT
560          STA HOR
561          JMP SHATX
562 ;
563 *****
564 **   DISPLAY TEXT   **
565 *****
566 ;
567 TEXT      LDX CLASS
568          LDA DATA,X
569          STA RD
570          LDY #$08          ;
571 SHITX     LDA RD            ;LOAD DATA
572          STY LOOP3
573 ST        ASL
574          BCS CT            ;CARRY SET
575          DEY
576          BNE ST            ;
577          RTS
578 CT        STY LOOP2        ;
579          STY LOOP3
580          STA RD
581          LDA #$00
582 ROTT      ROL              ;ROTATE DATA
583          DEC LOOP2
584          BNE ROTT
585          JSR CHXT
586          LDY LOOP3
587          DEY
588          BNE SHITX
589 ;
590 *****
591 **   SET TEXT   **
592 *****
593 ;
594 SHATX     LDY #$00
595          CPY CLASS
596          BNE CS5
597          LDA PIC1          ;LOAD TEXT
598          STA JP1          ;SAVE TEXT
599          JMP SETXT

```

```

600 CS5      LDA PIC2      ;
601          STA JP1
602 ;
603 *****
604 **  SCAN  TEXT  **
605 *****
606 ;
607 SETXT     LDX JP1      ;LOAD PIC. TEXT
608          LDA TABL,X    ;LOAD LO-BYTE
609          STA STL      ;
610          LDA TABH,X    ;LOAD HI-BYTE
611          STA STH      ;
612          LDX VER      ;LOAD VERTICAL
613          LDA GL,X     ;LOAD GRAPH LO-BYTE
614          CLC          ;CLEAR CARRY
615          ADC HOR      ;GRAPH LO+HOR
616          STA DPL      ;SAVE GRAPH LO-BYTE
617          LDA GH,X     ;LOAD GRAPH HI-BYTE
618          CLC          ;CLEAR CARRY
619          ADC PAGE     ;GRAPH HI+PAGE
620          STA GRA      ;SAVE GRAPH HI-BYTE
621          LDY #$00
622 SET2      JSR DRAW
623          JSR SCAN
624          INY
625          CPY #$05
626          BNE SET2
627          RTS
628 ;
629 *****
630 **  CHECK TEXT  **
631 *****
632 ;
633 CHXT      CMP #$80
634          BNE SE8
635          LDX #$00
636          LDA #$04
637          JMP TBT
638 SE8       CMP #$40
639          BNE SE9
640          LDX #$01
641          LDA #$04
642          JMP TBT
643 SE9       CMP #$20
644          BNE SE10
645          LDX #$02
646          LDA #$05
647          JMP TBT
648 SE10      CMP #$10
649          BNE SE11
650          LDX #$03

```

```

651          LDA  ##06
652          JMP  TBT
653 SE11     CMP  ##08
654          BNE  SE12
655          LDX  ##04
656          LDA  ##06
657          JMP  TBT
658 SE12     CMP  ##04
659          BNE  SE13
660          LDX  ##05
661          LDA  ##06
662          JMP  TBT
663 SE13     CMP  ##02
664          BNE  SE14
665          LDX  ##06
666          LDA  ##06
667          JMP  TBT
668 SE14     CMP  ##01
669          BNE  ECHX3
670          LDX  ##07
671          LDA  ##06
672          JMP  TBT
673 ECHX3    RTS
674 CLETX    LDA  ##00
675          STA  PIC1
676          STA  PIC2
677          STA  JP1
678 CTX2     LDX  ##00
679 CTX1     STX  LOOP3
680          LDA  VERT, X
681          STA  VER
682          LDA  HORT, X
683          STA  HOR
684          JSR  SETXT
685          INC  LOOP3
686          LDX  LOOP3
687          CFX  ##08
688          BNE  CTX1
689          RTS
690          END

```

บทที่ 4

บทสรุป

จากการทดลอง ระบบได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้งานสำหรับ เป็นระบบรักษาความปลอดภัยด้วยคอมพิวเตอร์ภายในที่พักอาศัย ตามโรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน เป็นต้น เพื่อให้ระบบเป็นที่เชื่อถือได้จึงทำการทดลอง ทดสอบ และปรับแต่งจนสามารถใช้งานได้ดี โดยทำตามขั้นตอนและสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

สรุปผลขั้นตอนของโครงการนี้

1. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ ทำงานตามที่ได้ทดลองสามารถนำมาใช้งานร่วมกับ ระบบรักษาความปลอดภัย หรือต่อใช้งานร่วมกับระบบอื่น ๆ ได้ (ได้ผล ถูกต้อง ดี)
2. วงจรรับสัญญาณอินพุต ซึ่งจะ LATCH ข้อมูลทางด้านอินพุตไว้ โดยใช้ I.C. TTL 74LS74 รับสัญญาณจากอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแล้วมาเข้าที่ขา Ck ของ I.C. สามารถ Clear สัญญาณอินพุตได้ เอาท์พุทออกทางขา Q ของไอซีซึ่งจะให้เอาท์พุทเป็นลอจิก "1" ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอินพุตเข้ามาที่ขา Ck ดังวงจรในบทที่ 3 รูปที่ 3.7 เอาท์พุทที่ขา Q นำไปเข้าวงจรภาคอินเทอร์เฟสในบทที่ 3 รูปที่ 3.6 เมื่อทำการทดลองวงจร LATCH สัญญาณอินพุต จะให้ผลตามที่ได้ออกแบบไว้จริง โดยนำวงจรนี้มาใช้ในระบบ (ได้ผล ถูกต้อง)
3. ภาคอินเทอร์เฟส การทดลองได้ทำการทดลองบนแผ่น proto-board ประกอบด้วยวงจรตีโคตเตอร์ I/O การทดสอบภาคนี้เพื่อให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์จึงได้ทดลองกับเครื่อง ไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II การทดสอบภาคนี้ให้ต่อขาสัญญาณต่าง ๆ ที่ใช้ของวงจรเข้าทาง SLOT 2 และใช้โปรแกรมภาษาเบสิกทดสอบดังนี้

```

10 A = PEEK (49312)
20 POKE 49320,A
30 PRINT A
40 GOTO 10

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่นอนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ผลที่ได้จากการทดสอบเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้ สัญญาณอินพุตที่ใช้ทดสอบได้ ใช้ DIP Switch เป็นตัวกำหนดข้อมูลอินพุต ใช้ LED แสดงผลที่เอาต์พุต และให้พิมพ์ ข้อมูลออกหน้าจอภาพ (ได้ผล ถูกต้อง)

4. ภาคเอาต์พุตควบคุม ซึ่งการทำงานของวงจร ทราฟฟิเคเตอร์ จะทำหน้าที่เป็นสวิทช์ โดยการควบคุมทราฟฟิเคเตอร์ เบส ในการทดสอบภาคนี้โดยการบอวลอจิก "1" เข้าไปที่ทราฟฟิเคเตอร์ เบส มีผลทำให้ รีเลย์ทำงาน (ได้ผล ถูกต้อง)

เมื่อทำการประกอบวงจร รวมเข้าด้วยกันทั้งหมด โดยทำแผ่นวงจรพิมพ์ขึ้นใน ภาคผนวก ก และทำการทดสอบด้วยโปรแกรมที่ออกแบบโดยเฉพาะ เขียนด้วยภาษาเครื่อง และภาษาแอสเซมบลี ผลการทดสอบเป็นที่พอใจ การแสดงผลเป็น GRAPHIC และ TEXT สามารถควบคุมที่เอาต์พุต (ได้ผล ถูกต้อง สามารถนำไปใช้งานได้)



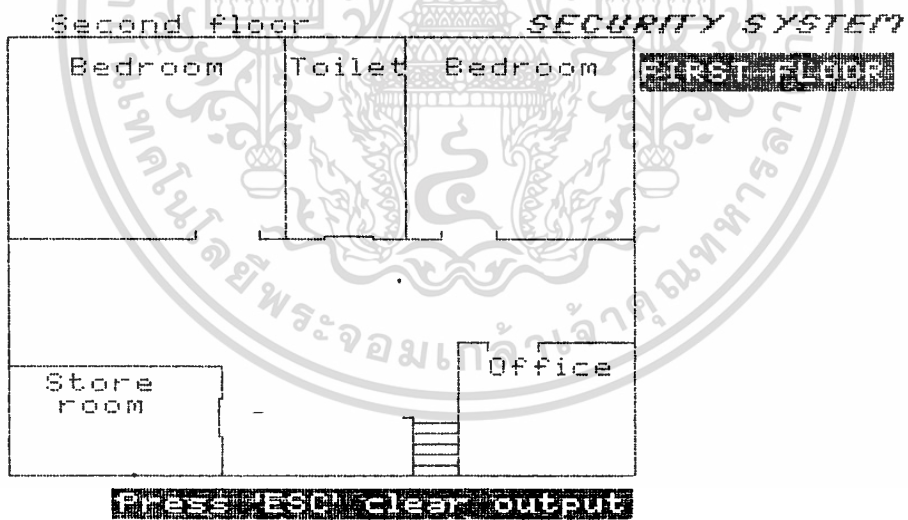
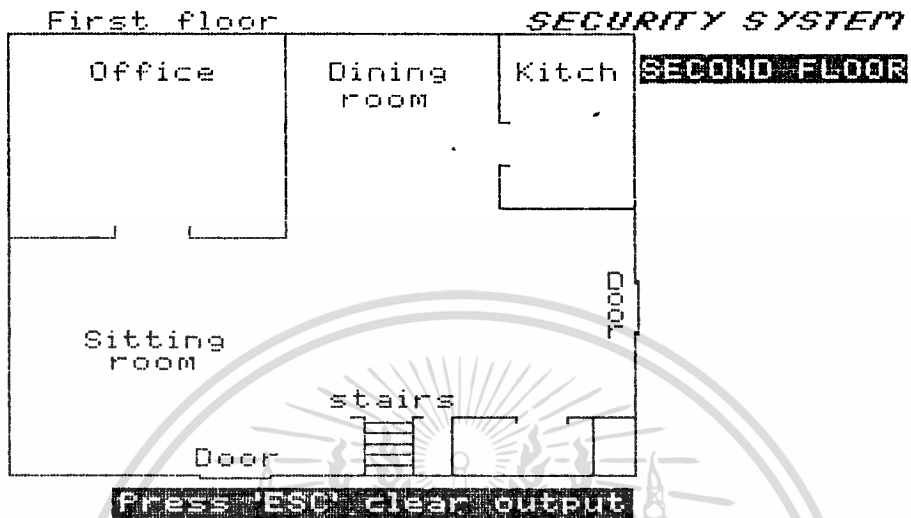
แสดงภาพ ในกรณีเกิดเหตุ

การนำไปใช้งาน

เมื่อประกอบสำเร็จเรียบร้อย ในการใช้งานระบบจะใช้ควบคุมไปกับไมโครคอมพิวเตอร์ APPLE II และโปรแกรมควบคุมที่ได้ออกแบบไว้ในบทที่ 3 ซึ่งอาจจะจัดเป็นภาษาเครื่อง หรือภาษาแอสเซมบลี ก็ได้ ระบบนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง ภาพ GRAPHIC และ TEXT หอออกแบบไว้เป็น หกภาคย่อยอาคาร 2 ชั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยโปรแกรมเพื่อให้แสดง ภาพ GRAPHIC และ TEXT ของอาคารอื่น เช่น โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณทุกตัวจะต้องทำการติดตั้ง ณ ตำแหน่ง ตามที่ภาพได้แสดงผลทางจอ Monitor อาจจะเป็นบริเวณหน้าต่าง ประตู ห้องนอน ห้องครัว เป็นต้น

ลำดับการใช้งานดังนี้

1. เปิดเครื่องระบบรักษาความปลอดภัย ถ้าอินพุทสัญญาณแสดง ต้องกดปุ่ม CLEAR ก่อน
 2. ใส่แผ่นโปรแกรมควบคุมที่ DRIVE ของ APPLE II เปิดเครื่อง APPLE II เพื่อ LOAD โปรแกรม สวิตซ์ตำแหน่ง DIRECT ใช้ในกรณีที่ไม่ใช่เครื่อง APPLE II เมื่อถึงขั้นตอนหน้าจอ MONITOR จะต้องแสดงภาพ (เปลี่ยนภาพโดยกดคีย์ 1 หรือ 2)
 3. เครื่องพร้อมที่จะทำงาน ซึ่งจะคอยตรวจสอบสัญญาณที่เข้ามาทางอินพุทกรณี เครื่องตรวจพบสัญญาณที่อินพุทจอ MONITOR จะแสดงผลสัญญาณเตือน และที่เครื่องจะแสดงผลเป็น LED และที่เอาท์พุทของเครื่องสามารถนำไปควบคุมอุปกรณ์อื่นได้ เช่น ควบคุมการปิด-เปิด หน้า ด้วย โซลินอยล์ วาล์ว หรือ เสียงไซเรน เป็นต้น
- การต่ออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเข้ากับตัวเครื่อง ดังนี้
- D7 ต่อเข้ากับ SMOKE DETECTOR
 - D6, D5, D4 ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณกรณีเกิดเพลิงไหม้ชนิดอื่น
 - D3, D2 ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณกรณีเกิดผู้บุกรุก
 - D1, D0 ต่อเข้ากับอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณกรณี ทางไฟฟ้า หรือกรณีเกิดผู้บุกรุก



แสดงภาพห้องแต่ละชั้นในกรณีปกติ

การพัฒนาระบบ

อินเตอร์เฟสออกแบบขนาน ถือได้ว่าเป็นชุด เอนกประสงค์ สามารถต่อร่วมกัน หรือ อินเตอร์เฟสเข้ากับระบบอื่น ๆ ที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อื่นได้ เนื่องจากไม่ได้น่าจะจงใช้เฉพาะเบอร์ PORT ของ CPU นั้น ๆ ดังวงจรในรูป ได้ใช้ IC LATCH 74LS373 , Buffer 74LS245 และ ตีได้ตำแหน่งด้วย IC 74LS138 ในขั้นได้ออกแบบไว้ที่ COAO-COAF คือตำแหน่งของ DEVSEL ที่ SLOT 2 ดังวงจรอินเตอร์เฟสดังกล่าวจึงสามารถต่อร่วมเข้ากับ IBM PC. ได้อีกด้วยโดยการต่อชุด ตีได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้น และการเขียนโปรแกรมควบคุมใหม่ เนื่องจากเครื่อง IBM PC. ใช้ CPU 8088 คนละเบอร์กับ APPLE II

ข้อดีของระบบรักษาความปลอดภัยของอินเตอร์เฟสชุดนี้

1. เป็นชุดอินเตอร์เฟสแบบ เอนกประสงค์ จึงง่ายต่อการใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เบอร์อื่น ๆ
2. จุดควบคุมมีมากพอ ที่จะใช้ควบคุมในระบบใหญ่ ๆ ได้
3. สามารถแสดงผลได้ทั้งภาพกราฟิก , LED และอุปกรณ์ควบคุมเอาต์พุต เช่น SOLINOID VALUE เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ๕. ตำแหน่งนั้น ๆ
4. ประสิทธิภาพความเชื่อถือได้มากกว่า
5. ความไวของระบบในการติดต่อ เตือน แสดงผล ดีกว่า
6. ราคาไม่สูงมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของระบบ

บรรณานุกรม

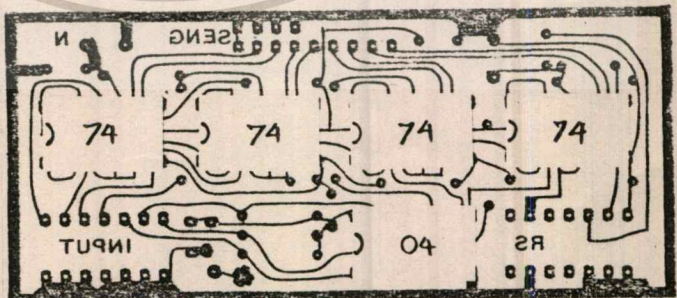
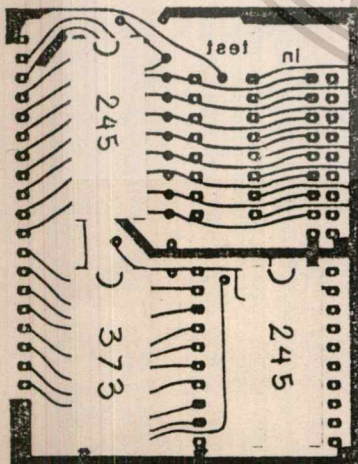
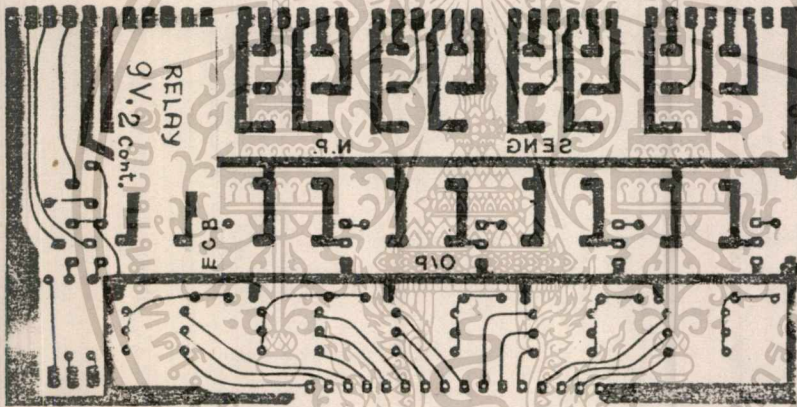
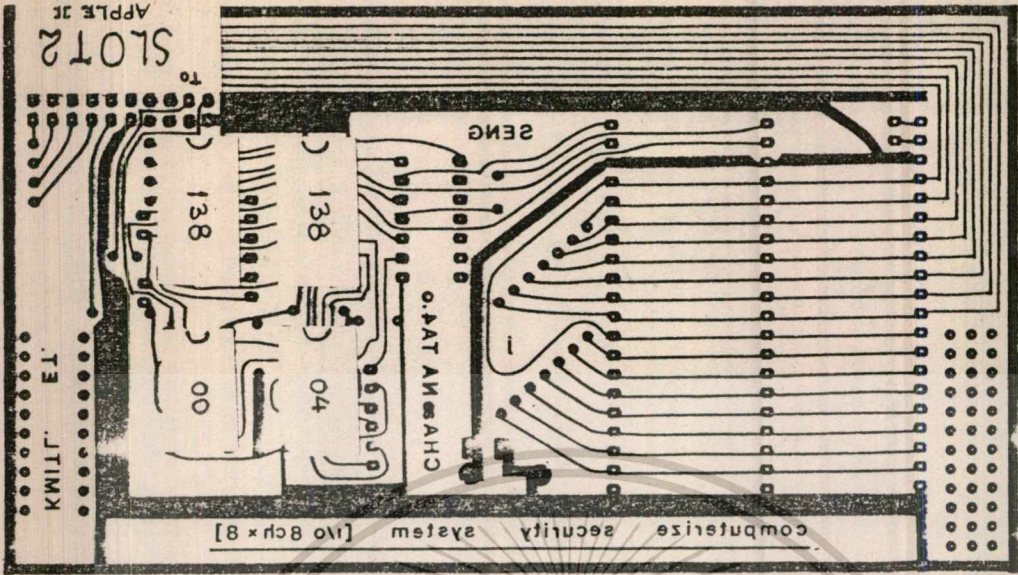
1. JONATHAN A. TITUS DAVID G. LARSEN
CHRISTOPHER A. TITUS , APPLE INTERFACING
2. Lance A. Leventhal , 6502 ASSEMBLY LANGUAGE
PROGRAMMING
3. Rodney Zaks , Advanced 6502 Programming
4. MARVIN L. DE JONG , APPLE II ASSEMBLY LANGUAGE
5. ชื่น ภูววรรณ , อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม

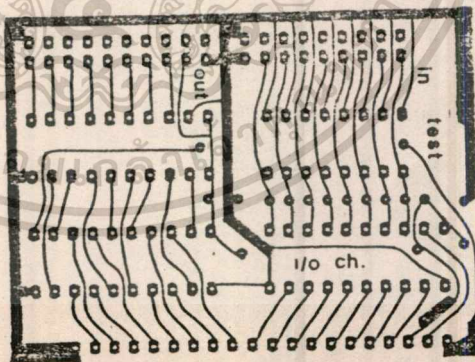
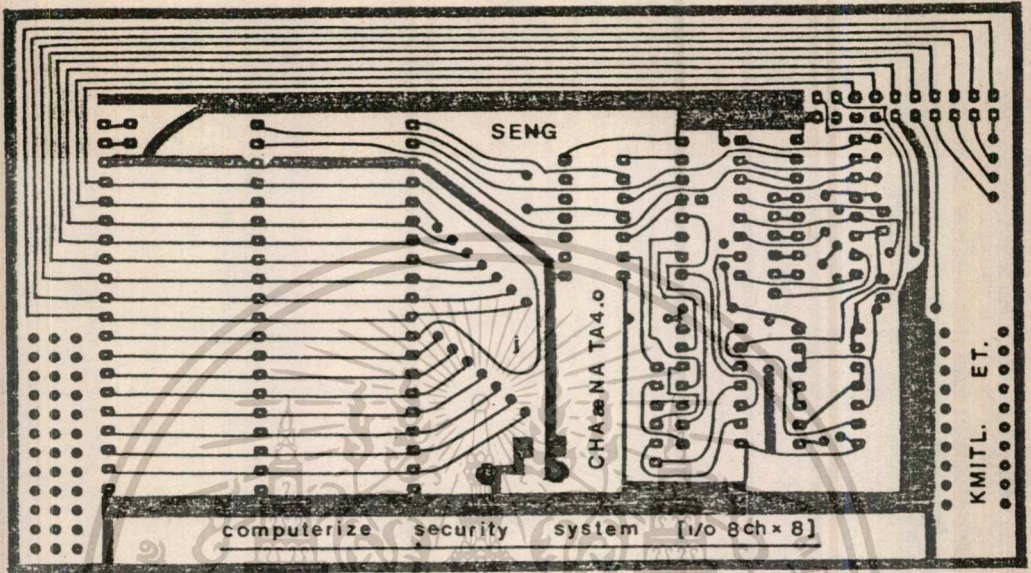


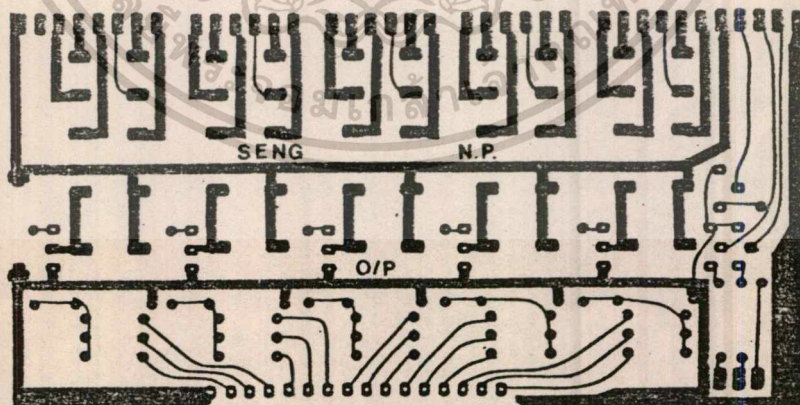
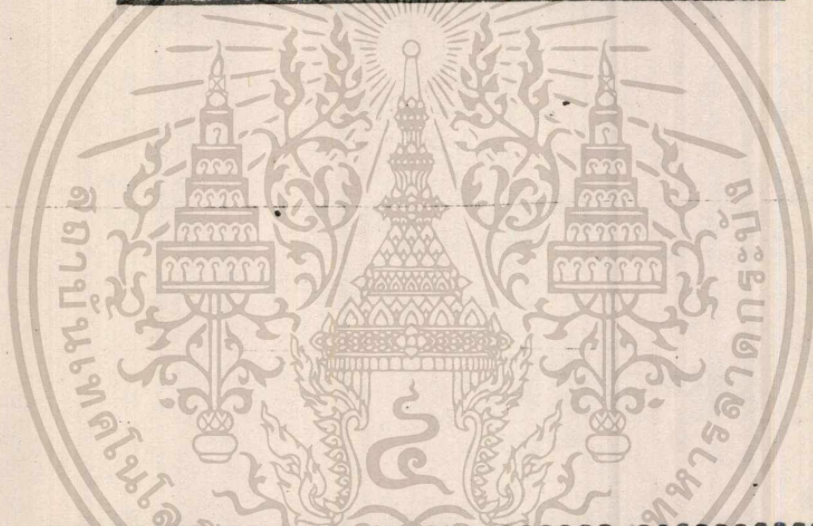
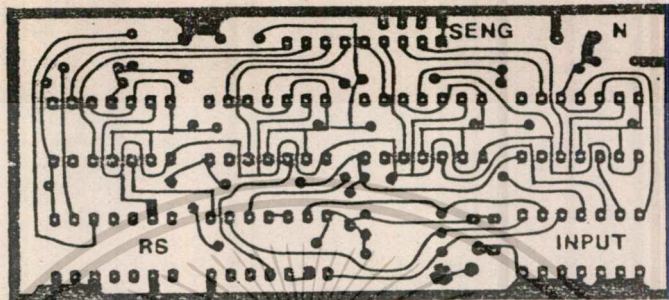
ผนวก ก

รายการอุปกรณ์ชุดอินเตอร์เฟส

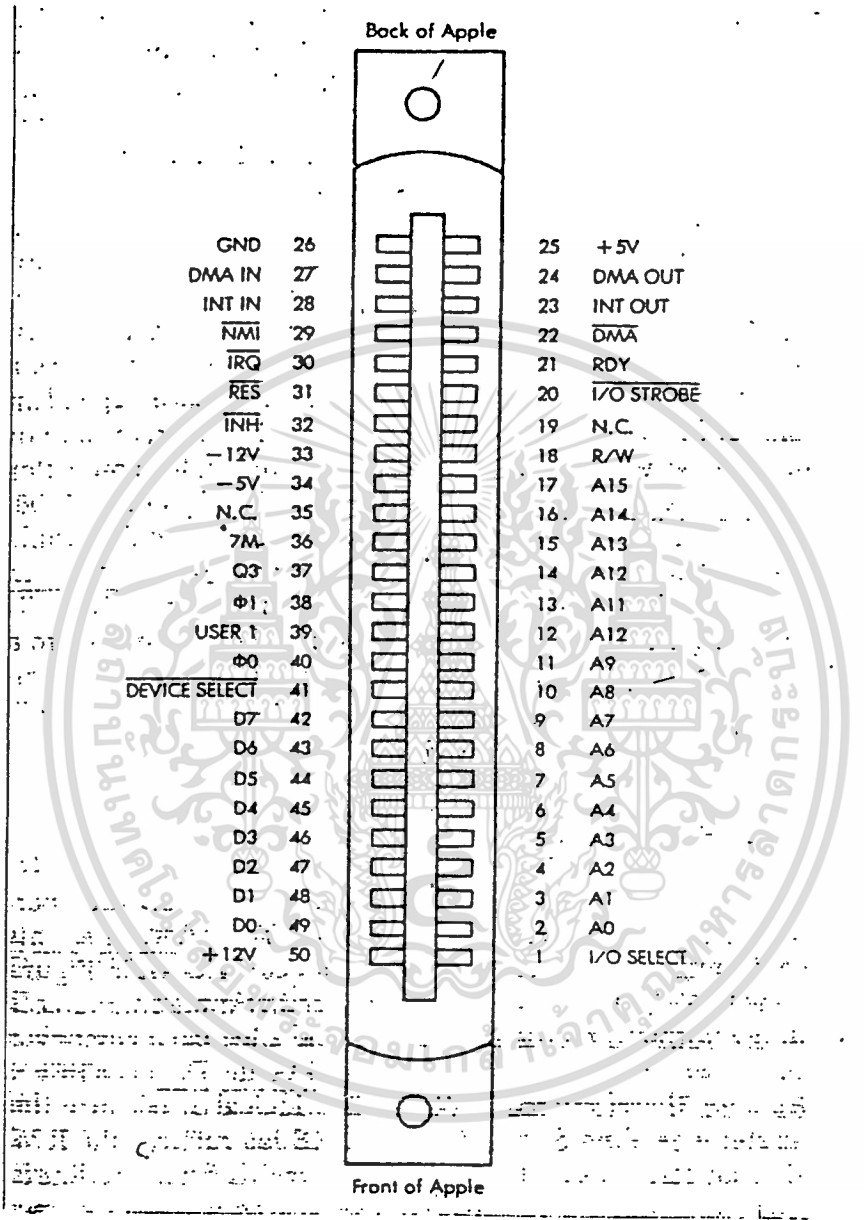
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ	จำนวน
SMOKE DETECTOR	1
HEAT DETECTOR	1
MAGNETIC SWITCH	1
MICRO SWITCH	1
LDR	1
I.C. TTL	จำนวน
74LS00	1
74LS04	2
74LS74	4
74LS138	2
74LS245	2
74LS373	1
I.C. 7805	1
อื่น ๆ	จำนวน
TRANSISTOR 2SC458	5
RELAY 9 V. 2 CONTACT	5
CONNECTOR	1
อื่น ๆ R,C,SW,แผ่นวงจรพิมพ์, กอลอง ฯลฯ	ตามวงจร
รายการ SOFTWARE	
โปรแกรมควบคุมระบบ (DISKETTE)	1 แผ่น







ผนวก ข



แสดง I/O slot ในเครื่องแอปเปิ้ล

ขาที่	ชื่อขา	กฎใช้งาน
1	I/O SELECT	มีทุกสล็อตยกเว้นสล็อต 0 แอดทิฟระหว่างที่ 0 เป็น 0 ที่ลอค "0" เมื่อมีการเรียกแอดเดรสช่วง \$ CNOO - \$ CNFF โดยที่ 0 เป็นเลขที่สล็อต
2-17	AB-A ₁₅	ขาเอาต์พุตของสล็อต
18	R/W	ควบคุมการอ่านหรือเขียนข้อมูล ที่สถานะลอค "0" เป็นการเขียนข้อมูลส่วนสภาวะ "1" เป็นการอ่านข้อมูล
19	SYNC	เป็นสัญญาณที่ซิงค์ (Sync) กับ Video timing มีเฉพาะสล็อต 7 เท่านั้น
20	I/O STROBE	เป็นขาสัญญาณที่ต่อร่วมกันทุกสล็อต แอดทิฟระหว่างที่ 0 เป็น 0 ที่ลอค "0" เมื่อมีการเรียกแอดเดรสช่วง \$ C800 - \$ CFFF
21	RDY	เป็นขาที่แสดงสถานะการทำงานของอุปกรณ์เทอร์มิเฟอร์หรือที่ส่งไปบอก CPU
22	DMA	ควบคุมการทำ Direct-memory access ของอุปกรณ์เทอร์มิเฟอร์หรือกับหน่วยความจำ
23	INT OUT	เป็นสัญญาณที่ใช้จัดลำดับความสำคัญของการทำอินเทอร์รัพท์
24	DMA OUT	ใช้จัดลำดับความสำคัญของการทำ Direct memory access
25	+5 Vols	สามารถจ่ายกระแสได้ถึง 500 mA
26	GND	เป็นขาราวด์ของระบบ
27	DMA IN	ใช้ร่วมกับขา DMA OUT เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการทำ Direct memory access
28	INT IN	ใช้ร่วมกับขา INT OUT เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการทำอินเทอร์รัพท์ชนิด maskable
29	NMI	เป็นขาอินเทอร์รัพท์ชนิด Non-maskable
30	IRQ	เป็นขาอินเทอร์รัพท์ชนิด maskable และสามารถจัดลำดับความสำคัญในการขออินเทอร์รัพท์ได้
31	RES	เป็นขาชนิดสองทิศทางไว้สำหรับรีเซ็ต การทำงานของเครื่องแอสเปคและอุปกรณ์เทอร์มิเฟอร์หรือ
32	INH	ทำงานที่ลอค "0" เป็นการบล็อกการทำงานของ ROM ในช่วงแอดเดรส \$ D000 - \$ FFFF
33	+12 Vols	สามารถจ่ายกระแสได้ 200 mA
34	+5 Vols	สามารถจ่ายกระแสได้ 200 mA เช่นเดียวกับสัญญาณไฟ +12 Vols
35	COLOR REP	มีเฉพาะสล็อต 7 ให้สัญญาณความถี่ 3608 MHz
36	7M	เป็นสัญญาณความถี่มาตรฐาน 7.159 MHz
37	Q ₁	ให้สัญญาณความถี่มาตรฐาน 2.046 MHz
38	0	เป็นขากาานถี่ 1.023 MHz ของ CPU ใช้แทนขาสัญญาณนาฬิกา 0502 0 ₁
39	USER 1	เป็นการเรียกการดีคอดของไอซี H12 และ H2 ในช่วงแอดเดรส \$ C000 - \$ C7FF เมื่อให้ลอค 0
40	0	ให้ความถี่เช่นเดียวกับขา 0 ₁ แต่มีเฟสตรงกันข้ามใช้แทนสัญญาณนาฬิกา 0502 0 ₂
41	DEV SEL	มีทุกสล็อต แต่ละสล็อตมีช่วงแอดเดรสที่ \$ COX0 - \$ COXF; X = N + 8 เมื่อ N คือ เลขสล็อต
42-49	D ₇ - D ₀	เป็นขาข้อมูลของสล็อต
50	+12 Vols	สามารถจ่ายกระแสได้ถึง 250 mA

สถาปัตยกรรมของ CPU 6502

รูปร่างภายนอกของ 6502 ก็เหมือนกับ ไอซี 40 ขาธรรมดา ในด้านการใช้งานก็เหมือนกับไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นมาตรฐานในยุคบุกเบิก โดยทั่วไปคือใช้สาร NMOS ทำงานในย่านความถี่เป็นเมกะเฮิรตซ์ หากเทียบกับ Z80 จะมีข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดในเรื่องนี้ Z80 ใช้สัญญาณนาฬิกา 2 MHz การทำงานในช่วงจังหวะการทำงานหนึ่งๆ เช่น ช่วงการเฟิร์ม คือ การอ่านคำสั่งจากหน่วยความจำ Z80 ต้องใช้เวลาถึง 4 CYCLE คือ 4 ไมโครวินาที ส่วน 6502 ใช้สัญญาณนาฬิกา 1 MHz ซึ่งช้ากว่า แต่ในช่วงการทำงานหนึ่งๆ จะใช้เวลาเพียง 1 CYCLE คือ 1 ไมโครวินาทีเท่านั้น แต่สำหรับแต่ละช่วงการทำงานที่สมบูรณ์ จะต้องประกอบด้วยช่วงการตีความและการปฏิบัติตามคำสั่ง สมมติว่าเป็นคำสั่งไบต์เดี่ยว Z80 จะทำงานเสร็จโดยสมบูรณ์ใน 1 แมกซ์ไซเคิล แต่ของ 6502 ต้องการอีก 1 แมกซ์ไซเคิล

ไมโครโปรเซสเซอร์โดยทั่วไปจะแบ่งการจัดขาออกเป็น 3 กลุ่ม ตามลักษณะการทำงานของมัน คือ

- แอดเดรสบัส (Address Bus)

- ดาตาบัส (Data Bus)

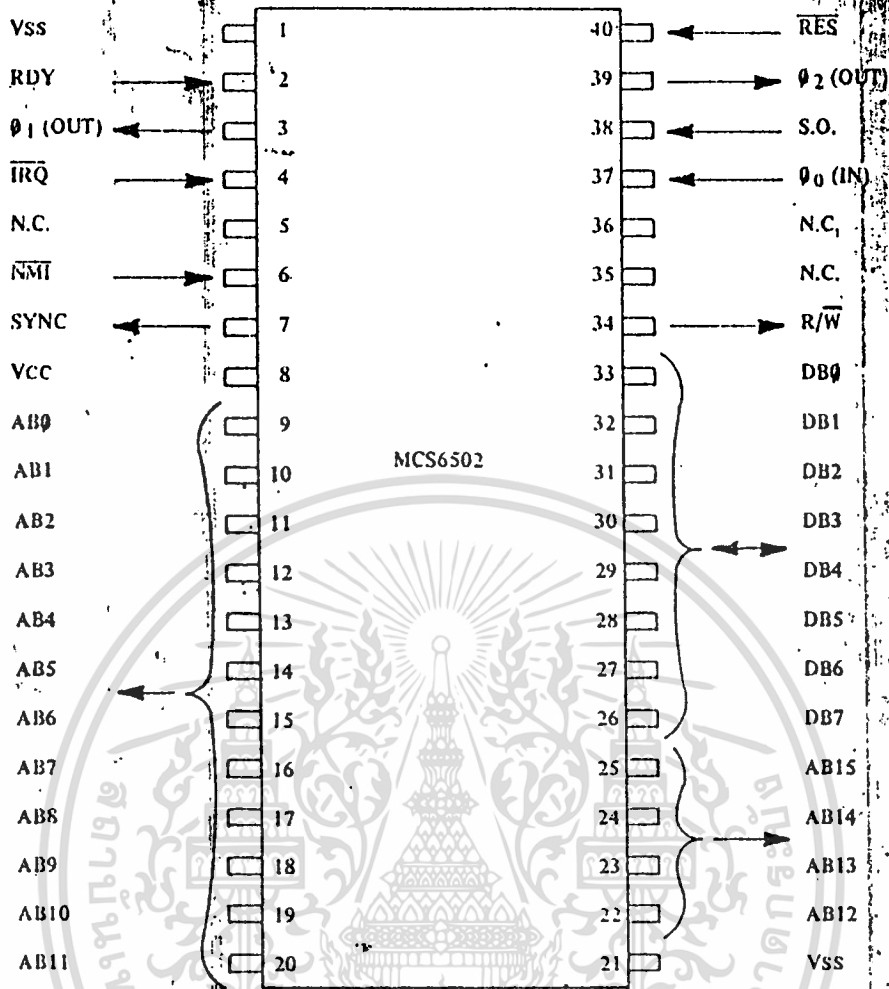
- คอนโทรลบัส (Control Bus) ซึ่งของ 6502 ได้จัดไว้ 10 ขา

เป็นขาอินพุต 6 ขา ได้แก่ $\overline{O0}$, RDY, NMI, IRQ, RES และ SO เป็นขาเอาต์พุต 4 ขา คือ O1, O2, R/W และ SYNC

ผู้จัดทำได้แสดงการจัดขาบน CPU 6502 ไว้ในรูปที่ 1

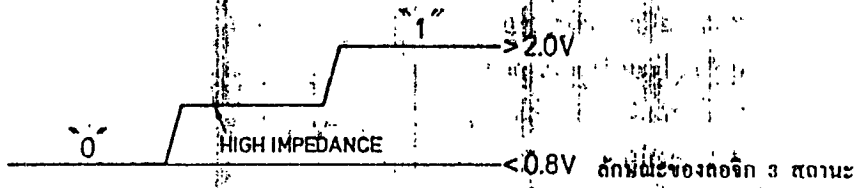
สัญญาณนาฬิกาของระบบ (System Clock)

ในการศึกษา CPU เบอร์ใดเบอร์หนึ่งหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวของมันอย่างคร่าวๆ แล้ว สิ่งที่ต้องให้ความสนใจอันดับแรกคือ สัญญาณนาฬิกาของระบบ ดังแสดงในรูป 3, 4, 5

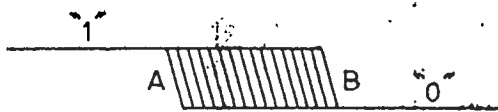


N.C. = NO CONNECTION

Pin Name	Description	Type
R/W	Read/Write control	Output
IRQ	Interrupt request	Input
NMI	Non-maskable interrupt	Input
RESET	Reset	Input
phi 0	CPU clock	Input
phi 1, phi 2	System clocks	Output
DB0 - DB7	Data Bus	Instate bidirectional
AB0 - AB15	Address Bus	Output
RDY	Single cycle control	Input
SO	Set Overflow flag	Input
SYNC	Identify op code fetch cycle	Output
VCC, Vss	Power and Ground	



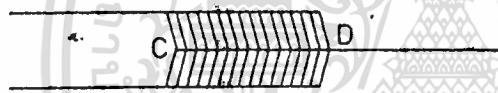
ลักษณะของลอจิก 3 สถานะ



การเปลี่ยนลอจิกจาก "1" ไป "0"



การเปลี่ยนลอจิกจาก "0" ไป "1"



การเปลี่ยนสถานะจาก "ON" ไป "OFF"



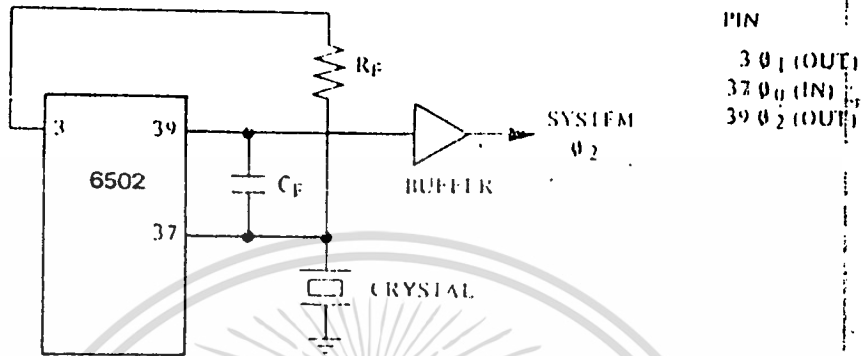
การเปลี่ยนสถานะจาก "OFF" ไป "ON"



รูปที่ 2 แสดงสถานะของสัญญาณ.

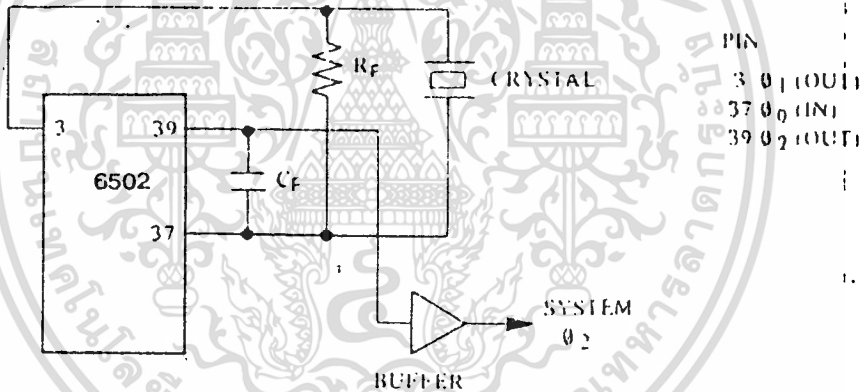
- ใน TTL ถือว่าสัญญาณที่มีแรงดันต่ำกว่า $0.8V$ เป็นลอจิก "0" ถ้าสูงกว่า $2V$ เป็นลอจิก "1" และเรียกสถานะทั้งสองนี้ว่า "ON state" ทว่าที่เป็น 3-STATE จะมีสถานะที่สามคือ high impedance (และเรียกว่า "OFF state")
- การเปลี่ยนสถานะของสัญญาณ อาจกำหนดช่วงเวลาแน่นอนไม่ได้ จะอยู่ในช่วงเวลา A ถึง B หรือ C ถึง D
- สถานะไม่แน่นอนส่วนมากเกิดในบัสในช่องที่มีการสลับเปลี่ยนแอดเดรสหรือเปลี่ยนจาก READ ไป WRITE และกลับกัน

รูปที่ 3 แสดงการจับวงจรสัญญาณนาฬิกา



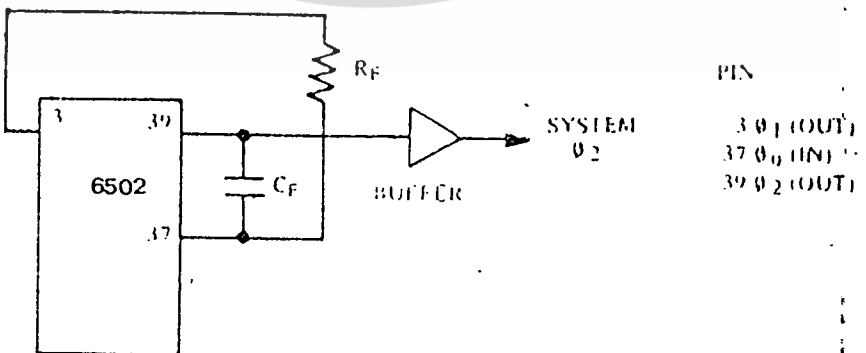
PIN
3 0₁ (OUT)
37 0₀ (IN)
39 0₂ (OUT)

MCS6502 Parallel Mode Crystal Controlled Oscillator



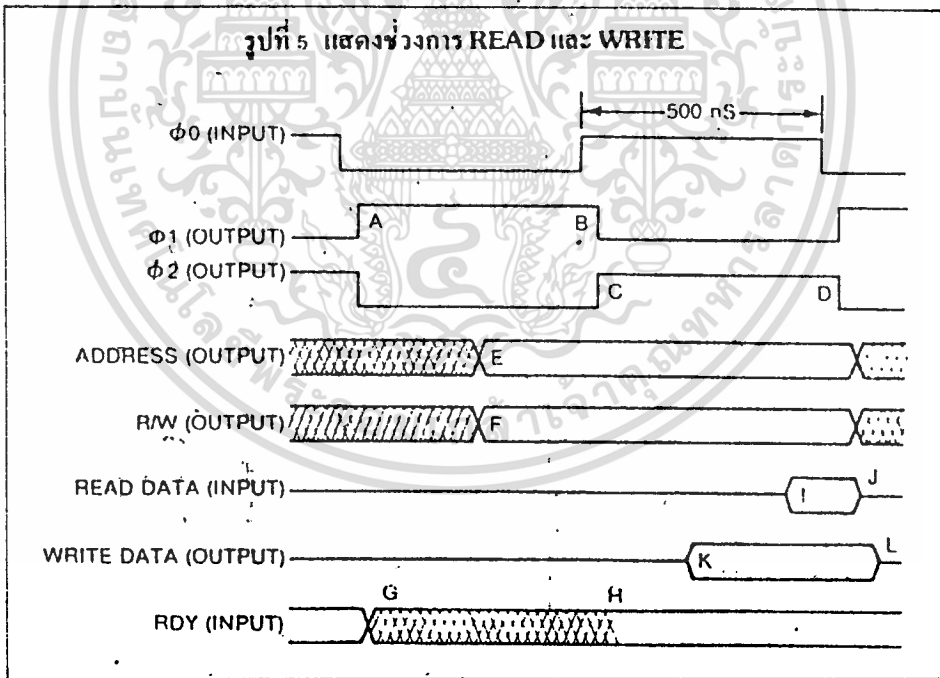
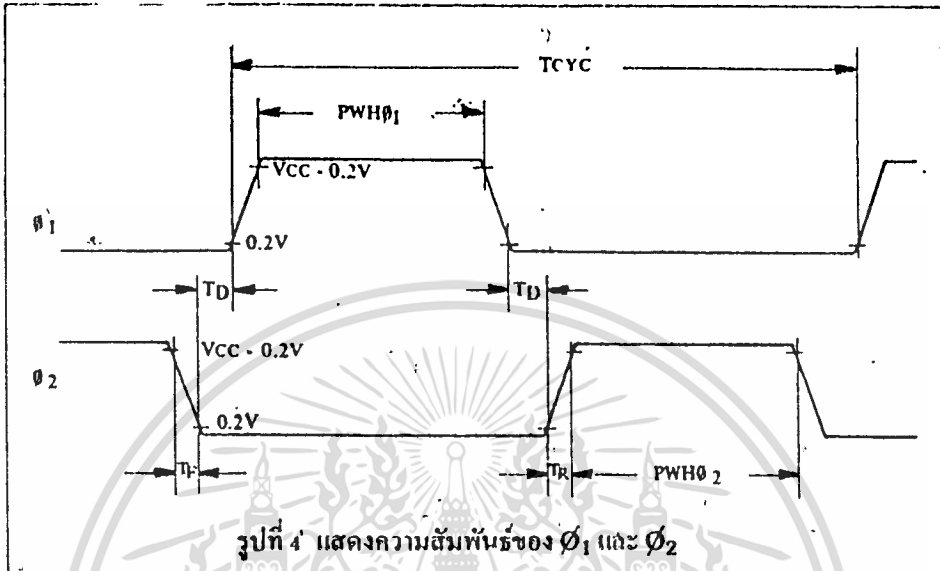
PIN
3 0₁ (OUT)
37 0₀ (IN)
39 0₂ (OUT)

MCS6502 Series Mode Crystal Controlled Oscillator

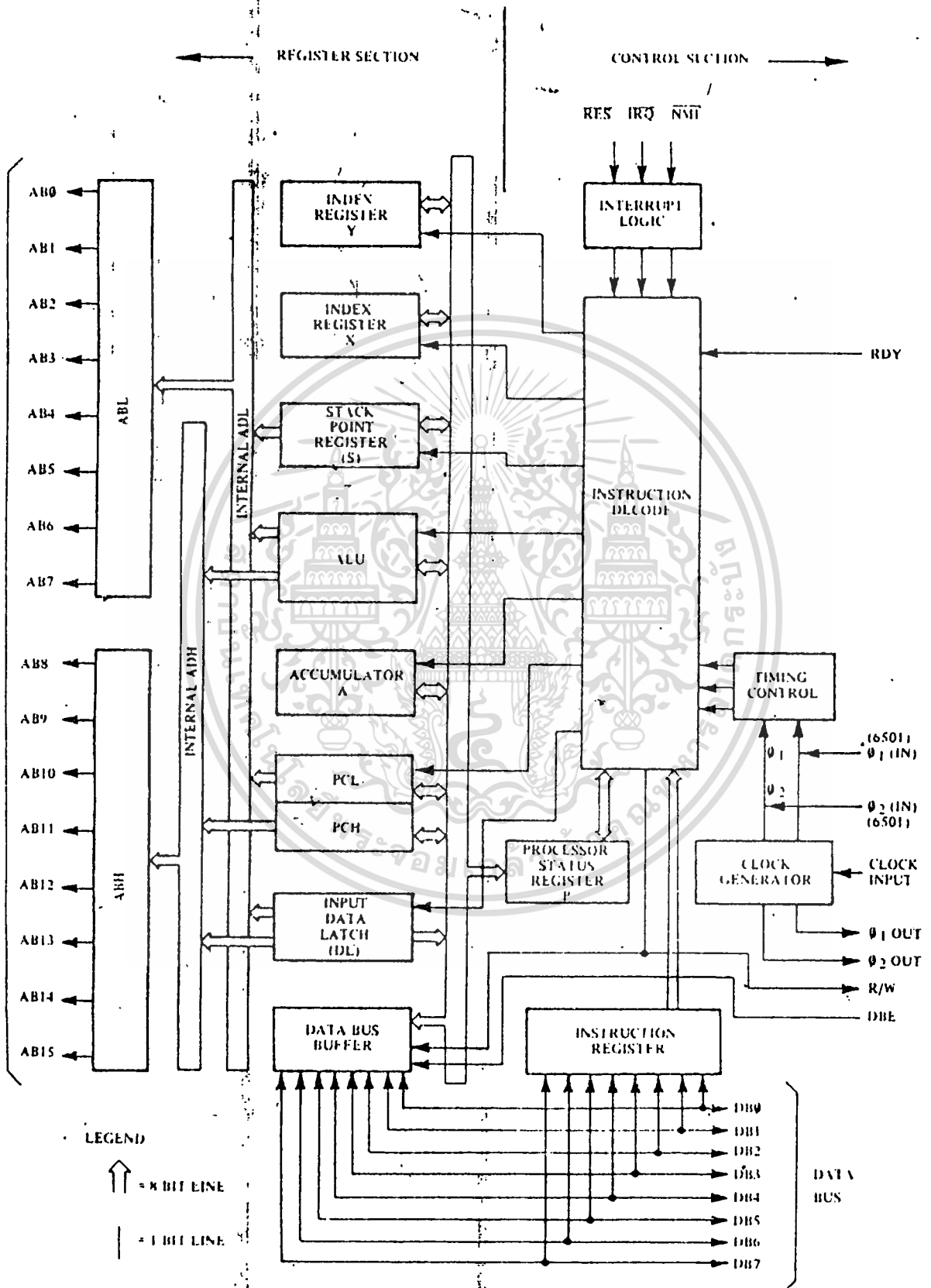


PIN
3 0₁ (OUT)
37 0₀ (IN)
39 0₂ (OUT)

MCS6502 Time Base Generator; RC Network



รูปที่ 7 โครงสร้างภายในของ 650X



5400/7400 Quadruple 2-Input Positive-NAND Gate

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL			
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package		
		C	P	M/CF		C	P	M/CF		C	P	M/CF		C	P	M/CF		C	P	M/CF
T.I.	SN54300	J	N	W1	SN54H00	J	N	W1	SN54LS00	J	N	W1	SN5400	J	N	W2	SN54L00	J	N	W2
	SN74300	J	N	W1	SN74H00	J	N	W1	SN74LS00	J	N	W1	SN7400	J	N	W2	SN74L00	J	N	W2
FAIRCHILD	FMS500	F	M	D1	FMS4H00	F	M	D1	FMS4500	F	M	D1	FM5400/FM900	F	M	D1	FZ			
	FL74500	F	L	D1	FC74H00/FC900	F	L	D1	FC74500	F	L	D1	FC7400/FC900	F	L	D1				
MOTOROLA					MC3100	M	C	F2	MC3000	M	C	F2	MC5400	M	C	F2				
					DM54H00	D	M	F2	DM54500	D	M	F2	DM5400	D	M	F2	DM54L00	D	M	F2
N.S.C.	DM74500	D	M	F2	DM74H00	D	M	F2	DM74500	D	M	F2	DM7400	D	M	F2	DM74L00	D	M	F2
PHILIPS	N74500	N	7		GJH131/74H00	G	J		N74LS00	N	7		FJH131/7400	F	J					
SIGNETICS	NS4500	N	S	W1	S54H00	S	5	W2	S5400	S	5		S5400	S	5	W2				
	N74500	N	7		N74H00	N	7		N74LS00	N	7		N7400	N	7					
SIEMENS													FLH101	F	L					
FUJITSU					MB601	M	B		74LS00	F	J		MB400	M	B					
HITACHI	HD74500	H	D						HD74LS00	H	D		HD7400/HD2503	H	D					
MITSUBISHI	M55000	M	5						M74LS00	M	7		M53200	M	5					
NEC	μPB2500	μ	P						74LS00	7	4		μPB201	μ	P					
TOSHIBA													TD3400A	T	D					

Electrical Characteristics SN54LS00/SN74LS00

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V _{CC}	TV	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55 to 125°C
Input voltage	TV	Storage temperature range	SN74LS	-65 to 150°C
Interconnect voltage	5.5V			

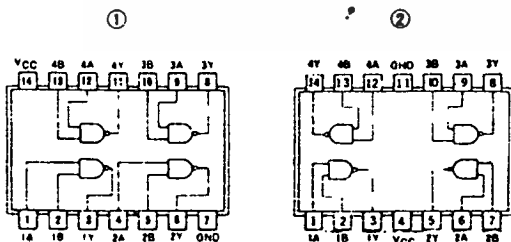
recommended operating conditions

	SN54LS00		SN74LS00		UNIT
	MIN	MAX	MIN	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5.5	4.75	5.25	V
High-level output current, I _{OH}		-40		-40	mA
Low-level output current, I _{OL}		8		8	mA
Operating free-air temperature, T _A	-55	125	0	75	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

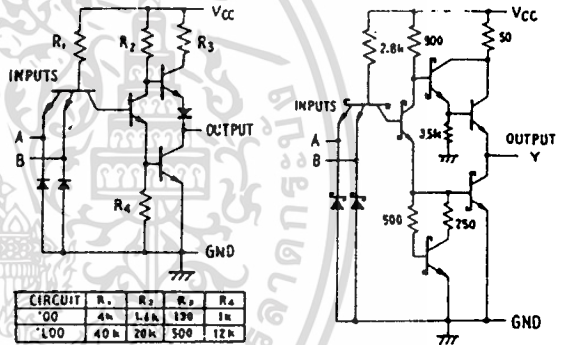
PARAMETER	TEST CONDITIONS †	MIN	TYP ‡	MAX	UNIT
V _{IH}	High-level input voltage		2		V
V _{IL}	Low-level input voltage			0.8	V
V _I	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18 mA		-1.5	V
V _{OH}	High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IL} = V _{IL} max, I _{OH} = MAX	2.7	3.4	V
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, I _{OL} = 8 mA	0.2	0.4	V
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = TV		0.1	mA
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2.7V		20	μA
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _{IL} = 0.4V		-0.4	mA
I _{OS}	Short-circuit output current †	V _{CC} = MAX	SALS Family -20 7ALS Family -18	-100	mA
I _{COH}	Supply current	V _{CC} = MAX	Total outputs high	4	mA
I _{CCL}	Supply current	V _{CC} = MAX	Total outputs low	12	mA
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = 5V	Average per gate (50% duty cycle)	0.4	mA
t _{PLH}	Propagation delay time, low-to-high-level output	V _{CC} = 5V, T _A = 25°C		9	ns
t _{PHL}	Propagation delay time, high-to-low-level output	C _L = 15pF, R _L = 2kΩ		10	ns

Pin Assignments (Top View)



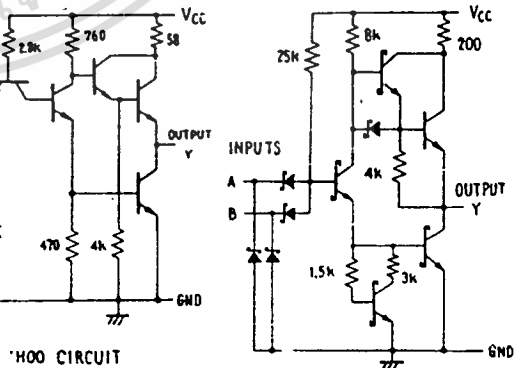
positive logic:
Y = AB

Schematics (each gate)



CIRCUIT	R ₁	R ₂	R ₃	R ₄
'00	4k	1.5k	190	1k
'00	40k	20k	500	12k

Input clamp diodes not on SN54LS00/SN74LS00 circuits.



Resistor values shown are nominal and in ohms

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

‡ All typical values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.

• Not more than one output should be shorted at a time, and for SN54H00, SN74H00, and SN54S00, SN74S00, duration of short circuit should not exceed 1 second.

5402/7402 Quadruple 2-Input Positive-NOR Gate

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL				
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			
T.I.	SN54502	J	14	WT					SN54LS02	J	14	WT	SN5402	J	14	W2	SN54L02	J	14	ND	TQ
FAIRCHILD	FMS4502 / FMS502	ND		FC					FMS4502 / FMS502	ND		FC	FMS402 / FMS502	D	14	F 2					
MOTOROLA																					
N.S.C.																					
PHILIPS																					
SIGNETICS																					
SIEMENS																					
FUJITSU																					
HITACHI																					
MITSUBISHI																					
NEC																					
TOSHIBA																					

Electrical Characteristics SN54LS02/SN74LS02

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

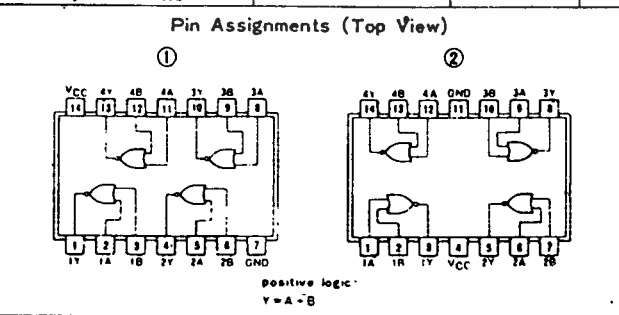
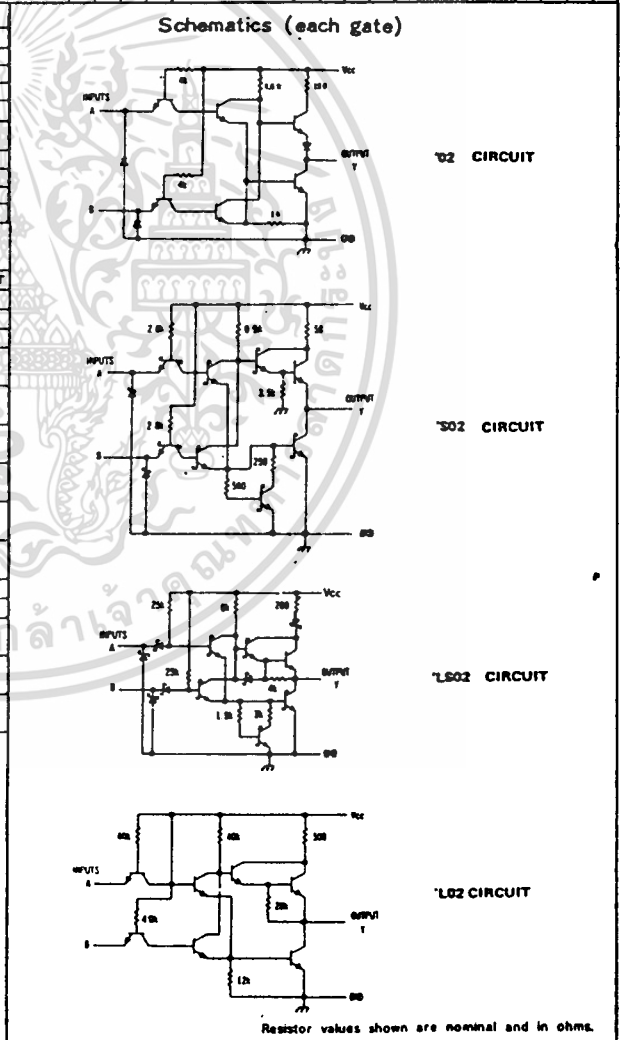
Supply voltage, V _{CC}	TV	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C
Input voltage	TV	Storage temperature range	SN74LS	0°C to 70°C
				-60°C to 150°C

recommended operating conditions

	SN54LS02			SN74LS02			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current I _{OH}			-400			-400	µA
Low-level output current I _{OL}			4			4	mA
Operating free-air temperature, T _A	-55		125	0		70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER	TEST CONDITIONS †	MIN	TYP ‡	MAX	UNIT
V _{IH} High-level input voltage		2			V
V _{IL} Low-level input voltage			0.8		V
V _I Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18 mA			-1.5	V
V _{OH} High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IL} = V _{IH} MAX, I _{OH} = MAX	2.7	3.4		V
V _{OL} Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, I _{OL} = 4mA		0.25	0.4	V
I _I Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.1		mA
I _{IH} High-level input current	Data inputs, V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2.7V		20		µA
I _{IL} Low-level input current	Data inputs, V _{CC} = MAX, V _{IL} = 0.4V		0.4		mA
I _{OS} Short-circuit output current †	V _{CC} = MAX	SALS Family	-20	-100	mA
		NLS Family	-20	-100	mA
I _{CC} H Supply current	V _{CC} = MAX, Total outputs high		1.6	3.2	mA
I _{CC} L Supply current	V _{CC} = MAX, Total outputs low		2.8	5.4	mA
I _{CC} Supply current	V _{CC} = 5V, Average per gate (50% duty cycle)		0.55		mA
t _{PLH} Propagation delay time, low-to-high-level output	V _{CC} = 5V, T _A = 25°C		10	15	ns
t _{PHL} Propagation delay time, high-to-low-level output	C _L = 15pF, R _L = 2kΩ		10	15	ns



† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.
‡ All typical values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.
♦ Not more than one output should be shorted at a time, and for SN54S/SN74S duration of output short-circuit should not exceed one second.

5404/7404 Hex Inverter

T. I.	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL							
	Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package					
	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF				
T. I.	SN54S04	J ¹		W ¹	SN54H04	J ¹		W ¹	SN54LS04	J ¹		W ²	SN5404	J ¹		W ²	SN54L04	J ¹		W ²	SN74L04	J ¹		W ²
	SN74S04	J ¹	N ¹		SN74H04	J ¹	N ¹		SN74LS04	J ¹	N ¹		SN7404	J ¹	N ¹		SN74L04	J ¹	N ¹		SN74L04	J ¹	N ¹	
FAIRCHILD	FM54S04/FM5404	D ¹			FM54H04/FM5404	D ¹			FZ54S04/FZ5404	D ¹			FM5404/FM5404	D ¹										
MOTOROLA	FC74S04/FC9504	D ¹	M ¹		FC74H04/FC9504	D ¹	P ¹		FC74LS04/FC9504	D ¹	P ¹		MC5404	L ¹			MC5404	L ¹						
					MC3108	L ¹			MC3008	L ¹	P ¹	F ¹	MC7404	L ¹	P ¹		MC7404	L ¹	P ¹					
N. S. C.	DM74S04				DM54H04	J ¹	N ¹		DM54LS04				DM5404	J ¹	N ¹		DM54L04	J ¹	N ¹		DM74L04	J ¹	N ¹	
PHILIPS	N74S04		D		N74H04		D		N74LS04				FJH241-7404											
SIGNETICS	SS4S04	F ¹	A ¹	W ¹	SS4H04	F ¹	A ¹	W ²					SS404	F ¹	A ¹	W ²								
	N74S04	F ¹	A ¹	W ¹	N74H04	F ¹	A ¹	W ²	N74LS04				N7404	F ¹	A ¹	W ²								
SIEMENS													FLH211											
FUJITSU									74LS04			M ¹	MB418			M ¹								
HITACHI	HC74S04	J ¹	P ¹						HD74LS04			P ¹	HD7404/HD2522			P ¹								
MITSUBISHI	M55004			K ¹					M74LS04			P ¹	M53204			P ¹								
NEC	74S04			O ¹					74LS04			C ¹	μ PB235			D ¹								
TOSHIBA													TD3404A			P ¹								

Electrical Characteristics SN54LS04/SN74LS04

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V _{CC}	7V	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C
Input voltage	7V	Storage temperature range	SN74LS	0°C to 150°C
		Storage temperature range		-65°C to 150°C

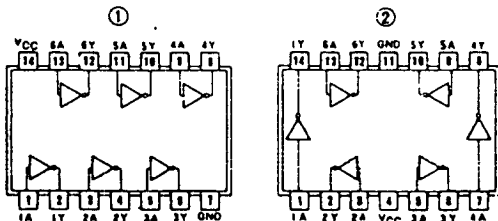
recommended operating conditions

	SN54LS04			SN74LS04			LIMIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current, I _{OH}			-400			-400	mA
Low-level output current, I _{OL}			4			4	mA
Operating free-air temperature, T _a	-55		125	0		75	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER	TEST CONDITIONS 1	MIN	TYP 2	MAX	UNIT	
V _{IH}	High-level input voltage		2		V	
V _{IL}	Low-level input voltage			0.8	V	
V _I	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18mA		-1.5	V	
V _{OH}	High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _I L = V _I L max, I _{OH} = MAX	2.7	3.4	V	
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _I H = 2V, I _{OL} = 4mA		0.4	V	
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.1	mA	
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _I H = 2.7V		20	μA	
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _I L = 0.4V		-0.4	mA	
I _{OS}	Short-circuit output current	V _{CC} = MAX	SN54LS Family	-20	-100	mA
I _{QCH}	Supply current	V _{CC} = MAX	Total, outputs high	1.2	2.4	mA
I _{QCL}	Supply current	V _{CC} = MAX	Total, outputs low	3.6	6.6	mA
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = 5V	Average per gate (50% duty cycle)	0.4		mA
t _{PLH}	Propagation delay time, low-to-high-level output	V _{CC} = 5V, T _a = 25°C, C _L = 15PF, R _L = 2kΩ		9	15	ns
t _{PHL}	Propagation delay time, high-to-low-level output	V _{CC} = 5V, T _a = 25°C, C _L = 15PF, R _L = 2kΩ		10	15	ns

Pin Assignments (Top View)



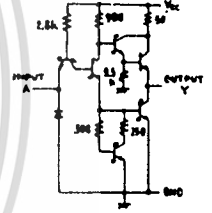
positive logic:
Y = \bar{A}

Schematics (each gate)

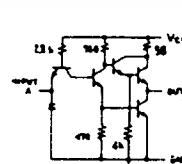


CIRCUIT	R1	R2	R3	R4
'04	4k	1.5k	130	1k
'L04	40k	20k	500	17k

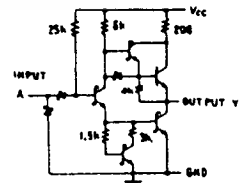
Input clamp diodes not on SN54L74SN74L' circuits.
'04, 'L04 CIRCUITS



504 CIRCUIT



704 CIRCUIT



'L504 CIRCUIT

Resistor values shown are nominal and in ohms.

1 For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions

2 All typical values are at V_{CC} = 5V, T_a = 25°C

3 Not more than one output should be shorted at a time, and for SN54H/SN74H' and SN54S/SN74S', duration of short-circuit should not exceed 1 second

5474/7474 Dual D-Type Positive-Edge-Triggered Flip-Flop with Preset and Clear

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL											
	Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package									
	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF								
Y.I.	SN54S74	J	D	ND	SN54H74	J	D	ND	SN54LS74	J	D	ND	SN5474	J	D	ND	SN54L74	J	D	ND	T	D	ND	F	D			
FAIRCHILD	SN74S74	J	D	ND	SN74H74	J	D	ND	SN74LS74	J	D	ND	SN7474	J	D	ND	SN74L74	J	D	ND	T	D	ND	F	D			
MOTOROLA	FMS4S74/FMS374	DD	ND		FMS4H74/FMS3H74	DD	ND	F	D	FMS4LS74/FMS3LS74	DD	ND	F	D	FMS474/FMS374	DD	ND	F	D	FMS4L74/FMS3L74	DD	ND	F	D				
H.S.C.	DM74S74		ND		DM54H74	J	D	ND	DM54LS74	J	D	ND	DM7474	J	D	ND	DM54L74	J	D	ND	F	D			F	D		
PHILIPS	N74S74		D		011131/74H74		D		N74LS74		D		F11131/7474		D													
SIGNETICS	S54S74				S54H74	F	D	A	D	ND			S5474	F	D	A	D	ND				S54L74	F	D	A	D		
SIEMENS	N74S74				N74H74	F	D	A	D	ND			N7474	A	D							FLJ141		D				
FUJITSU									74LS74	A	D		MB420	D	ND													
HITACHI	HD74S74	D	P	C					HD74LS74	P	D			HD7474/HD2510	D	P	C											
MITSUBISHI	M74S74		P	D					M74LS74	P	D			MB327/MS374	P	D												
NEC	74S74		C	D					74LS74	C	D			μPB214	DD	C	D											
TOSHIBA														TC3474A	P	D												

Electrical Characteristics SN54LS74/SN74LS74

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

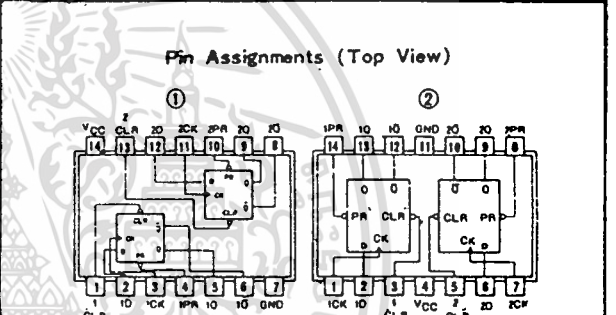
Supply voltage, V _{CC}	5V	Operating power temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C
Input voltage	5.5V	Storage temperature range	SN74LS	0°C to 70°C
		Storage temperature range		-55°C to 150°C

recommended operating conditions

PARAMETER	SN54LS74		SN74LS74		UNIT
	MIN	MAX	MIN	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5.5	4.75	5.25	V
High-level output current, I _{OH}	-40		-40		mA
Low-level output current, I _{OL}	4		4		mA
Input current, I _I					μA
Clear high	25		25		μA
Preset or clear low	25		25		μA
High-level delay	25		25		ns
Low-level delay	20		20		ns
Setup time, t _{su}	5		5		ns
Hold time, t _h	5		5		ns
Operating power temperature, T _a	-55	125	0	70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

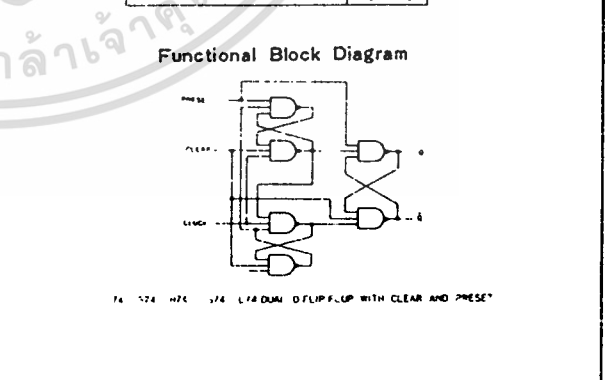
PARAMETER*	TEST CONDITIONS†	MIN	TYP‡	MAX	UNIT
V _{IH} High-level input voltage		2			V
V _{IL} Low-level input voltage			0.8		V
V _I Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18mA			-1.5	V
V _{OH} High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = 0.8V, I _{OH} = MAX	2.7	3.4		V
V _{OL} Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = 0.8V, I _{OL} = 4mA		0.25	0.4	V
I _I Input current at maximum input voltage	D, J, K, Clear			0.1	mA
	Preset	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.2	mA
	Clear			0.2	mA
	Clock			0.1	mA
I _{IH} High-level input current	D, J, K, Clear	V _{CC} = MAX, V _I = 2.7V		20	μA
	Preset			30	μA
	Clear			40	μA
	Clock			20	μA
I _{IL} Low-level input current	D, J, K, Clear	V _{CC} = MAX, V _I = 0.4V		-0.4	mA
	Preset			-3.8	mA
	Clear			-0.8	mA
	Clock			-0.4	mA
I _{OS} Short-circuit output current*	Series 54LS	V _{CC} = MAX	-20	100	mA
	Series 74LS		-20	100	mA
I _{CC} Supply current (Average per flip-flop)	V _{CC} = MAX, See Note 1		4	8	mA
f _{clock} clock frequency	V _{CC} = 5V, T _A = 25°C, C _L = 15pF, R _L = 2kΩ		25	33	MHz
t _{PLH} Propagation delay time, low-to-high-level output			13	25	ns
t _{PLL} Propagation delay time, high-to-low-level output			25	40	ns



Functional Table

74, 74A, LS74, 7474 (See Note 2)

INPUTS			OUTPUTS	
PRESET	CLEAR	CLOCK	Q	Q̄
L	H	X	X	H L
H	L	X	X	L H
L	L	X	X	H* H*
H	H	↑	H	L
H	H	↓	L	H
H	H	L	X	Q ₀ Q̄ ₀



NOTE: With a output open, I_{CC} is measured with the Q and Q̄ outputs high. At the time of measurement, the clock input is grounded. H = high level (steady state), L = low level (steady state), X = irrelevant. ↑ = transition from low to high level. Q₀ = the level of Q before the indicated input conditions were established. * This configuration is nonstable; that is, it will not persist when preset and clear inputs return to their inactive (high) level.

* Small values shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions. † These values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C. ‡ Where more than one output should be specified at a time. * Propagation delay time, low-to-high-level output. † Propagation delay time, high-to-low-level output. ‡ Arrows indicate the edge of the clock pulse used for reference. † For the rising edge.

54138/74138 3-Line-to-8-Line Decoder

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL				
	Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		
	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	
T.I.	SN54S138	J ¹							SN54LS138	J ¹											
	SN74S138	J ¹	N ¹						SN74LS138	J ¹	N ¹										
FAIRCHILD	/74S138	K ¹							/74LS138	K ¹											
	74S138/74S138	K ¹							74LS138/74LS138	K ¹											
MOTOROLA									SN74LS138	P ¹											
N.S.C.	DM74S138								DM74LS138												
									DM54LS138												
PHILIPS	N74S138								N74LS138												
	54S138	F ¹	B ¹						74LS138												
SIGNETICS	N74S138	F ¹	B ¹						N74LS138	A ¹											
SIEMENS																					
FUJITSU									74LS138	M ¹											
HTACH									HD74LS138	P ¹											
MTSUBISHI	M74S138								M74LS138	P ¹											
NEC									74LS138	C ¹											
TOSHIBA																					

Electrical Characteristics SN54LS138/SN74LS138

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V _{CC}	7V	Operating free-air temperature range	SN54LS138	-55°C to 125°C
Input voltage	7V	Storage temperature range	SN74LS138	0°C to 70°C
				-65°C to 150°C

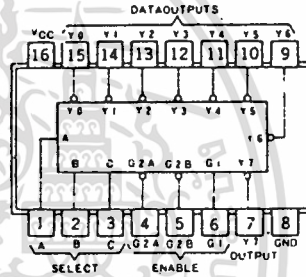
recommended operating conditions

	SN54LS138		SN74LS138		UNIT		
	MIN	NOM	MAX	MIN		MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output current, I _{OH}			400		400		mA
Low-level output current, I _{OL}			4		4		mA
Operating free-air temperature, T _A	-55		125	0	70		°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER*	TEST CONDITIONS†	MIN	TYP‡	MAX	UNIT	
V _{IH}	High-level input voltage		2		V	
V _{IL}	Low-level input voltage			0.8	V	
V _I	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18mA		1.5	V	
V _{OH}	High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{OH} = 2V, I _{OH} = 0.8V, I _{OH} = 400mA	2.5	3.4	V	
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{OH} = 2V, I _{OL} = 0.8V, I _{OL} = 4mA	0.35	0.5	V	
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.1	mA	
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 2.7V		20	µA	
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 0.4V		0.4	mA	
I _{OS}	Short-circuit output current*	V _{CC} = MAX	-20	-100	mA	
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = MAX, Outputs enabled and open	6.3	10	mA	
IP _{LH}	from Binary select to Any output	V _{CC} = 5V, T _A = 25°C, C _L = 150pF, R _L = 2kΩ	2	13	20	ns
IP _{HL}			3	27	41	ns
IP _{LH}			3	26	39	ns
IP _{LH}	from Enable to Any output	levels of delay	2	12	18	ns
IP _{HL}			3	21	32	ns
IP _{LH}	from Enable to Any output	levels of delay	2	17	26	ns
IP _{HL}			3	25	38	ns

Pin Assignment (Top View)



positive logic see function table

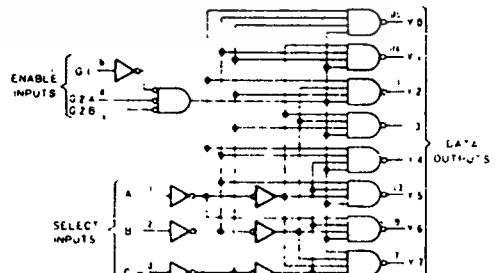
Function Table

*S138 *LS138

INPUTS				OUTPUTS								
ENABLE	SELECT	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	K	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L

* G2 = G2A + G2B
H = high level, L = low level, X = irrelevant

Functional Block Diagram



*S138 *LS138 DECODER DEMULTIPLEXER

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions for the applicable device type.

‡ All typical values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.

* Not more than one output should be shorted at a time, and duration of the short-circuit test should not exceed one second.

† IP_{LH} = propagation delay time, low-to-high-level output

† IP_{HL} = propagation delay time, high-to-low-level output

54244/74244 Octal Buffers/Line Drivers/Line Receivers

	Schttky TTL			High-Speed TTL			Low-Power Schottky TTL			Standard TTL			Low-Power TTL					
	Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package				
		C	P		M	C		P	M		C	P		M	C	P	M	C
T. I.							SN54LS244	J	L									
FAIRCHILD							SN74LS244	J	NO									
MOTOROLA																		
N. S. C.																		
PHILIPS																		
SIGNETICS																		
SIEMENS																		
FUJITSU																		
HITACHI																		
MITSUBISHI																		
NEC																		
TOSHIBA																		

Electrical Characteristics SN54LS244/SN74LS244

Pin Assignment (Top View)

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range			
Supply voltage, VCC	TV	Operating free-air temperature range	SN54LS 55°C to 125°C
Input voltage	5.5V	temperature range	SN74LS 0°C to 70°C
Intermittent voltage	5.5V	Storage temperature range	65°C to 150°C

recommended operating conditions						
	LS54LS244		SN74LS244		UNIT	
	MIN	NOM	MAX	MIN		MAX
Supply voltage, VCC	4.5	5	5.5	5	5.25	V
High-level output current, IOH			12		15	mA
Low-level output current, IOL			12		24	mA
Operating free-air temperature, TA	55		125	0	70	°C

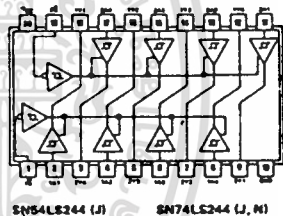
electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS †	SN74LS		UNIT
		MIN	TYP ‡ MAX	
V _{IH} High-level input voltage			2	V
V _{IL} Low-level input voltage			0.8	V
V _{IK} Input clamp voltage	VCC = MIN, I _I = -18mA		-1.5	V
Hysteresis(V _{T+} - V _{T-})	VCC = MIN		0.2 0.4	V
V _{OH} High-level output voltage	VCC = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{ILmax} , I _{OH} = -3mA		2.4 3.4	V
	VCC = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = 0.5V, I _{OH} = MAX		‡	
V _{OL} Low-level output voltage	VCC = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{ILmax}	I _{OL} = 12mA	0.4	V
		I _{OL} = 24mA	0.5	
I _{OZH} Off-state output current, high-level voltage applied	VCC = MAX, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{ILmax}	V _O = 2.7V	20	µA
I _{OZL} Off-state output current, low-level voltage applied	VCC = MAX, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{ILmax}	V _O = 0.4V	-20	µA
I _I Input current at maximum input voltage	VCC = MAX, V _I = 7V		0.1	mA
I _{IH} High-level input current, any input	VCC = MAX, V _I = 2.7V		20	µA
I _{IL} Low-level input current	VCC = MAX, V _{IL} = 0.4V		-0.2	mA
I _{OS} Short-circuit output current †	VCC = MAX		-40 -225	mA
I _{CC} Supply current	Outputs high	VCC = MAX	A [‡] P	13 23
	Outputs low		LS244	27 46
	A [†] outputs disabled		LS244	32 54

switching characteristics, VCC 5V, TA 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t _{PLM} Propagation delay time, low-to-high-level output			9	14	ns
t _{PML} Propagation delay time, high-to-low-level output	C _L = 45pF, R _L = 66Ω		12	18	ns
t _{PZL} Output enable time to low-level	See Note 2		20	30	ns
t _{PZH} Output enable time to high-level			15	23	ns
t _{PLZ} Output disable time from low level	C _L = 50pF, R _L = 66Ω		15	25	ns
t _{PHZ} Output disable time from high level	See Note 2		10	18	ns

† For conditions shown as MIN or MAX use the appropriate value specified under recommended operating conditions.
 ‡ AR typical values are at VCC 5V, TA 25°C.
 † Not more than one output should be shorted at a time and duration of the short-circuit should not exceed 100 ns.
 NOTE 2: Load circuit and voltage wave forms are shown on page 3-11.



SN54LS244 (J) SN74LS244 (J, N)

54245 74245 Octal Bus Transceivers with 3-state Outputs

	Schottky TTL			High-Speed TTL			Low-Power Schottky TTL			Standard TTL			Low-Power TTL			
	Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package		Device Type	Package		
		C	P	MCF		C	P	MCF		C	P	MCF		C	P	MCF
CHILD																
MOTOROLA																
NEC																
PHILIPS																
ROHM																
TECHNICS																
TI																
TOYOTA																
WINNERS																
YAMAHA																

Electrical Characteristics SN54LS245/SN74LS245

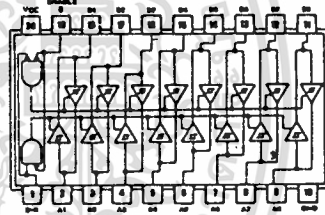
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range						
supply voltage, VCC	7V	Operating free-air temperature range	SN54LS	55°C	10 to 125°C	
input voltage	7V	temperature range	SN74LS	0°C	to 70°C	
		Storage temperature range		65°C	to 150°C	
recommended operating conditions						
	SN54LS245		SN74LS245		UNIT	
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
supply voltage, VCC	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25
high-level output current, IOH			-12			-15
low-level output current, IOL			12			24
operating free-air temperature, TA	-55		125	0		70

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range

PARAMETER	TEST CONDITIONS †	SN74LS245		UNIT
		MIN	TYP ‡ MAX	
High-level input voltage		2		V
Low-level input voltage		0.8		V
input clamp voltage	VCC = MIN, II = -10mA	-1.5		V
Hysteresis (VT+ - VT-)	VCC = MIN	0.2, 0.4		V
High-level output voltage	VCC = MIN VIH = 2V VIL = VILmax IOH = -3mA	2.4, 3.4		V
Low-level output voltage	VCC = MIN VIH = 2V VIL = VILmax IOL = -12mA	0.4		V
Off-state output current, high-level voltage applied	VCC = MAX, VO = 2.7V	10		µA
Off-state output current, low-level voltage applied	VCC = MAX, VO = 0.4V	200		µA
input current at maximum input voltage	A or B DIR or \bar{D} VCI: MAX VI: 7V	0.1		mA
High-level input current	VCC = MAX, VIH = 2.7V	20		µA
Low-level input current	VCC = MAX, VIL = 0.4V	0.2		mA
Short-circuit output current	VCC = MAX	40		225
Supply current	Total outputs = 0 VI, O MAX Outputs oper Outputs at Hi-Z	48 62 64		70 90 95

switching characteristics, VCC 5V, TA 25°C

PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Propagation delay time, low-to-high-level output		8	12	15	ns
Propagation delay time, high-to-low-level output		8	12	15	ns
Output enable time to low level	CL = 50pF, RL = 667 Ω See Note 2	27	40	45	ns
Output enable time to high level		25	40	45	ns
Output disable time from low level	CL = 50pF, RL = 667 Ω See Note 2	15	25	35	ns
Output disable time from high level		15	25	35	ns



SN54LS245 (L) SN74LS245 (L, N)

† Conditions shown as MIN or MAX use the appropriate value specified under recommended operating conditions

‡ Typical values are at VCC = 5V, TA = 25°C.

§ More than one output should be shorted at a time, and duration of the short-short should not exceed one second.

54373/74373 Octal D-Type Transparent Latches and Edge-Triggered Flip-Flops

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL					
	Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package		Device Type		Package			
	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF	C	P	M	CF		
T.I.	SN54S373	J	D							SN54LS373	J	D										
FAIRCHILD	SN74S373	J	D	N	L					SN74LS373	J	D	N	L								
MOTOROLA																						
N.S.C.																						
PHILIPS																						
SIGNETICS																						
SIEMENS																						
FUJITSU																						
HITACHI																						
MITSUBISHI																						
NEC																						
TOSHIBA																						

Electrical Characteristics SN54LS373/SN74LS373

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V _{CC}	7V	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55°C to 125°C
Input voltage	7V	Storage temperature range	SN74LS	0°C to 70°C
		Storage temperature range		65°C to 150°C

recommended operating conditions

	SN54LS373			SN74LS373			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5.5	4.75	5	5.25		V
High-level output current, I _{OH}			-1			-2.6	mA
High-level output voltage, V _{OH}			5.5			5.5	V
Pulse width, t _w	Clock enable high	15		15			ns
	Clock enable high	15		15			ns
Setup time, t _{SUTUP}	0		0.1			0.1	ns
Hold time, t _{HD}	10		10			10	ns
Operating free-air temperature, T _A	-55		125	0		70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

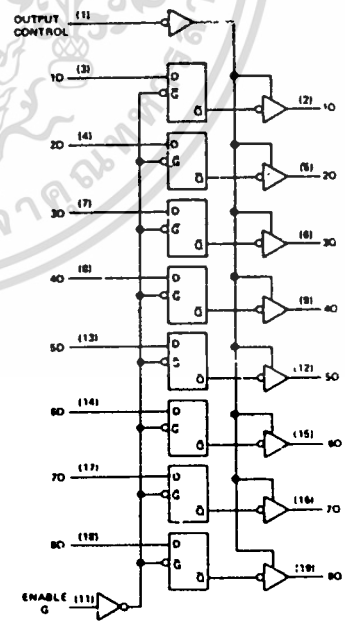
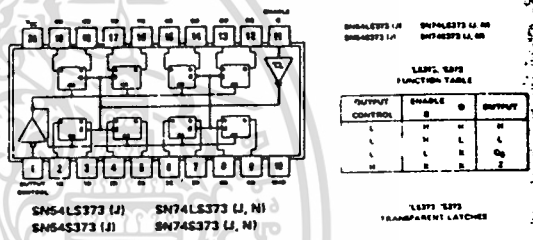
PARAMETER	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT	
V _{IH}	High-level input voltage		2		V	
V _{IL}	Low-level input voltage			0.8	V	
V _{IK}	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -10mA		-1.5	V	
V _{OH}	High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{II} = V _{II} max, I _{OH} = MAX	2.4	3.1	V	
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{II} = V _{II} max, I _{OL} = 24mA	0.35	0.5	V	
I _{OZH}	Off-state output current, high-level voltage applied	V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2V, V _O = 2.7V		20	μA	
I _{OZL}	Off-state output current, low-level voltage applied	V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2V, V _O = 0.4V		-20	μA	
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.1	mA	
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 2.7V		20	μA	
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 0.4V		-0.4	mA	
I _{O5}	Short-circuit output current	V _{CC} = MAX		-30	mA	
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = MAX, Output control at 4.5V LS373		24	40	mA

switching characteristics, V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
t _{max}							MHz
t _{PLH}	Data	Any 0	C _L = 45pF, R _L = 66Ω	12	18		ns
t _{PLH}				12	18		ns
t _{PLH}	Clock or enable	Any 0	See Notes 2 and 3	20	30		ns
t _{PHL}				18	30		ns
t _{PZH}	Output	Any 0	C _L = 5pF, R _L = 66Ω	15	28		ns
t _{PZL}	Control			25	36		ns
t _{PHZ}	Output	Any 0	See Note 3	12	20		ns
t _{PLZ}	Control			15	25		ns

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.
 ‡ All typical values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C.
 § More than one output should be shorted at a time and duration of the short circuit should not exceed one second.

Pin Assignments (Top View)



NOTES 2 Maximum clock frequency is tested with all outputs loaded.
 3 See lead circuits and waveforms on page 3-11.
 t_{max} = maximum clock frequency.
 t_{PLH} = propagation delay time, low-to-high-level output.
 t_{PHL} = propagation delay time, high-to-low-level output.
 t_{PZH} = output enable time to high level.
 t_{PZL} = output enable time to low level.
 t_{PHZ} = output disable time from high level.
 t_{PLZ} = output disable time from low level.

54374/74374 Octal D-Type Transparent Latches and Edge-Triggered Flip-Flops

	Schottky TTL				High-Speed TTL				Low-Power Schottky TTL				Standard TTL				Low-Power TTL				
	Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			Device Type	Package			
		C	P	M	CF		C	P	M	CF		C	P	M	CF		C	P	M	CF	
T.I.	SN54S374 SN74LS374	J1 J1	N N								SN54LS374 SN74LS374	J1 J1	N N								
FAIRCHILD																					
MOTOROLA																					
N.S.C.																					
PHILIPS																					
SIGNETICS																					
SIEMENS																					
FUJITSU																					
HITACHI																					
mitsubishi																					
NEC																					
TOSHIBA																					

Electrical Characteristics SN54LS374/SN74LS374

absolute maximum ratings over operating free-air temperature range

Supply voltage, V _{CC}	V _I	Operating free-air temperature range	SN54LS	-55 to 125°C
Input voltage	V _I	Storage temperature range	SN74LS	0 to 70°C
				-65 to 150°C

recommended operating conditions

	SN54LS374			SN74LS374			UNIT
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX	
Supply voltage, V _{CC}	4.5	5	5.5	4.75	5	5.25	V
High-level output voltage, V _{OH}			-420				μA
High-level output current, I _{OH}			16				mA
Width of clock enabling pulse, t _w	High	15		15			ns
	Low	15		15			ns
Data hold time, t _{hold}		0 †		0 †			ns
Setup time, t _{setup}		20 ‡		20 ‡			ns
Operating free-air temperature, T _A		-55		-25		70	°C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

PARAMETER	TEST CONDITIONS ‡	MIN	TYP ‡	MAX	UNIT
V _{IH}	High-level input voltage		2		V
V _{IL}	Low-level input voltage			0.8	V
V _{IK}	Input clamp voltage	V _{CC} = MIN, I _I = -18 mA		-1.5	V
V _{OH}	High-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{IL} max, I _{OH} = MAX	2.4	3.1	V
V _{OL}	Low-level output voltage	V _{CC} = MIN, V _{IH} = 2V, V _{IL} = V _{IL} max, I _{OL} = 24 mA	0.35	0.5	V
I _{OZH}	Off-state output current, high-level voltage applied	V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2V, V _O = 2.7V		20	μA
I _{OZL}	Off-state output current, low-level voltage applied	V _{CC} = MAX, V _{IH} = 2V, V _O = 0.4V		-20	μA
I _I	Input current at maximum input voltage	V _{CC} = MAX, V _I = 7V		0.1	mA
I _{IH}	High-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 2.7V		20	μA
I _{IL}	Low-level input current	V _{CC} = MAX, V _I = 0.4V		-0.4	mA
I _{OS}	Short-circuit output current ‡	V _{CC} = MAX		130	mA
I _{CC}	Supply current	V _{CC} = MAX, Output control at 1.5V LS374	27	40	mA

switching characteristics, V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

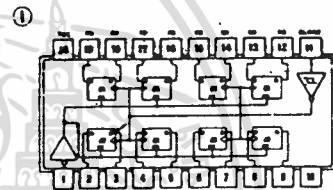
PARAMETER	FROM (INPUT)	TO (OUTPUT)	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
f _{max}				30	50		MHz
t _{PLH}	Data	Any Q	C _L = 45pF, R _L = 667Ω See Notes 2 and 3	15	28		ns
t _{PHL}	Clock or enable	Any Q		19	28		ns
t _{PZH}	Output Control	Any Q		20	28		ns
t _{PZL}	Control	Any Q		21	28		ns
t _{PHZ}	Output Control	Any Q	C _L = 50pF, R _L = 667Ω See Note 3	12	20		ns
t _{PLZ}	Control	Any Q		14	25		ns

† For conditions shown as MIN or MAX, use the appropriate value specified under recommended operating conditions.

‡ All typical values are at V_{CC} = 5V, T_A = 25°C

§ Not more than one output should be started at a time and duration of the short circuit should not exceed one second.

Pin Assignment (Top View)



SN54LS374 (J) SN74LS374 (J, N)
SN54S374 (J) SN74S374 (J, N)

LS374, LS374
FUNCTION TABLE

OUTPUT CONTROL	CLOCK	D	OUTPUT
L	↑	H	H
L	↑	L	L
L	L	X	Q ₀
H	X	X	Z

NOTES 2 Maximum clock frequency is tested with an output loaded.
3 See load circuits and waveforms on page 3-11

f_{max} = maximum clock frequency
t_{PLH} = propagation delay time, low-to-high-level output
t_{PHL} = propagation delay time, high-to-low-level output
t_{PZH} = output enable time to high level
t_{PZL} = output enable time to low level
t_{PHZ} = output disable time from high level
t_{PLZ} = output disable time from low level